

2012

GESCHÄFTSBERICHT

SÜSS MicroTec



LITHOGRAFIE

**LICHT PRÄGT
UNSERE
INDUSTRIE**

KENNZAHLEN

in Mio. €	2012	2011	Veränderung 2012 / 2011
FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN			
Auftragseingang	157,2	143,1	9,9 %
Auftragsbestand zum 31.12.	86,5	83,7	3,3 %
Umsatz gesamt	163,8	175,4	-6,6 %
Umsatzrendite	4,6 %	7,9 %	-3,3 %-Punkte
Rohertrag	57,4	66,4	-13,6 %
Rohertragsmarge	35,0 %	37,9 %	-2,9 %-Punkte
Herstellungskosten	106,4	109,1	-2,5 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	9,7	12,9	-24,8 %
FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN			
EBITDA	18,6	24,9	-25,3 %
EBITDA-Marge	11,4 %	14,2 %	-2,8 %-Punkte
EBIT	11,7	18,6	-37,1 %
EBIT-Marge	7,1 %	10,6 %	-3,5 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	7,6	13,8	-44,9 %
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,40	0,72	-44,4 %
FORTGEFÜHRTE UND NICHT FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN			
Ergebnis nach Steuern	9,1	13,8	-34,1 %
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,48	0,72	-33,3 %
Bilanz und Cashflow			
Eigenkapital	128,1	120,4	6,4 %
Eigenkapitalquote	71,1 %	64,1 %	7,0 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	5,9 %	11,5 %	-5,6 %-Punkte
Bilanzsumme	180,1	187,7	-4,0 %
Net Cash	32,3	42,0	-23,1 %
Free Cashflow ⁽¹⁾	-4,5	3,5	<-100,0 %
Weitere Kennzahlen			
Investitionen ⁽²⁾	4,2	3,4	23,5 %
Investitionsquote	2,6 %	1,9 %	0,7 %-Punkte
Abschreibungen	6,8	6,4	6,3 %
Mitarbeiter zum 31.12.	704	624	12,8 %

⁽¹⁾ vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben, Wertpapierverkäufen und Sondereffekten aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften

⁽²⁾ ohne Berücksichtigung des Erwerbs von Tochtergesellschaften

SEGMENTINFORMATIONEN

FOTOMASKEN EQUIPMENT

Umsatz 2012

22,9 MIO.€

EBIT 2012

1,1 MIO.€



PRODUKTE

Mask Track

ADRESSIERTE MÄRKTE

Halbleiterindustrie

LITHOGRAFIE

Umsatz 2012

113,2 MIO.€

EBIT 2012

23,7 MIO.€



PRODUKTE

Mask Aligner
UV-Projektions-
belichtungssysteme
Laser Processing-Systeme
Entwicklungssysteme
Spin- und Spray-Coater

ADRESSIERTE MÄRKTE

Advanced Packaging
Mikrosystemtechnik (MEMS)
Verbindungshalbleiter
3D-Integration

SUBSTRAT BONDER

Umsatz 2012

23,1 MIO.€

EBIT 2012

-12,0 MIO.€



PRODUKTE

Substrat-(Wafer)-Bonder

ADRESSIERTE MÄRKTE

3D-Integration
Mikrosystemtechnik (MEMS)
Verbindungshalbleiter

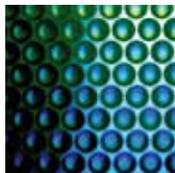
SONSTIGE

Umsatz 2012

4,6 MIO.€

EBIT 2012

-1,0 MIO.€



PRODUKTE

Mikrooptik und -linsen
C4NP

ADRESSIERTE MÄRKTE

Mikrooptik
Halbleiterindustrie
Advanced Packaging (C4NP)

INHALT

- 2 EDITORIAL
- 6 BERICHT DES AUFSICHTSRATS



- 10 Integrierte Schaltkreise – Innovations-treiber auf kleinstem Raum



- 12 Lithografie – Die Kernkompetenz von SÜSS MicroTec



- 16 Zugang zu neuen Märkten mit technologisch führenden Produkten



- 20 Not one size fits all



- 22 Innovationen für die Frontend Lithografie
More than Moore

- 24 INVESTOR RELATIONS
- 28 CORPORATE GOVERNANCE
- 34 ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT
- 71 KONZERNABSCHLUSS
- 86 ANHANG ZUM IFRS-KONZERNABSCHLUSS
- 142 SERVICE

SÜSS MICROTEC WELTWEIT



NORDAMERIKA

Mitarbeiter 131
Umsatz 30,3 Mio. €

EUROPA

Mitarbeiter 444
Umsatz 40,5 Mio. €

JAPAN

Mitarbeiter 24
Umsatz 16,5 Mio. €

SONSTIGES ASIEN

Mitarbeiter 105
Umsatz 76,5 Mio. €

editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir blicken auf ein Jahr 2012 zurück, das einige Herausforderungen für die deutsche Industrie bereithielt. Die abgeschwächte Konjunktur und die anhaltende europäische Schuldenkrise haben die Märkte im letzten Jahr maßgeblich beeinflusst. Die auf europäischer Ebene ergriffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen haben die Situation zwar zeitweise beruhigt, aber die strukturellen Probleme bleiben weiterhin ungelöst. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Weltkonjunktur von der europäischen Schuldenkrise in Mitleidenschaft gezogen wird, ist groß.

Die Finanzmärkte waren 2012 erneut stark von den Auswirkungen politischer Entscheidungen betroffen. Dies hat zu einem unterjährigen Wechselspiel von Hoffnung und Ernüchterung geführt. Zum Jahresende konnten alle wichtigen Indices in Deutschland ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr ausweisen. Trotz der verbesserten Stimmung an den Märkten sind die Vorsicht und eine damit einhergehende hohe Volatilität der Kurse weiterhin spürbar. Auch 2013 wird aller Voraussicht nach die europäische Schuldenkrise weiterhin ein dominierender Faktor in der Wirtschaftswelt sein.

Betrachten wir das Geschäftsjahr 2012 aus Sicht von SÜSS MicroTec, so blicken wir auf ein von Zurückhaltung geprägtes Geschäftsumfeld. Die gesamte Halbleiterbranche bewegte sich in einem schwierigen Umfeld. Trotz dieser Rahmenbedingungen hat sich das Geschäft von SÜSS MicroTec in 2012 als robust erwiesen. Die Ergebnisse reichen nicht an das außerordentlich gute Geschäftsjahr 2011 heran, sind aber unter Berücksichtigung der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage sehr zufriedenstellend. Wir haben ein Umsatzniveau von 163,8 Mio. Euro und ein Ergebnis von 11,7 Mio. Euro erzielt. Der Auftragseingang für das Gesamtjahr lag bei 157,2 Mio. Euro und hat erneut einen guten Wert erreicht.

Darüber hinaus haben wir 2012 weitere wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens vorgenommen. Es ist uns gelungen unser Kerngeschäft, die Lithografie, mit der Akquisition der Tamarack Scientific auszuweiten und langfristig zu stärken. Wir haben uns mit diesem Schritt zu einem weltweit einzigartig aufgestellten Anbieter von umfassenden Produkten und Lösungen für die Mid- und Backend Lithografie entwickelt. Im Bereich Belichtung bietet in diesem Segment kein anderes Unternehmen ein vergleichbares Kompetenzspektrum und die daraus abgeleitete vielfältige und kundentoptimierte Produktpalette an. Die Belichtungstechnologie für die Halbleiterfertigung gehört zu den langjährigen Kernkompetenzen von SÜSS MicroTec. In diesem Zusammenhang feiern wir 2013 ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 50 Jahren hat das Unternehmen – damals noch unter dem Namen Karl Süss – den ersten Mask Aligner entwickelt, gebaut und an Kunden ausgeliefert. In diesem Geschäftsbericht erfahren Sie nicht nur mehr über die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des Mask Aligners, sondern wir berichten über die besondere Bedeutung der Lithografie und der lithografischen Verfahren für die Halbleiterbranche und für SÜSS MicroTec.

DAS GESCHÄFTSJAHR IN ZAHLEN

Im Vergleich zu 2011 hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage 2012 kaum gebessert, die schwierige Situation in Europa hat die Unternehmen weiterhin fest im Griff. Es muss jedoch festgehalten werden, dass sich die schlimmsten Befürchtungen – glücklicherweise – nicht bewahrheitet haben. Vor diesem Hintergrund sind unsere Unternehmenszahlen insgesamt hinter dem sehr erfolgreichen Jahr 2011 zurückgeblieben, aber wir haben keinen massiven Einbruch im Umsatz erlebt sondern konnten sogar im Auftragseingang zulegen. Der Auftragseingang im Gesamtjahr 2012 belief sich auf 157,2 Mio. Euro, was ein Plus von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet (Vorjahr: 143,1 Mio. Euro). Der Umsatz war im Jahresvergleich leicht rückläufig und lag mit 163,8 Mio. Euro um 6,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahres (Vorjahr: 175,4 Mio. Euro).

Die Rohertragsmarge hat sich im abgelaufenen Gesamtjahr verringert und lag für die SÜSS MicroTec-Gruppe bei 35,0 Prozent (Vorjahr: 37,9 Prozent). Die Hauptgründe für diesen Rückgang sind zum einen die rückläufige Marge im Bereich Fotomaschinen Equipment und zum anderen die Marge im Lithografiebereich, welche nach einem äußerst starken Jahr 2011 wieder auf ein normales Niveau zurückgekehrt ist.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 11,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 18,6 Mio. Euro. Hierin sind einmalige Währungseffekte in Höhe von -0,4 Mio. Euro enthalten. Diese resultieren aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten der SÜSS MicroTec AG gegenüber der Süss MicroTec, Inc. im Zusammenhang mit der im März 2012 erfolgten Akquisition von Tamarack Scientific. Im vierten Quartal 2012 ergab darüber hinaus eine Anpassung der Purchase Price Allocation sowie eine Neubeurteilung der Earn-Out-Rückstellung per Saldo einen Ertrag in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Insgesamt wirkten der erhöhte Umsatzanteil mit Substrat Bondern, der negative Ergebnisbeitrag von Tamarack Scientific sowie die hohen Forschungs- und Entwicklungskosten margaenbelastend.

Das Ergebnis nach Steuern (EAT) belief sich für das fortgeführte Geschäft auf 7,6 Mio. Euro nach 13,8 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) für das fortgeführte und nicht fortgeführte Geschäft belief sich auf 9,1 Mio. Euro nach 13,8 Mio. Euro im Vorjahr. Darin enthalten ist ein steuerfreier Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro, welcher aus dem Verkauf der Testsysteme in 2010 resultiert. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Aktivitäten beträgt 0,40 Euro (Vorjahr: 0,72 Euro).

Der Free Cashflow belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapieren und Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten zum Ende des Geschäftsjahres auf -4,5 Mio. Euro nach 3,5 Mio. Euro im Vorjahr. Damit verfügte die SÜSS MicroTec-Gruppe zum 31. Dezember 2012 über liquide Mittel und verzinsliche Wertpapiere in Höhe von 36,6 Mio. Euro. Die Net Cash-Position verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2011 von 42,0 Mio. Euro auf 32,3 Mio. Euro im Wesentlichen bedingt durch die Akquisition der Tamarack Scientific.



Michael Knopp
Finanzvorstand der SÜSS MicroTec AG



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

MEILENSTEINE 2012

Neben den operativen Verlagerungsaktivitäten und der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens haben wir die Grundlage unseres Wachstums und Erfolgs, die innovativen Produktentwicklungen, weiter gestärkt. Im vergangenen Geschäftsjahr gab es wichtige Produkteinführungen, die unsere Position als einer der technologisch führenden Equipment-Anbieter in den von uns bedienten Märkten im Halbleiter Mid- und Backend sowie im Fall der Fotomaschinenreinigung auch im Frontend bestätigt. Zu diesen Produktneuerungen gehört beispielsweise die XBC300 Gen2. Mit diesem Bond Cluster hat SÜSS MicroTec im Februar 2012 eine neue Geräteplattform für 3D-Prozesse in der Volumenproduktion in den Markt eingeführt. Diese aktuelle Generation von Bonding-Equipment kann für das permanente Bonden von Wafern oder für das Debonden und Reinigen von 200mm und 300mm Wafern konfiguriert werden. Im März 2012 wurde zudem mit der RCD8 eine neuentwickelte manuelle Geräteplattform zum Belacken und Entwickeln von Substraten in den Markt eingeführt. Mit der dritten Generation der ACS200, einer Automatenplattform zum Belacken und Entwickeln von 200mm Wafern wurde ein weiteres innovatives Systemkonzept am Markt platziert. Die vielfältige und flexible Konfigurierbarkeit der unterschiedlichen Module und Technologien ermöglicht nicht nur den Einsatz in Forschung und Entwicklung, sondern deckt darüber hinaus die Anforderungen der Kernmärkte Advanced Packaging, MEMS und LED in der Volumenproduktion ab.

Auch im Jahr 2012 haben wir einen Schwerpunkt auf das Thema Kooperationen gelegt und konnten im Februar die Zusammenarbeit mit der GenlSys GmbH bekannt gegeben. Gemeinsam mit GenlSys wurde die Lithografie-Simulationssoftware Layout LAB™ für den Einsatz mit Mask Alignern von SÜSS MicroTec optimiert. Mit Dow Corning haben wir 2012 eine Kooperation beim temporären Waferbonden für die 3D (TSV) Integration begonnen.

Wie einleitend erwähnt haben wir im ersten Quartal 2012 einen weiteren substanziellen Meilenstein für das Unternehmen erreicht. Durch die strategische Akquisition der Tamarack Scientific haben wir unser Technologie- und Produktportfolio sinnvoll erweitert. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt UV-Projektionsbelichtungsgeräte sowie laserbasierte Mikrostrukturierungssysteme. Damit haben wir uns zum führenden Anbieter von Mid- und Backend Lithografieanlagen und -prozesslösungen entwickelt und haben uns damit eine weltweite Alleinstellung erarbeitet.

Vorstand und Aufsichtsrat von SÜSS MicroTec sind weiterhin bestrebt, die Organisationsstruktur des Unternehmens zu vereinfachen und gleichzeitig Kernkompetenzen im Haus zu erhalten und auszubauen. Aus diesem Grund haben wir 2012 unseren Anteilsbesitz an der Süss MicroOptics S.A., Neuchâtel, Schweiz, von 85 Prozent auf 100 Prozent aufgestockt. Süss MicroOptics ist führender Lieferant hochwertiger refraktiver und diffraktiver Mikrooptiken, die sowohl bei SÜSS MicroTec als auch bei anderen Unternehmen nicht nur in der Halbleiterbranche zum Einsatz kommt. Das Unternehmen ist in attraktiven und schnell wachsenden Märkten tätig. Um dem kontinuierlich wachsenden Geschäftsvolumen Rechnung zu tragen und um die Produktionseinrichtungen auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, wurde der Umzug in ein neues Produktionsgebäude erforderlich. Das neue Gebäude, welches zweckgerecht ausgebaut wurde, unterstützt die strategische Wachstumsausrichtung des Bereichs Mikrooptik.

Meine Damen und Herren, abschließend möchten wir Sie noch auf unsere verstärkten Aktivitäten im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen. Seit August 2012 ist die SÜSS MicroTec AG ein offiziell anerkannter Partner der Nachhaltigkeitsinitiative „Blue Competence“ des VDMA. Da Nachhaltigkeit auch im industriellen Sektor immer mehr an Bedeutung gewinnt, haben wir uns der Initiative des VDMA angeschlossen. Als Teil der sozialen Verantwortung legen wir großen Wert auf den Schutz der Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft sowie das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums. Unsere Geschäftsbeziehungen umfassen nicht nur ökonomische und finanzielle Gesichtspunkte, auch die Umwelt und soziale Aspekte werden in gleicher Weise in Betracht gezogen.

AUSBLICK

Für das laufende Jahr sehen die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute eher verhalten aus. Eine nachhaltige Belebung der Weltwirtschaft ist aus heutiger Sicht für 2013 nicht zu erwarten. Der Hauptgrund hierfür ist die weiterhin unge löste Schuldenproblematik in Europa sowie die verlangsamte Wachstumsdynamik in den Schwellenländern und aufstrebenden Volkswirtschaften. Das ifo-Institut geht von einem schwachen Winterhalbjahr 2012/13 aus und erwartet neue Wachstumsimpulse für die Weltwirtschaft im Verlauf des zweiten Halbjahres 2013. Eine ähnliche Erwartungshaltung gilt auch für den Euroraum, hier wird von einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent im Jahr 2013 ausgegangen.

Für die Halbleiterbranche erwartet das Marktforschungsinstitut Gartner einen Anstieg der Nachfrage nach Halbleiterprodukten um 4,5 Prozent gegenüber 2012. Das Wachstum wird im Wesentlichen durch eine zunehmende Nachfrage nach Tablet-Computern und Smartphones ausgelöst. Für den Halbleiter-Equipment-Markt prognostiziert Gartner für 2013 einen leichten Rückgang gegenüber 2012.

Aufgrund des zum Jahresende 2012 gebuchten Auftragsbestands, des schwachen Konjunkturausblicks und des verhaltenen Starts in das Jahr 2013 rechnen wir insgesamt für das Geschäftsjahr 2013 mit einem Umsatz von rund 150 Mio. Euro und einem EBIT im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Alles in allem blicken wir auf ein spannendes Geschäftsjahr zurück und möchten hiermit allen Mitarbeitern für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung der verschiedenen Projekte danken.

Garching, im März 2013



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 informieren.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben nachgekommen und hat den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit uns ab und unterrichtete uns regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden im Einzelnen erläutert und von uns anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir mit dem Vorstand ausführlich erörtert, und zu zustimmungspflichtigen Geschäften haben wir unsere Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2012 fanden insgesamt sieben ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. An diesen Sitzungen haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratsitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Es gab keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre.

SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Finanzlage, die Investitionsprojekte sowie die Geschäftsentwicklung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unterrichtete umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers befasst. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsratsitzungen eingegangen.

Am 9. Februar 2012 fand die erste ordentliche Aufsichtsratsitzung statt. Hierbei befassten wir uns intensiv mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2011 und zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2011. Der vorgelegten Planung für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach intensiven Diskussionen zugestimmt. Weiterhin wurde dem Aufsichtsrat ein erneutes Update der strategischen Projekte präsentiert. In diesem Zusammenhang autorisierte der Aufsichtsrat den Vorstand, ein Projekt im definierten Rahmen fortzuführen. Zudem genehmigte der Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten Termsheet-Entwurf zum Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc., Corona, USA, und stimmte der Durchführung einer Due Diligence sowie der Aufnahme von Kaufvertragsverhandlungen zu. Abschließend wurden die Ziele für die erfolgsabhängige Vergütung des Vorstands erörtert.

An der zweiten Sitzung am 27. März 2012 haben Vertreter unseres Abschlussprüfers teilgenommen. Sie informierten den Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011. Mit den Vertretern des Abschlussprüfers diskutierten wir Fragen der Bilanzierung sowie die wesentlichen Sachverhalte des abgelaufenen Geschäftsjahres und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Des Weiteren erläuterte uns der Abschlussprüfer die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2011 und zur aktuellen Geschäftslage haben wir zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2011. Außerdem wurde Beschluss gefasst über den Bericht des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Aufsichtsrat ermächtigte den Vorstand, den Kauf der Tamarack Scientific Co., Inc. zu den festgelegten Bedingungen abzuschließen. Zudem erörterten Aufsichtsrat und Vorstand den Status eines weiteren strategischen Projektes. Darüber hinaus wurden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 20. Juni 2012 erörtert. Der Aufsichtsrat fasste Beschluss über den Vorstandsbonus für das Geschäftsjahr 2011 sowie die Ziele des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.



Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender

Am 3. Mai 2012 fand die dritte ordentliche Aufsichtsratsitzung statt. Wir haben uns mit den aktuellen Zahlen zum ersten Quartal 2012 und der Prognose für das Gesamtjahr befasst. Im Rahmen dieser Sitzung hat der Vorstand dem Aufsichtsrat ein Update zum Stand der laufenden strategischen Projekte vorgelegt und erläutert. An dieser Sitzung nahm zeitweise Dr. Reinhard Völkel (Geschäftsführer der Suss MicroOptics S.A.) teil. Er stellte uns das Unternehmen Suss MicroOptics vor und wir erörterten anschließend den Vorschlag des Vorstands, den Anteilsbesitz an der Suss MicroOptics auf 100 Prozent zu erhöhen. Nach ausführlicher Diskussion stimmte der Aufsichtsrat einer Erhöhung der Beteiligung an der Suss MicroOptics auf 100 Prozent zu. Es wurden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 20. Juni 2012 beschlossen.

Am 29. Mai 2012 hat der Aufsichtsrat der aktualisierten Entsprechenserklärung der Gesellschaft zugestimmt.

In der Sitzung am 20. Juni 2012, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand vornehmlich über die aktuelle Geschäftslage informiert. Wir haben außerdem vom Vorstand ein Update zu den laufenden strategischen Projekten erhalten. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung trat der neu gewählte Aufsichtsrat erstmals zusammen. In seiner konstituierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Stefan Reineck zum Vorsitzenden, sowie Herrn Jan Teichert zu seinem Stellvertreter.

Am 2. August 2012 fand die fünfte ordentliche Aufsichtsratsitzung des Jahres 2012 statt. In dieser Sitzung wurde dem Aufsichtsrat ein Update zum laufenden Geschäft gegeben. Insbesondere erörterten Vorstand und Aufsichtsrat das Vorschreiten der Integration von Tamarack Scientific in die SÜSS MicroTec-Gruppe. Vorstand und Aufsichtsrat beschäftigten sich mit den jüngsten M&A-Transaktionen im Halbleiter Equipment Markt und deren Bedeutung für die Süss MicroTec AG. Ferner erörterten wir die Ergebnisse der wichtigen Halbleitermesse Semicon West in San Francisco, welche im Juli 2012 stattgefunden hat.

In der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats vom 6. November 2012 berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf das Gesamtjahr. Zudem erhielten wir in dieser Sitzung vom Vorstand eine erste Einschätzung der voraussichtlichen Entwicklung der wichtigsten Absatzmärkte 2013. Darüber hinaus berichtete der Vorstand über den Status der laufenden strategischen Projekte. Der Aufsichtsrat fasste Beschluss über den Kauf der Immobilie am Standort Garching zu den festgelegten Konditionen. Weiterhin berieten Vorstand und Aufsichtsrat über die Ausgabe von Aktienoptionen Ende November 2012. Der Aufsichtsrat stimmte der Ausgabe von Aktienoptionen nicht zu.

Gegenstand der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2012, die am 18. Dezember 2012 stattfand, waren im Wesentlichen die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Planung für das Geschäftsjahr 2013. Darüber hinaus präsentierte der Vorstand dem Aufsichtsrat ein weiteres Update zum Stand der strategischen Projekte und zum geplanten Kauf der Immobilie am Standort Garching. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit Themen der Corporate Governance. Insbesondere beschäftigte er sich mit Risikomanagement, Compliance und dem neugefassten Deutschen Corporate Governance Kodex. Er aktualisierte die Ziele und Kriterien für die Besetzung des Aufsichtsrates. Desweiteren legte er den Jahreskalender 2013 fest.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt Vergütungsbericht des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 56 ff. wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben am 29. Mai 2012 die jährliche Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2012 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2012 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 26. März 2013 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen Abschlussprüfung waren die Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc., die Werthaltigkeit der Finanzanlagen und der Impairmenttest im Konzernabschluss, Umsatzrealisierung und Plausibilität der prognostischen Angaben.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der SÜSS MicroTec AG wurden von uns geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers haben wir nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens haben wir zugestimmt.

Im Geschäftsjahr 2012 gab es keine personellen Änderungen im Vorstand.

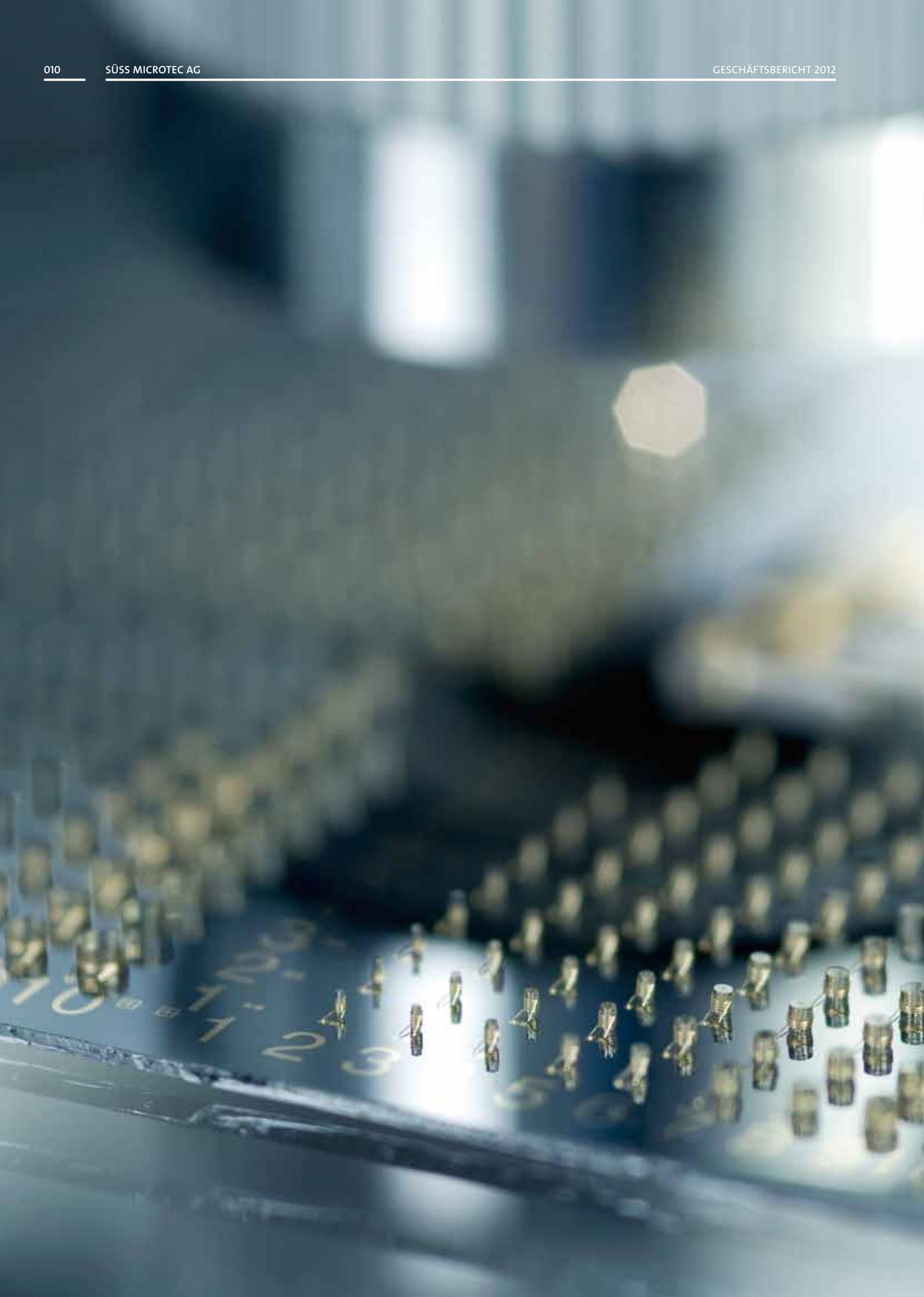
Für die tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung aus.

Garching, 26. März 2013

Für den Aufsichtsrat



Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender



Heute finden auf wenigen Quadratmillimetern Milliarden von Transistoren Platz.

INTEGRIERTE SCHALTKREISE – INNOVATIONSTREIBER AUF KLEINSTEM RAUM

Mitte des 20. Jahrhunderts gelang es erstmals mit einem Halbleiterbauelement – dem Transistor – Strom durch ein elektrisches Signal zu steuern. Wenig später haben Wissenschaftler verschiedene Komponenten, wie Kondensatoren, Widerstände sowie Transistoren auf einem einzigen Substrat zusammengeführt und hiermit den ersten integrierten Schaltkreis geschaffen. Dies war der Startschuss für die moderne Elektronikindustrie. Die Entwicklung der – auf sogenannten Halbleitern basierenden – Schaltungen hat von da an eine rasante Entwicklung genommen. Nach der als „Moore’s Law“ beschriebenen Gesetzmäßigkeit hat sich seither die Anzahl der Transistoren in integrierten Schaltkreisen ca. alle 18 Monate verdoppelt. Mit anderen Worten, die Leistungssteigerung in

der Halbleitertechnologie wurde durch die Verkleinerung von Bauelementstrukturen erreicht. Heute finden auf wenigen Quadratmillimetern Milliarden von Transistoren Platz, sie steuern Computer, verarbeiten und speichern Daten oder führen komplizierte Berechnungen im Bruchteil einer Sekunde aus.

SÜSS MicroTec ist mit seiner sehr erfolgreichen Kernproduktlinie – den Belichtungsgeräten Mask Aligner – seit den industriellen Anfängen der Fertigung integrierter Schaltkreise (IC) in den 1960er Jahren aktiv. Der Mask Aligner feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über SÜSS MicroTec, die Dynamik in der Halbleiterindustrie und welche wichtige Rolle dabei das Thema Lithografie einnimmt.

HALBLEITER

Halbleiter sind Feststoffe, deren Leitfähigkeit zwischen der von Leitern und Nichtleitern liegt. Es handelt sich hierbei um einen einkristallinen Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch Integrierte Schaltkreise aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise eines integrierten Schaltkreises werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske (z. B. im Mask Aligner) belichtet.

LITHOGRAFIE – DIE KERNKOMPETENZ VON SÜSS MicroTec

Kaum eine Industrie hat sich in der Geschichte so rasant entwickelt, so viele Neuerungen hervorgebracht und damit das tägliche Leben so maßgeblich beeinflusst wie die Elektronikindustrie. Besonders hervorzuheben ist die Halbleiterbranche, welche das Zeitalter von Internet, grenzenloser mobiler Kommunikation und des digitalen Lebenswandels erst ermöglicht hat. Blickt man in die Zukunft, so wird schnell klar, dass die Menschheit auch in den kommenden Jahren nach schnelleren Computern, leistungsfähigeren Mobiltelefonen und komplexeren Endgeräten verlangen wird. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit auf immer kleinerem Raum umzusetzen erfordert eine stetige Weiterentwicklung der Fertigungstechnologien in der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie. Zu den Zukunftsthemen in der Halbleiterbranche gehören die erfolgreiche und massentaugliche Einführung der EUV-Lithografie, der Einsatz von 450 mm Wafern in der industriellen Produktion und das Stapeln gedünnter Mikrochips – die 3D-Integration. An all diesen Themen arbeiten auch Ingenieure von SÜSS MicroTec in ihrem jeweiligen Spezialgebiet.



SCHATTENWURF-VERFAHREN (PROXIMITY LITHOGRAFIE)

Hierbei handelt es sich um ein Belichtungsverfahren in der Halbleiterindustrie (vorwiegend im Mid- und Backend), bei dem eine Glasmaske sehr nah an einen Wafer herangeführt und submikrometergenau zu diesem Wafer ausgerichtet wird. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den mit fotoempfindlichem Material belackten Wafer übertragen. Dieser Arbeitsschritt wird von einem Mask Aligner vollzogen.

SPEZIALMASCHINENBAUER IM MID- UND BACKEND

In der Halbleiterindustrie werden elektronische Schaltkreise, auch Mikrochips genannt, mit Hilfe von lithografischen Verfahren hergestellt. Man unterscheidet bei der Herstellung der Mikrochips das Frontend, Mid- und Backend. Im Frontend wird der eigentliche Mikrochip durch die Strukturierung einzelner Ebenen auf dem Siliziumwafer in einer Art Schichtaufbau hergestellt. Es werden hierbei Strukturgrößen im Nanometerbereich hergestellt. Erst nachdem die einzelnen Mikrochips auf dem Wafer fertig gestellt sind, beginnen die Prozessschritte des Mid- und Backends. Zum Midend gehört unter anderem das Advanced Packaging oder auch Wafer Level Packaging, dabei wird der Wafer als Ganzes durch den Prozess geführt. Hierbei handelt es sich um eine moderne Form der Verpackungstechnologie, die das klassische Verbinden mit Kupferdrähten (Wire-Bonding) ersetzt und eine große Anzahl von Verbindungen bei gleichzeitig kleinerem Flächenbedarf ermöglicht. Diese Technologie hat insbesondere durch die starke Zunahme von Smartphones und Tablet-PCs in jüngster Zeit an Bedeutung gewonnen. Im Sensorikbereich (Mikroelektromechanische Systeme, MEMS) wird auch mit Midend-Prozessschritten gefertigt. Der Mikrochip durchläuft das Backend erst nach dem Vereinzeln, dazu gehört beispielsweise das klassische Wire-Bonding wobei der individuelle Mikrochip auf einen Leiter-Rahmen gegeben und in ein Plastikgehäuse eingekapselt wird sowie das anschließende Testen der einzelnen Mikrochips. Wire-Bonding kommt immer dann zum Einsatz, wenn ausreichend Raum im Endgerät verfügbar ist.

SÜSS MicroTec ist als Spezialmaschinenbauer mit Substrat Bondern, dem Fotomaschinen Equipment und den

Lithografiegeräten seit Jahrzehnten in dieser Industrie tätig und trägt maßgeblich dazu bei, dass die inzwischen vernetzte und vollelektronische Welt reibungslos funktioniert. Das Angebot an Lösungen von SÜSS MicroTec umfasst alle leistungsrelevanten Arbeitsschritte der Waferbearbeitung von Belackung, Aushärtung und Entwicklung über die Belichtung bis hin zum Bonden der Wafer. Darüber hinaus gehören Geräte zur Reinigung von Fotomaschinen, die bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen im Frontend zum Einsatz kommen, zur Produktpalette. Hinzu kommen hochspezialisierte Zusatzausrüstungen wie Lithografie-Tools für das Nanoimprinting und optische Linsen. Das Knowhow im Unternehmen hat sich über Jahrzehnte entwickelt und macht SÜSS MicroTec zu einem unverzichtbaren Partner der Halbleiterindustrie.

SÜSS MicroTec adressiert mit seinen Maschinen und Lösungen weitgehend das Mid- und Backend der Halbleiterfertigung. Wichtige Schwerpunktmärkte des Unternehmens sind das Advanced Packaging oder Wafer Level Packaging und der MEMS-Markt. Beim Advanced Packaging und bei der Herstellung von MEMS werden verschiedene lithografische Verfahren eingesetzt, dabei kommen häufig Mask Aligner, Belacker und Entwickler aus dem Hause SÜSS MicroTec zum Einsatz. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen weltweite Marktanteile von bis zu 50 Prozent. Zu den Kunden gehören die großen Packaginghäuser, welche überwiegend in Asien angesiedelt sind, aber auch die integrierten Hersteller von Halbleiterchips sowie zukunftsweisende Forschungsinstitute. Ein weiterer Markt, der von SÜSS MicroTec bedient wird, ist der LED-Markt, hier gehören namhafte LED-Hersteller zum Kundenstamm. Der LED-Markt ist derzeit von Überkapazitäten und einer entsprechend geringen Nachfrage geprägt, doch mittel- und langfristig wird das Thema energieeffiziente Beleuchtung wieder in den Fokus rücken und die Nachfrage nach kostengünstigen und stromsparenden Leuchtmitteln – wie LEDs – erhöhen. »

Maskenmagazin
des Mask Aligners
MA300Gen2



GEZIELTE LITHOGRAFIE- LÖSUNGEN FÜR ATTRAKTIVE WACHSTUMSMÄRKTE

Eine wichtige Applikation – das Advanced Packaging – basiert auf einer besonderen Midend-Fertigungstechnologie. Hierbei wird die Kontaktierung des Mikrochips, noch während er auf dem Wafer ist, aufgebracht. Anstelle der beim Wire Bonding verwendeten Leitungsdrähte

werden hierbei sogenannte Lotkügelchen (Micro Bumps) mit hoher Präzision auf den fertigen Mikrochip aufgebracht, die später als Kontakt dienen. Diese Packaging-Technologie kommt überwiegend bei Anwendungen zum Tragen, wo eine hohe Packungs- und Leistungsdichte auf sehr kleinem Raum gefragt ist. Dazu gehören Mikrochips, wie beispielsweise Bluetooth-, WLAN- und GPS-Komponenten, die in Smartphones, Tablet-PCs und

Ultrabooks zum Einsatz kommen. Diese Anwendungen werden auch in Zukunft ein starkes Wachstum aufweisen und damit einen massgeblichen Einfluß auf das Geschäft von SÜSS MicroTec haben. Bei Applikationen mit wenig kritischer Platzanforderung, z.B. bei Fernsehern oder Desktop-Computern, werden auch weiterhin konventionelle Technologien zum Einsatz kommen.

In unseren Maschinen
steckt das Knowhow vieler
Ingenieursgenerationen.



Der MEMS-Markt wird von vergleichbaren Endanwendungen wie das Advanced Packaging bestimmt. In einem modernen Smartphone oder Tablet-PC finden sich bereits heute bis zu neun MEMS-Funktionen. Glaubt man den Marktvorschau, so wird nicht nur die Anzahl der verkauften Smartphones und anderer mobiler Endgeräte zunehmen, sondern auch die Anzahl der MEMS-Sensoren pro Gerät wird ansteigen. Für die Herstellung

von MEMS-Bausteinen und auch beim Advanced Packaging kommen die Lithografiefösungen von SÜSS MicroTec zum Einsatz. Neben einzelnen Geräten zum Belackern, Belichten und Entwickeln bietet das Unternehmen auch komplette Lithografie-Systemlösungen, in denen mehrere Prozessschritte integriert sind, an. Für den Kunden hat dies den Vorteil, dass eine komplette Prozesskette mit Maschinen eines Herstellers abgedeckt wird. Bei SÜSS MicroTec findet der Kunde im Falle von Prozessveränderungen oder Fragen zu Wartung und Service einen direkten Ansprechpartner für eine Vielzahl von Arbeitsschritten. Kaum ein anderes Unternehmen im Halbleiter-Backend kann seinem Kunden diesen Mehrwert bieten.

Bei der Herstellung von MEMS und LEDs kommen neben den Lithografiegeräten auch Substrat Bonder von SÜSS MicroTec zum Einsatz. Zu typischen Prozessschritten bei der LED-Herstellung gehört neben der lithografischen Strukturierung von Kontaktflächen, Elektroden und Ätzmasken auch das Bonden zum Aufbringen von Spiegelflächen oder zum Zusammenfügen von verschiedenen Epitaxielagen. Um den speziellen Anforderungen des LED-Markts gerecht zu werden, hat das Unternehmen den Mask Aligner MA100e Gen2 entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein Belichtungsgerät mit besonders hohem Durchsatz durch die parallele Verarbeitung von bis zu drei Wafern, bei gleichzeitig hoher Ausbeute. Der LED-Markt ist nach zwei starken Jahren 2010 und 2011 derzeit von einer geringen Nachfrage nach Fertigungsequipment geprägt, doch perspektivisch wird der Einsatz energieeffizienter Beleuchtungsmittel stark zunehmen.

ERWEITERUNG DER BELICHTUNGSKOMPETENZ

Mit der Mask Aligner-Technologie deckt SÜSS MicroTec seit vielen Jahren wesentliche Prozessschritte der Mid- und Backend-Lithografie ab. Es gibt jedoch Anwendungsbereiche, bei denen die Mask Aligner-Technologie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangt. Dies ist der Fall, wenn der zu belichtende Wafer bereits eine ausgeprägte Topografie aufweist und somit eine natürliche Grenze besteht, wie nah die Maske an den Wafer gebracht werden kann, ohne in Kontakt zu kommen. Ein anderes Beispiel sind Auflösungen im Bereich von 2-5 μ , hier können andere Belichtungs-technologien unter Umständen genauere und feinere Ergebnisse erzielen. Zu den alternativen Technologien gehört z.B. die UV-Projektionsbelichtung, eine Technologie, die das Unternehmen bisher nicht im Produktspektrum hatte. Mit der Übernahme von Tamarack Scientific im März 2012 hat SÜSS MicroTec diese Technologielücke geschlossen und hat sich zum weltweit einzigen Anbieter umfassender Mid- und Backend-Belichtungsverfahren weiterentwickelt.



UV-PROJEKTIONS-BELICHTUNG

Während beim Schattenwurf die Belichtung des kompletten Wafers in einem Schritt erfolgt, werden bei projektionslithografischen Prozessen einzelne Felder des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die gesamte Belichtung des Wafers erfolgt somit entweder schrittweise („Step-and-Repeat“) oder kontinuierlich („Scannen“).

LASER-PROZESSIERUNG

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. So finden sich aktuelle Einsatzgebiete im Bereich der 3D-Integration, z.B. bei der Herstellung von Durchkontaktierungen in Interposern oder im Bereich von Umverdrahtungslagen.

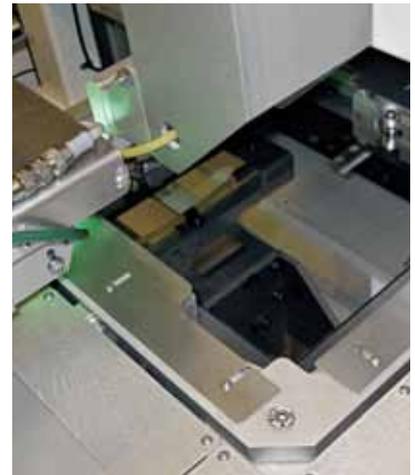


ZUGANG ZU NEUEN MÄRKTEN MIT TECHNOLOGISCH FÜHRENDEN PRODUKTEN



Am 29. März 2012 hat SÜSS MicroTec sämtliche Aktien der Firma Tamarack Scientific Co., Inc. (Tamarack Scientific) übernommen. Der Kaufpreis für die Übernahme aller Aktien betrug 9,34 Mio. US-Dollar. Es wurde ein zusätzlicher variabler Kaufpreisanteil vereinbart, dessen Höhe von der Umsatzentwicklung und den erwirtschafteten Deckungsbeiträgen der nächsten drei Geschäftsjahre abhängt. Tamarack Scientific hat zum Zeitpunkt der Übernahme mit rund 60 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 10 Mio. Euro und ein negatives Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern erwirtschaftet. Die Zielmärkte des Unternehmens sind weitestgehend

deckungsgleich mit denen von SÜSS MicroTec, dazu gehören das Advanced Packaging, die 3D-Integration, der MEMS- und der LED-Markt. Die Geräte von Tamarack Scientific kommen sowohl in der industriellen Produktion als auch in der Forschung und Entwicklung zum Einsatz. Tamarack Scientific entwickelt, produziert und vertreibt UV-Projektionsbelichtungsgeräte (Stepper und Scanner) sowie laserbasierte Mikrostrukturierungssysteme. Mit der Akquisition von Tamarack Scientific verfolgt SÜSS MicroTec eine Konsolidierungsstrategie im Halbleiter Backend und hat die vorhandene Lithografiekompetenz um die UV-Projektionsbelichtung sowie die Lasertechnologie sinnvoll ergänzt. »



Mit den Laserprozessierungs-Systemen und den UV-Projektionsbelichtungsgeräten von Tamarack Scientific hat SÜSS MicroTec sein Produktportfolio sinnvoll erweitert.



Tamarack Scientific war in seinem Heimatmarkt USA erfolgreich, konnte jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen die Migration der Halbleiterindustrie nach Asien nicht begleiten und war somit in seinen Wachstumsperspektiven begrenzt. Mit der Übernahme durch SÜSS MicroTec eröffnen sich für Tamarack Scientific neue und attraktive Märkte außerhalb der USA. Die globale Vertriebs- und Servicestruktur von SÜSS MicroTec kann die Produkte von Tamarack Scientific direkt vermarkten und unterstützen. Zu diesem Zweck wurden im Anschluss an die Akquisition intensive Schulungen der Mitarbeiter durchgeführt. Insbesondere die schnelle Verfügbarkeit von Servicemitarbeitern ist ein wichtiges Kriterium, um mit internationalen Produktionskunden in Geschäftsbeziehungen treten zu können. Darüber hinaus liegt eine große Herausforderung im Bereich Entwicklung und Produktion. Tamarack Scientific als einstiger Sondermaschinenbauer schlüpft nun in die Rolle eines Kleinserienherstellers. Allein der Zugang zu neuen Märkten reicht hier nicht aus, sondern das Unternehmen muss nun die hohen Anforderungen der Produktionskunden erfüllen.

Auf der Arbeitsebene wurden im letzten Jahr bereits gemeinsame, standortübergreifende Projekte begonnen. Entwicklerteams aus Garching, Sternenfels und Corona haben Synergien zwischen verschiedenen Produktlinien identifiziert und bereits genutzt.

NEUE MASCHINEN UND TECHNOLOGIEN ERGÄNZEN PRODUKTPALETTE

Tamarack Scientifics Maschinen zur Projektionslithografie und zur Laserstrukturierung sind eine logische Erweiterung der Technologiekompetenz zu den SÜSS MicroTec Mask Alignern. Das umfassende Knowhow im Bereich Belichtung verschafft dem Unternehmen eine stärkere Position im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, die typischerweise nur eine Belichtungs-technologie anbieten können.

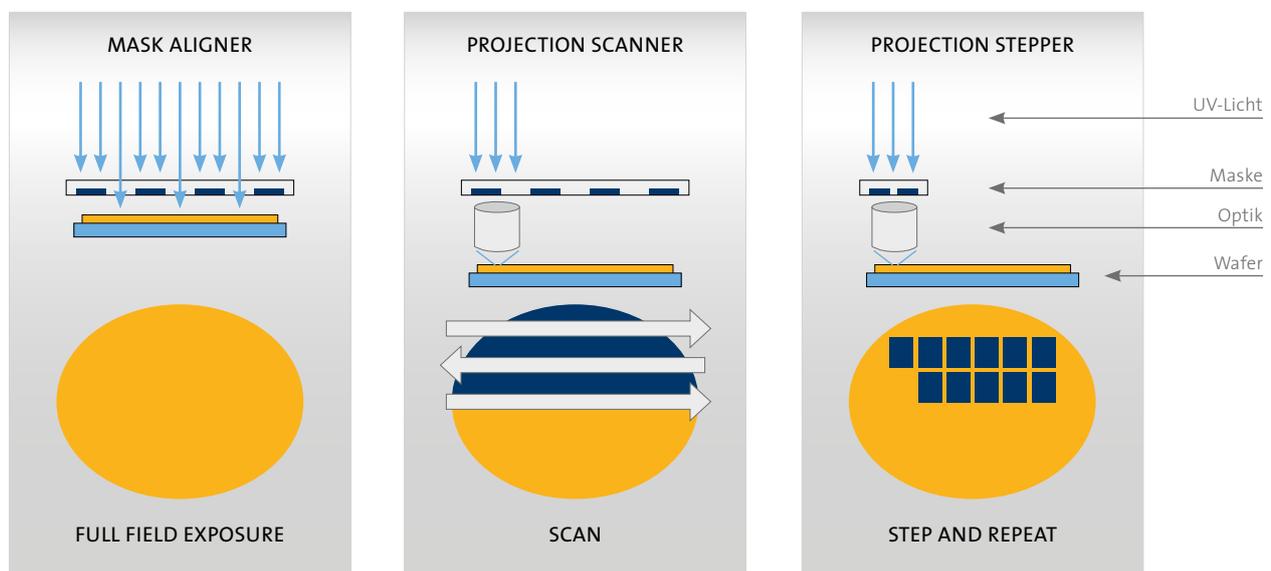
Die Laserstrukturierung ist im Midend der Halbleiterfertigung eine noch wenig genutzte, aber zukunftssträchtige Technologie. Neben Kostenvorteilen im Herstellungsprozess lassen sich auch technologische Verbesserungen realisieren. Hierzu hat Tamarack Scientific bereits vor der Akquisition durch SÜSS MicroTec erste Aufträge von führenden Industriekunden erhalten.

Die Laserstrukturierung ist im Midend der Halbleiterfertigung eine noch wenig genutzte, aber zukunftssträchtige Technologie.

Dafür werden zahlreiche Neuerungen erprobt und optimiert. Aufgrund der hohen Komplexität der Geräte liegen die Lieferzeiten derzeit noch deutlich über dem Durchschnitt herkömmlicher SÜSS MicroTec-Maschinen. Diese werden sich in Zukunft durch Serienfertigung deutlich verkürzen lassen und sich den normalen Aufbauzeiten von SÜSS MicroTec angleichen.

Durch die Übernahme von Tamarack Scientific hat SÜSS MicroTec sich zu einem führenden Anbieter von Lithografie-Lösungen für das Halbleiter Mid- und Backend entwickelt. Insbesondere bei der Belichtung bietet das Unternehmen ein so umfassendes Produktspektrum, wie es kein anderes Unternehmen weltweit anbieten kann.

VON SÜSS MICROTEC ANGEBOTENE BELICHTUNGSVERFAHREN



NOT ONE SIZE FITS ALL

Wie in allen Lebensbereichen gilt auch in der Halbleiterbranche: not one size fits all. Für SÜSS MicroTec bedeutet dies maßgeschneiderte Kundenlösungen zu entwickeln und anzubieten.

Ein sehr gutes Beispiel ist die Akquisition von Tamarack Scientific und die damit im Haus SÜSS MicroTec zusammengeführte Belichtungskompetenz.

In der Vergangenheit konnte SÜSS MicroTec seinen Kunden spezielle Lösungen rund um die Mask Aligner-Technologie anbieten. Es gibt jedoch im Halbleiter Mid- und Backend Bereiche, in denen andere Belichtungstechnologien ähnlich gute oder sogar bessere Ergebnisse erzielen. Zu diesen Anwendungen hatte SÜSS MicroTec in der Vergangenheit keine Technologie im Produktportfolio und entsprechend keinen Zugang zu diesen Applikationen. Mit der Übernahme von Tamarack Scientific hat SÜSS MicroTec ein umfassendes Knowhow-Portfolio zu den verschiedenen Belichtungstechnologien unter einem Dach zusammengeführt.

SÜSS MicroTec ist nunmehr als weltweit einziges Unternehmen in der Lage, seinen Kunden ein umfassendes Spektrum an Lithografiertechnologien und -lösungen anzubieten. Durch verschiedene Preis-/Leistungs-Punkte erhält der Kunde eine hohe Flexibilität in seiner Entscheidung zur Kosten-/Nutzenoptimierung.

Während die Mask Aligner, Scanner und Stepper-Produkte bereits lange am Markt erhältlich und weitestgehend ausgereift sind, beschreitet SÜSS MicroTec mit der neuartigen Laser-Strukturierung neue Wege mit großem Zukunftspotenzial.

FERTIGUNG VON SCHLÜSSELKOMPONENTEN IM EIGENEN HAUS

SÜSS MicroTec ist mit der Mask Aligner-Produktfamilie seit nunmehr 50 Jahren im Halbleitermarkt aktiv. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung konnte sich SÜSS MicroTec zum weltweiten Technologie- und Marktführer entwickeln. Ein Schlüssel zur weiteren Verbesserung dieser Technologie liegt im neuartigen Beleuchtungssystem der SÜSS Mask Aligner, der MO Exposure Optics.

Bei der MO Exposure Optics werden hochpräzise Mikrooptiken in dem Beleuchtungspfad eingesetzt. Die MO Exposure Optics reduziert Gleichförmigkeitsschwankungen, verbessert die Parallelität des Lichtes und erlaubt eine flexible Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Lithografie-Aufgabe. Für den Anwender bedeutet dies eine Kosteneinsparung durch den reduzierten Wartungsaufwand, eine Verbesserung der Gleichförmigkeit der Belichtung und somit eine Erhöhung der Ausbeute.

Die hochpräzisen Mikrooptiken zur Strahlformung werden von der Süss MicroOptics, einer Schweizer Tochterfirma der SÜSS MicroTec, entwickelt und hergestellt. Um die wachsende Nachfrage nach diesen Schlüsselkomponenten befriedigen zu können, wurde 2012 eine neue Mikrooptik-Fabrik in Betrieb genommen. In neuen Reinräumen Klasse 100/1'000 fertigt Süss MicroOptics in Neuchâtel, Schweiz, hochpräzise Mikrooptiken für mehr als 200 Kunden weltweit.

Die MO Exposure Optics verbessert die herkömmliche Schattenwurf-Lithografie und ist zudem die Basistechnologie für eine Advanced Mask Aligner Lithography (AMALITH). AMALITH ermöglicht SÜSS MicroTec, für spezielle Anwendungen bei MEMS, Bio-Chips, LED und Solar eine Mikrostrukturierung bis in den Bereich von einigen Hundert Nanometern herzustellen.

MO Exposure Optics und AMALITH sind aber nicht die einzigen Maßnahmen, mit denen SÜSS MicroTec sich für zukünftige Lithografie-Aufgaben rüstet. —



Die Fotomaschinenreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Frontend Lithografie-Infrastruktur.

FOTOMASKENREINIGUNG

Innovationen für die Frontend Lithografie

SÜSS MicroTec ist nicht nur im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie tätig, sondern bedient mit seinen Reinigungsgeräten für Fotomaschinen auch das Frontend der Halbleiterfertigung. Hier werden die Mikrochips, die heute maßgeblich unser Leben bestimmen, gefertigt. In der Halbleiterindustrie gilt seit vielen Jahren Moore's Law, welches im Grundsatz besagt, dass sich circa alle 18 Monate die Strukturgrößen auf den Mikrochips verringern lassen und

die Kosten pro Transistorfunktion sinken. Diese Gesetzmäßigkeit gerät derzeit an ihre ökonomischen Grenzen. Es ist zwar nach wie vor möglich, kleinere und leistungsfähigere Mikrochips herzustellen, aber der Herstellungsprozess wird zunehmend teurer, da immer anspruchsvollere Verfahren zum Einsatz gelangen. Hierbei spielt die Fotomaschine eine entscheidende Rolle, denn sie enthält die Informationen, die tausendfach mit Hilfe lithografischer

Verfahren auf die einzelnen Wafer und somit auf die Mikrochips übertragen werden. Eine fehlerhafte oder verunreinigte Maske führt in der Folge zu vielen fehlerhaften Mikrochips und damit zu hohen Ausbeuteverlusten. Aus diesem Grund ist die Maskenreinigung ein wichtiger Bestandteil der Lithografie-Infrastruktur im Frontend. Bei Maskenreinigungsgeräten für die aktuell eingesetzte 193nm Immersionslithografie hat SÜSS MicroTec einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Bei der Extrem Ultraviolet Lithografie (EUVL) der Zukunft ist SÜSS MicroTec der einzige Anbieter von Maskenreinigungsgeräten, der die hohen Ansprüche des EUVL-Umfeldes erfüllen kann.



3D-INTEGRATION

More than Moore

Vor dem Hintergrund, dass die Fortführung von Moore's Law zunehmend kostenintensiver wird, betrachten viele Experten die 3D-Integration – das Stapeln gedünnter Mikrochips – als Wendepunkt in der Herstellung von komplexen elektronischen Systemen. Mit Maschinen und Prozesslösungen unterstützt SÜSS MicroTec das Thema Thin Wafer Handling, welches bei der 3D-Integration eine entscheidende Rolle spielt. Hierbei kommen unsere Substrat Bonder zum Einsatz. Die Stärke von SÜSS MicroTec liegt dabei in der hohen Flexibilität der Systeme, deren konfigurierbare und austauschbare Module an kundenindividuelle Entwicklungsprozesse angepasst werden können. Die Vorteile für den Kunden liegen dabei auf der Hand: Prozessanforderungen und Optimierungen können auf dem gleichen Equipment implementiert werden.

Das Stapeln gedünnter Mikrochips empfiehlt sich immer dann, wenn auf kleinstem Raum mehr Komplexität erreicht werden soll. Ein weiterer Vorteil der 3D-Integration liegt unter anderem darin, funktional unterschiedliche Bauteile unabhängig voneinander in den für sie optimalen Prozessen zu fertigen und durch die 3D-Integration miteinander zu verbinden. Es bieten sich hier Anwendungen wie Speicherbausteine oder die Kombination von Speicher und Prozessoreinheit an. Aber auch hochwertige Sensorsysteme (z.B. Imagesensoren) sind adressierte Produktgruppen. Die 3D-Packaging-Technologie für Systeme ist derzeit noch nicht in der Massenfertigung im Einsatz, die Industrie arbeitet jedoch mit Hochdruck an der Einführung der Vorserienproduktion. Nach erfolgreichem Durchlauf der Vorserienproduktion mit kleinen Stückzahlen kann das Hochfahren der Volumenfertigung mit hohen Ausbeuten begonnen werden. SÜSS MicroTec hat besonders in diesem Bereich die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in den letzten Jahren deutlich erhöht, um auf diesem sehr attraktiven Wachstumsmarkt eine bedeutende Rolle spielen zu können. Erste Erfolge wurden bereits verbucht. Ein wichtiger internationaler Kunde hat Ende 2011 einen Bondcluster zur Prozessweiterentwicklung in industriellem Umfeld geordert.



Substrat Bonder ermöglichen „More than Moore“.



PROF. KLAUS-DIETER LANG
Fraunhofer-Institut für
Zuverlässigkeit und
Mikrointegration IZM,
Berlin

Das Fraunhofer IZM steht für anwendungsorientierte, industriennahe Forschung, es ist international tätig und unterstützt durch eigene Arbeiten und Industriekooperationen die internationale Technologieentwicklung auf den Gebieten der Systemintegration und des Electronic Packaging. Mitglieder des Instituts beteiligen sich in nationalen und internationalen Gremien an der Entwicklung entsprechender Rahmenbedingungen für innovative Integrationstechnologien. Dazu gehören unter anderem auch dreidimensionale Systemintegrationstechnologien, dies ist eines der Kernthemen der heutigen Aufbau- und Verbindungstechnik. Basierend auf der vertikalen Anordnung der Systemkomponenten bietet das Konzept spezifische Vorteile bezüglich der heterogenen Integration unterschiedlicher Bauteile, wie Sensoren, Prozessoren, Speichern oder Wireless-Komponenten. Durch die Erschließung der dritten Dimension ergeben sich neben kompakteren Bauformen durch Volumenreduzierung auch kürzere elektrische Verbindungswege, die erheblich zur Steigerung der Systemleistung, wie zum Beispiel der Erhöhung von Übertragungsbandbreiten beitragen können.

INVESTOR RELATIONS

Die erfolgreiche Verabschiedung der Rettungspakete auf europäischer und internationaler Ebene sowie leichte Signale einer konjunkturellen Belebung haben am Jahresanfang 2012 zu einer Entspannung an den Finanzmärkten geführt. Dies hat teilweise zu deutlich steigenden Aktienkursen geführt. Heute müssen wir feststellen, dass sich die Situation im Vergleich zu 2011 grundsätzlich kaum merklich verändert hat.

In der Zwischenzeit sind diverse Rettungspakete geschnürt worden und im Herbst 2012 ist der permanente Euro-Stabilitätsmechanismus ESM in Kraft getreten. Eine dauerhafte Lösung der europaweiten strukturellen Krise ist jedoch weiterhin nicht in Sicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Weltkonjunktur in Mitleidenschaft gezogen wird, ist nach wie vor groß. Diese Entwicklung spiegelt sich auch am Kapitalmarkt und hier insbesondere bei der Entwicklung der Aktienkurse wider. Ein hohes Maß an Unsicherheit und Volatilität beherrscht weiterhin die Kapitalmärkte. Weitere Informationen zur Kursentwicklung, der Aktionärsstruktur sowie der Investor Relations-Arbeit bei SÜSS MicroTec erhalten Sie in diesem Kapitel.

DIE KAPITALMÄRKTE SIND WEITERHIN VON GROSSER UNSICHERHEIT GEPRÄGT

Die positive Stimmung der Finanz- und Kapitalmärkte, die noch 2010 vorherrschte und enorme Kursgewinne verursacht hat, ist bereits 2011 einer großen Unsicherheit über die Konjunkturaussichten für die kommenden Jahre und insbesondere über die Zukunft der Eurozone gewichen. Daran hat sich auch im Verlauf des Geschäftsjahres 2012 nichts geändert, wobei zum Jahresende eine Aufhellung der Stimmung zu verzeichnen war. Alle wichtigen Indices in Deutschland haben schlussendlich das Börsenjahr mit einem soliden Plus beendet. Der Dax hat das Börsenjahr 2011 mit 5.898,35 Punkten beendet und schloss ein Jahr später im Dezember 2012 bei 7.612,39 Punkten. Dies entspricht einem Plus von rund 29 Prozent. Der MDAX hat auf Jahressicht sogar rund 34 Prozent gewonnen. Auch der TecDAX hat sich im gleichen Betrachtungszeitraum von 685,06 Punkten im Dezember 2011 auf 828,11 Punkte im Dezember 2012 verbessert, dies entspricht einem Plus von rund 21 Prozent.

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE

Nach einem bewegten vierten Quartal 2011 hat die SÜSS MicroTec-Aktie das Geschäftsjahr 2012 mit einem XETRA-Schlusskurs von 5,83 Euro am 2. Januar begonnen. Im ersten Quartal 2012 hat sich der Kurs der Aktie zwischenzeitlich fast verdoppelt und konnte erneut die Zehn-Euro-Marke überschreiten. Die SÜSS MicroTec-Aktie hat das erste Quartal 2012 schließlich mit einem Kurs von 10,76 Euro, was einem Plus von mehr als 90 Prozent gegenüber Jahresanfang 2012 entspricht, beendet. Im April 2012 wurde dieser allgemeine positive Aufwärtstrend durchbrochen. Die Kurse der Vergleichsindices TecDAX und Prime IG Semiconductor zeigten im zweiten Quartal kontinuierliche Kursverluste. Diesem Trend konnte sich auch die SÜSS MicroTec-Aktie nicht entziehen und musste deutliche Kursverluste im Vergleich zum ersten Quartal hinnehmen. Zu Beginn des dritten Quartals vollzog die SÜSS MicroTec-Aktie eine, von hoher börsentäglicher Volatilität geprägte, Seitwärtsbewegung. Im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals ist der Aktienkurs im weiteren Verlauf des dritten Quartals weiter gefallen, hat sein Plus gegenüber dem Jahresanfang jedoch halten können und beschloss das dritte Quartal insgesamt mit einem Plus in Höhe von 28 Prozent gegenüber dem 2. Januar 2012. Im vierten Quartal hat die Aktie, unterstützt durch das zusätzliche Aktien-Research, eine Trendwende vollzogen und

konnte den Abwärtskanal verlassen. Insgesamt hat unsere Aktie das Geschäftsjahr 2012 mit einem Kurs von 8,44 Euro, was einem Plus von rund 50 Prozent gegenüber Jahresende 2011 entspricht, abgeschlossen.

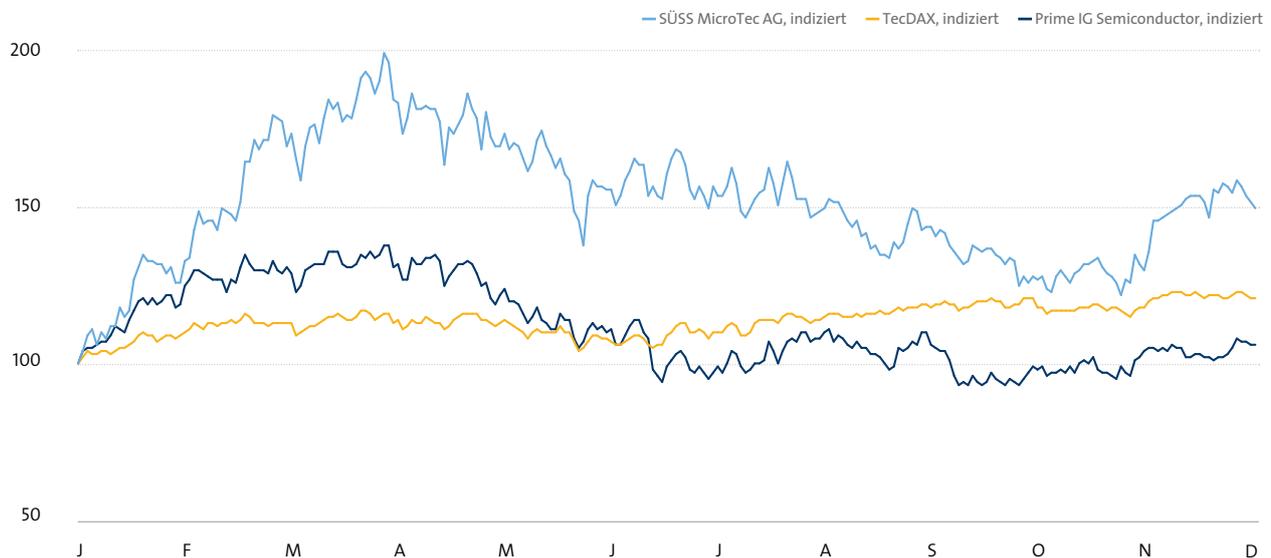
Die beiden Referenzindizes TecDAX und Prime IG Semiconductor haben sich 2012 unterschiedlich entwickelt. Der TecDAX hat das Jahr mit einem Plus von rund 21 Prozent beendet, wohingegen der Prime IG Semiconductor insgesamt nur ein Plus von rund 6 Prozent verzeichnet hat. Somit hat sich die SÜSS MicroTec-Aktie 2012 deutlich besser als die beiden Referenzindizes entwickelt.

Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt an allen deutschen Börsenplätzen gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien verringerte sich 2012 und lag für das Gesamtjahr bei 116.790 Stück (Vorjahr: durchschnittlich 261.090 Aktien pro Tag). Hierbei ist zu beachten, dass im ersten Quartal 2011 im Vorfeld der Aufnahme in den TecDAX außerordentlich hohe Handelsvolumina zu verzeichnen waren.

Einen Überblick über den Kursverlauf im Jahr 2012 bietet die folgende grafische Darstellung.

DIE KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTEC-AKTIE 2012

(Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2012: 5,83 €)



VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON SÜSS, TECDAX UND PRIME IG SEMICONDUCTOR IM GESCHÄFTSJAHR 2012

	30.12.2011	30.12.2012	Veränderungen
TecDAX	685	828	+21 %
Prime IG Semiconductor	115	122	+6 %
SÜSS MicroTec	5,63	8,44	+50 %

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennnummer	A1K023
ISIN-Nummer	DE000A1K0235
Reuters-Kürzel	SMHN
Bloomberg-Kürzel	SMHN:GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2012)	19.115.538
Wertpapiergattung	Namensaktien
Designated Sponsor	equinet Bank AG Close Brothers Seydler
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs- / -schlusskurs in €	5,83 / 8,44
Jahreshoch- / tief in €*	11,23 / 5,83

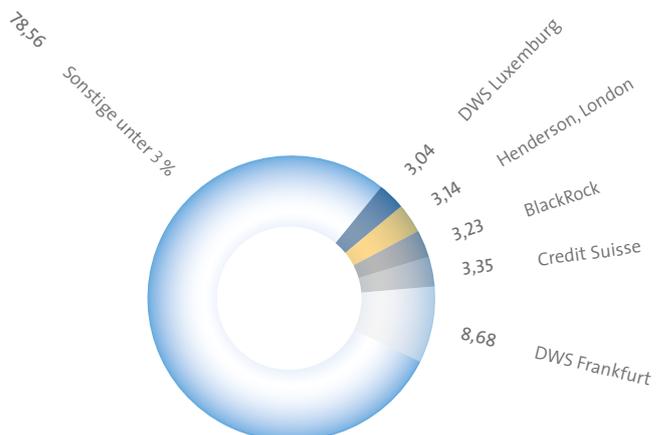
* XETRA Schlusskurs

NAMENSAKTIE HABEN SICH BEWÄHRT

Die Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG hatte am 21. Juni 2011 die Umwandlung der nennwertlosen Inhaberaktien auf Namensaktien beschlossen, welche schließlich zum 12. September 2011 erfolgte. Rückblickend lässt sich aus heutiger Sicht festhalten, dass die Umstellung auf Namensaktien mehr Transparenz bei der Analyse der Aktionärsstruktur geschaffen hat. Der Einladungs- und Anmeldeprozess im Vorfeld zur Hauptversammlung wurde deutlich verschlankt und beschleunigt. Weitere Informationen zum Thema Namensaktie finden Sie auf unserer Internetseite unter www.suss.com > Investor Relations.

AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2012

in %



INVESTOR RELATIONS-AKTIVITÄTEN WEITERHIN MIT INTERNATIONALEM FOKUS

Die Investor Relations-Arbeit umfasst alle Maßnahmen, die der Pflege der Beziehungen eines börsennotierten Unternehmens zu den (potenziellen) Investoren dienen. Mit anderen Worten geht es bei der IR-Arbeit unter anderem darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informationen über das Unternehmen zu versorgen und somit eine angemessene Bewertung der Aktie an der Börse zu gewährleisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den direkten Ansprechpartnern gehören beispielsweise Privataktionäre, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhäusern und natürlich auch die Finanzpresse.

Dieser Aufgabe fühlt sich auch der Vorstand der SÜSS MicroTec AG verpflichtet. So besuchten Vorstand und Investor Relations 2012 insgesamt zehn Kapitalmarktkonferenzen, darunter waren sechs internationale Konferenzen, und absolvierten elf Roadshows.

Die Kapitalmarktkonferenzen fanden beispielsweise in München, Frankfurt, Zürich, Paris, Las Vegas und New York statt. Zusätzlich dazu wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

ANALYSTEN RESEARCH ERWEITERT

Mit der DZ Bank AG, der Warburg Research GmbH, der equinet Bank AG, Close Brothers Seydler Research AG und Hauck & Aufhäuser Institutional Research AG haben fünf Researchhäuser ihre Berichterstattung des Vorjahres fortgesetzt. Im September und November 2012 kam weitere Coverage durch die Baader Bank AG, Unterschleißheim sowie Cheuvreux, Frankfurt hinzu. Im Dezember 2012 hat darüber hinaus die Deutsche Bank, Frankfurt die Coverage aufgenommen. Im Dezember 2012 haben sechs von acht Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen. Eine Übersicht über aktuelle Researchstudien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter www.suss.com > Investor Relations.

HAUPTVERSAMMLUNG

Am 20. Juni 2012 fand die ordentliche Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Die Aktionäre haben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung präsentierten, gegeben. Insgesamt waren mehr als 100 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit lag die Besucherzahl auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Auf der Hauptversammlung waren mehr als 29 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend.

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 und der Bestellung eines neuen Abschluss- und Konzernabschlussprüfers stand die turnusmäßige Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats an. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Dr. Stefan Reineck, Jan Teichert und Gerhard Pegam, wurden in ihrem Amt bestätigt und für eine weitere Amtsperiode in den Aufsichtsrat gewählt.

CORPORATE GOVERNANCE

bei SÜSS MicroTec

Eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle der Unternehmen – dafür steht der Begriff Corporate Governance. SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex, der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden sie in dem nachfolgenden Bericht.

CORPORATE GOVERNANCE IM ÜBERBLICK

Mit der Zielsetzung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen, hat die Corporate Governance einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben sich Geschäftsjahr 2012 erneut intensiv mit diesem Thema auseinander gesetzt. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter www.suss.com > Corporate Governance.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (DCGK)

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben am 29. Mai 2012 gem. §161 Abs. 1 AktG folgende Entsprechenserklärung abgegeben:

„Die SÜSS MicroTec AG hat den Empfehlungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 28. Juli 2011 mit den folgenden fünf Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Briefwahl, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen und wird ihnen mit diesen fünf Ausnahmen entsprechen:

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.2 allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege zu übermitteln, sofern die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind. SÜSS MicroTec übermittelt die Einberufung nebst Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege nur den Aktionären, Aktionärsvereinigungen und Finanzdienstleistern, die dies verlangen. Eine automatische elektronische Übermittlung an alle in Ziffer 2.3.2 Genannten erfolgt nicht. Nach der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien

hat die Gesellschaft die Möglichkeit der automatischen elektronischen Übermittlung der Einberufung nebst Einberufungsunterlagen zur Hauptversammlung geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dies trotz Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht zu tun. Die derzeitige Aktiönärsstruktur von SÜSS MicroTec weist einen sehr hohen Anteil an Privataktionären auf, deren E-Mailadressen der Gesellschaft nicht bekannt sind. Daher kann auf einen Postversand nicht vollständig verzichtet werden. Ein paralleler elektronischer und postalischer Versand ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, da die damit verbundenen Kosten in keinem Verhältnis zu dem Nutzen stehen.

BRIEFWAHL

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.3 Satz 2, dass die Gesellschaft die Aktionäre bei der Briefwahl unterstützen soll. Die durch das ARUG eröffnete Möglichkeit der Briefwahl ist noch mit zahlreichen rechtlichen und praktischen Problemen behaftet. Vor diesem Hintergrund und in Ansehung des mit der Briefwahl verbundenen administrativen Aufwands sowie der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf elektronischem Weg zu bevollmächtigen, verzichtet SÜSS MicroTec einstweilen auf die Anwendung dieser Empfehlung.

SELBSTBEHALT BEI D&O-VERSICHERUNGEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

VERGÜTUNG VON AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN

In Ziffer 5.4.6 Absatz 2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 19 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor. Nach Ansicht der Gesellschaft wird das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats durch Vereinbarung einer erfolgsorientierten Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich gefördert.“

Mit Inkrafttreten der Neufassung des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ vom 15. Mai 2012 durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 15. Juni 2012 sind die Abweichungen zur Briefwahl und zur erfolgsorientierten Vergütung von Aufsichtsräten entfallen, da die entsprechenden Empfehlungen in der neuen Fassung des Kodex nicht mehr enthalten sind.

Im Hinblick auf die Änderungen in Ziffer 5.4.1 des Kodex hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2012 die konkreten Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats neu gefasst. Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem am 15. Januar 2013 eine Entsprechenserklärung auf der Grundlage des Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 abgegeben und über die oben bereits wiedergegebenen, nunmehr noch maßgeblichen drei Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen – hinaus folgende Abweichung von dem Kodex in der Fassung vom 15. Juni 2012 erklärt:

„ZIELE FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 die Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei der Benennung der konkreten Ziele sollen unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigt werden. Insbesondere sollen die konkreten Ziele eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen. Seit der Neufassung des DCGK vom 15. Mai 2012 wird zudem die konkrete Angabe der angestrebten Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder empfohlen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese Ziele beachten. SÜSS MicroTec sieht von einer konkreten Zielsetzung und Quoten im vorgenannten Sinn ab. Aus Sicht der SÜSS MicroTec ist die Qualifikation von den Aufsichtsratskandidaten maßgebliches Kriterium für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats und damit die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei den Vorschlägen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unterstützt und berücksichtigt die SÜSS MicroTec die in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 DCGK genannten Kriterien, sieht aber konkrete Zielvorgaben oder Quoten nicht als sinnvoll an.“

KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec verfolgt den Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt sowie zeitnah zu informieren und dabei größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten. Dazu nutzt das Unternehmen neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten die Möglichkeit von Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows sowie die Website, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter www.suss.com > Investor Relations neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereit gestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews

im Video- oder Audioformat frei einsehen bzw. abrufen. Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG können sich unsere Aktionäre mit Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. Wir bereiten die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der Investor Relations-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, ihnen die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SÜSS MicroTec dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – zum Beispiel Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt und es wurden keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Herrn Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2012 nicht. Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2012 nicht auf.

ZIELE UND KRITERIEN ZUR BESETZUNG DES AUFSICHTSRATES DER SÜSS MICROTEC AG

Da der Deutsche Corporate Governance Kodex zum 15. Mai 2012 neugefasst wurde, hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2012 die mit Blick auf Ziff. 5.4.1 des Kodex festgelegten Ziele für seine Zusammensetzung angepasst und wie folgt neu beschlossen:

„Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der SÜSS MicroTec AG ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstandes auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.“

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrates, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Verbindungen vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von erfolgreichen Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrates beitragen. Dazu gehören Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inkl. Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarkt-kommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation und bewertet die Aufsichtsratsbesetzung in regelmäßigen Abständen.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrates sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen, ohne dass Aufsichtsrat und Vorstand die Festschreibung einer Quote derzeit für sinnvoll halten. Auch die Festlegung einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Mindestzahl von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern halten Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der Größe des Aufsichtsrates nicht für sinnvoll, um das künftige Auswahlermessen bei der Besetzung von Aufsichtsratspositionen nicht zu stark einzuschränken.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren.

Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrates vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativverklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potentiellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen für Aufsichtsrat und Vorstand zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrates.“

Zum Stand der Umsetzung ist folgendes zu berichten: Der Aufsichtsrat bewertet die Besetzung des Aufsichtsrats bezüglich der gesetzten Ziele und der aktuellen Unternehmenssituation als angemessen. Insbesondere verfügt der Aufsichtsrat über eine ausreichende Zahl an unabhängigen Mitgliedern. Die Anforderungen von § 100 Abs. 5 AktG an ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats, das über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt, werden insbesondere von Herrn Jan Teichert erfüllt.

ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und deren Mandate:

Frank Averdung

- VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
- IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

Michael Knopp

Dr. Stefan Reineck

- AttoCube Systems AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR / USA (Mitglied im Board of Directors)
- Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchartd (Geschäftsführender Gesellschafter)

Jan Teichert

- Einhell Germany AG (Mitglied des Vorstands)

Gerhard Pegam

- GPA Consulting GmbH, Au bei Bad Aibling (Geschäftsführender Gesellschafter)
- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

Mandate bis 31. Januar 2012:

- Vorstandsvorsitzender EPCOS AG, München
TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan
(Mitglied des Board of Directors)
sowie folgende Tochtergesellschaften der EPCOS AG (bis 31. Januar 2012):
 - EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors)
 - EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors)
 - EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors)
 - EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA (Vorsitzender des Board of Directors)

- Becromal S.p.A., Mailand, Italien
(Vorsitzender des Board of Directors)
- Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island
(Vorsitzender des Board of Directors)

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat es keine Veränderung im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG gegeben.

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

Die im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2012 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber 31.12.2011	Anzahl der Aktien- optionen zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber 31.12.2011
Aufsichtsrat				
Dr. Stefan Reineck	9.600	-	0	- 40.000
Jan Teichert	0	-	0	-
Gerhard Pegam	0	-	0	-
Vorstand				
Frank Averdung	83.200	+ 1.200	0	-
Michael Knopp	22.500	- 12.500	0	-41.400

MELDEPFLICHTIGE AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach §15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Sämtliche Geschäfte des Vorstands und des Aufsichtsrats werden auf der Website des Unternehmens unter www.suss.com > Investor Relations > Die Aktie > Directors Dealings veröffentlicht.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 20. Juni 2012 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2012 die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB ist Bestandteil des Lageberichts und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/erklarung-zur-unternehmensfuehrung.html allgemein zugänglich gemacht.

VERGÜTUNGSBERICHT

Die Grundzüge des Vergütungssystems haben wir im Vergütungsbericht dargestellt, der im zusammengefassten Lagebericht abgedruckt ist.

ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2012

035 Geschäft und Rahmenbedingungen

- 035 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
- 037 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
- 037 Forschung und Entwicklung
- 040 Überblick über den Geschäftsverlauf

046 Ertrags-, Finanz-, und Vermögenslage

- 046 Ertragslage
- 049 Finanz- und Vermögenslage
- 052 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
- 052 Investitionen
- 052 Die Holding – SÜSS MicroTec AG

054 Rechtliche Angaben

- 054 Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

056 Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

056 Vergütungsbericht

- 056 Vergütung des Vorstands
- 059 Vergütung des Aufsichtsrats

059 Nachtragsbericht

- 059 Stimmrechtsmitteilungen nach dem Stichtag

060 Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

- 060 Risikomanagement-System
- 062 Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken
- 063 Betriebliche Risiken
- 064 Finanzmarktrisiken

066 Prognosebericht

- 067 Halbleiterindustrie
- 068 Halbleiter-Equipment-Industrie
- 068 Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten
- 069 Endogene Indikatoren
- 070 Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

070 Vorausschauende Aussagen

Geschäft und Rahmenbedingungen

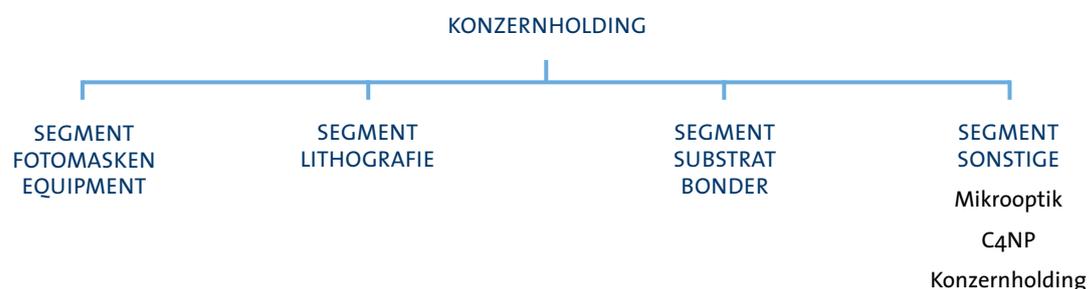
KONZERNSTRUKTUR UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND GESCHÄFTSFELDER

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-systemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeits-schwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

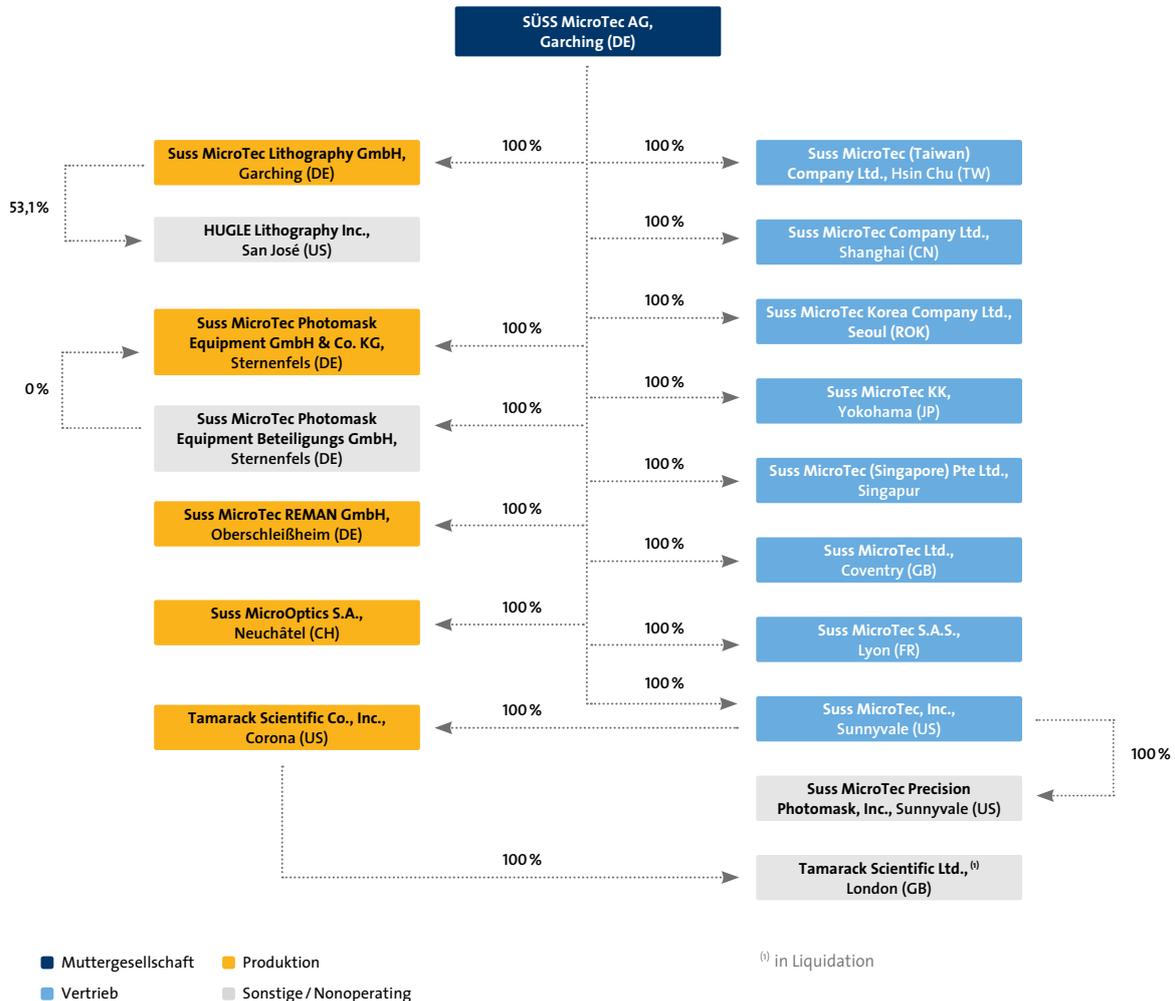
Der Konzern ist zum 31. Dezember 2012 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfirmierung: Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. ist im Segment Lithografie angesiedelt.



RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfügige Beteiligung von zehn Prozent an der ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT). Diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft.



LEITUNG UND KONTROLLE

Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß §19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500€ pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000€, sein Stellvertreter 40.000€ und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000€ pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunfts-trächtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Mit jeder neuen Produktgeneration erhöhen die Hersteller von elektronischen Endgeräten, wie Smartphones oder Tablet-PCs, die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte, während der Preis stabil bleibt oder sogar sinkt. Der wichtigste Treiber dieser Entwicklung ist die Halbleiterbranche, die Jahr für Jahr kleinere und gleichzeitig bessere Mikrochips auf den Markt bringt. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit auf immer kleinerem Raum umzusetzen erfordert eine stetige Weiterentwicklung der Fertigungstechnologien und damit hohe Investitionen sowie einen hohen Aufwand an Forschung und Entwicklung. Neben der stetigen Verkleinerung der Strukturgrößen sind die massentaugliche Einführung der EUV-Lithografie, der Einsatz von 450 mm Wafern und das Stapeln gedünnter Mikrochips – die 3D-Integration – wichtige Entwicklungsthemen in der Halbleiterbranche. SÜSS MicroTec beteiligt sich in seinen Anwendungsgebieten aktiv an der Weiter- und Neuentwicklung von Maschinen und Prozessen, die eine weitere Leistungssteigerung der Endprodukte unterstützen. Im Folgenden haben wir eine Übersicht über unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 2012 nach Segmenten zusammengestellt.

LITHOGRAFIE

Das größte Segment, die Lithografie, vereinigt die Produktlinien Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing und die Coater / Developer.

Der Mask Aligner, ein sehr erfolgreiches Produkt von SÜSS MicroTec, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Trotz des Alters der Mask Aligner-Technologie sind auch hier Weiterentwicklungen möglich und vom Kunden gewünscht. Bei der MA150e wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Reihe von Verbesserungen durchgeführt, um beispielsweise den Durchsatz zu erhöhen oder die Bildverarbeitung durch Einsatz eines neuen Standards zu verbessern.

Im Rahmen des europäischen Projektvorhabens JEMSIP3D wurde ein Prototyp eines neuartigen 12 Zoll Mask Aligners fertiggestellt.

Im Bereich Coater/Developer hat SÜSS MicroTec mit der ACS200 Gen3 die nächste Generation der 200mm Plattform für Hochvolumenproduktion eingeführt. Das System ist sehr flexibel konfigurierbar und hat durch die hohe Anzahl an Modulen auf kompaktem Raum das beste Verhältnis von Cost of Ownership zu Footprint seiner Klasse. Die vier Module können auf bis zu 19 Hotplates erweitert werden, das Vorgängermodell konnte lediglich auf maximal sieben Hotplates ausgebaut werden. Dazu enthält die ACS200 Gen3 ein neues Coater Modul, das auf hohe Performance mit geringen Reinigungszeiten getrimmt ist und somit die konsequente Weiterführung unseres Fokus auf Optimierung der Cost of Ownership darstellt. Zielmärkte sind vor allem das Advanced Packaging in der Großvolumenfertigung, aber auch der MEMS- und der LED-Markt. Die ACS200 Gen3 vereint die beiden bisherigen Plattformen ACS200Plus und GAMMA.

Zudem wurde die Plattform ACS200 GEN3 um das sogenannte Taiko Wafer Handling erweitert. Es ermöglicht die Prozessierung von Taiko Wafern auf unseren automatischen 300 mm Coater/Developer-Geräten. Diese Wafer finden vor allem im Bereich von Power Devices Anwendung. Taiko Wafer sind in der Mitte gedünnte Wafer, wobei die in der Mitte entstehende Membran bis zu 50 µm dünn sein kann. Durch den in Originaldicke belassenen Waferrand, hat der Wafer noch immer eine sehr hohe Stabilität. Zusätzlicher Vorteil dieser Wafer ist, dass beim Handling keine Kantenausbrüche entstehen.

Mit der RCD8 hat SÜSS MicroTec eine neue manuelle Geräteplattform zum Belacken und Entwickeln von Substraten entwickelt. Eine hohe Flexibilität in den Anwendungsbereichen bei gleichzeitig niedrigen Investitionskosten zeichnet die neue Plattform aus. Die RCD8 bietet derzeit als einziges System im Markt die Möglichkeit, es innerhalb von wenigen Minuten von einem Spinbelacker – mit unserer patentierten GYRSET®-Technologie – zu einem Sprühentwickler umzurüsten. In der Vergangenheit wurden dedizierte Geräte der Delta-Serie zum Belacken und Entwickeln in den Segmenten MEMS, LED, Advanced Packaging und der Forschung und Entwicklung eingesetzt. Diese unterschiedlichen Geräte werden nun in der neuen RCD8-Plattform vereint. Sie deckt alle notwendigen Belackungs- und Entwicklungsschritte bei den verschiedenen Anwendungsgebieten ab.

Abschließend sei hier noch die Entwicklung eines manuellen 300 mm Tapeframe-Reinigers zu nennen. Die Besonderheit hierbei ist eine Reinigungskammer, in der sowohl Lösungsmittel als auch Säuren und Basen prozessiert werden können. Dieses neue Produkt ermöglicht die Prozessevaluierung im Bereich temporäres Bonden.

SUBSTRAT BONDER

Produkt- und Prozesseinführungen sowie Weiterentwicklungen schaffen die Grundlage für das zukünftige Wachstum der Bonder Division. Technologisch setzt SÜSS MicroTec bei den temporären Bond- und Debond-Systemen für die 3D-Massenfertigung auf die zukunftsweisenden Raumtemperatur-Debondprozesse. SÜSS MicroTec ist laufend in Gesprächen mit bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern, um das Angebot an Bond- und Debondprozessen sinnvoll zu erweitern.

Die neueste Entwicklung von Bonding-Geräten, die XBC300 Gen2, kann für das permanente Bonden von Wafern oder für das Debonden und Reinigen von 200 mm und 300 mm Wafern konfiguriert werden. Die universell einsetzbare Geräteplattform ist mit verschiedenen Prozessmodulen ausgestattet und kann für alle gängigen permanenten Bondverfahren sowie mechanischen Debondverfahren bei Raumtemperatur und für die dazugehörigen Reinigungsprozesse in der 3D-Integration und beim 3D-Packaging eingesetzt werden. Auf der XBC300 Gen2 können permanente Bondprozesse mit hoher Bondkraft durchgeführt werden, wie beispielsweise Cu-Cu Bonden, Polymer- und Fusionsbonden sowie hybride Bondprozesse.

Zudem kann die XBC300 Gen2 als Debonder und Reinigungsgerät konfiguriert werden, dann dient sie als komplementäres Gerät zu der XBS300. Die Wafer mit den aktiven Strukturen werden in der XBS300 temporär auf einen Trägerwafer gebondet, um nach Durchführung aller Prozessschritte der Rückseitenbearbeitung in der XBC300 Gen2 wieder vom Trägerwafer getrennt (debonded) und gereinigt zu werden.

Für den CBC200 Bonder, welcher hauptsächlich für den MEMS- und den LED-Markt eingesetzt wird, wurde eine vollständig geschlossene Fixture sowie eine mechanische Zentrierstation entwickelt. Diese ermöglicht eine Alignment-Genauigkeit von $50\text{ }\mu\text{m}$, kommt somit ohne einen separaten Bond Aligner aus und bedient den Bedarf an optimierten Bondkonzepten für eine 100%-Ausbeute bei LED-Bonds. Das System bietet eine kostengünstige und durchsatzstarke Lösung für den LED-Markt.

Mit einem wichtigen asiatischen MEMS-Kunden wurde darüber hinaus auf der CBC200 ein Projekt zur Prozessoptimierung für eutektisches Bonden von MEMS erfolgreich abgeschlossen. Das System erwirtschaftet herausragende Ergebnisse im Hinblick auf Ausbeute und Leistung. Die fortschreitende Miniaturisierung sowie die weiter steigenden Anforderungen an MEMS-Bausteine beflügeln den Bedarf nach metallischen Bondverfahren bei der MEMS-Herstellung.

FOTOMASKEN EQUIPMENT

Die Innovationen im Bereich der Maskenherstellung sowie deren Verwendung im Halbleiter Frontendbereich sind getrieben sowohl von den Anforderungen der ITRS-Roadmap der Halbleiterindustrie (International Technology Roadmap for Semiconductors) als auch von den spezifischen Anforderungen der großen Hersteller von elektronischen Schaltkreisen und Speicherbauelementen. Immer kleinere Strukturen und eine immer höhere Integrationsdichte verlangen stets die Erweiterung bestehender als auch die Entwicklung neuer Lithografie-Technologien. Die 193 nm Immersionslithografie, basierend auf der Verwendung optischer Transmissionsmasken sowie die EUV-Lithografie, die hochempfindliche reflektierende Masken verwendet, sind dabei die beiden Technologien, die die Entwicklungen im Markt vorantreiben. Infolgedessen müssen auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie der Fotomaskenreinigung, eine der Kernkompetenzen von SÜSS MicroTec, angepasst werden. Die Erweiterbarkeit und

Flexibilität dieser Prozess- und Anlagentechnologien ist dabei ein wesentliches Kriterium und muss mehrere Technologieknoten abdecken.

Um im Bereich der EUV-Lithografie und der damit verbundenen Anforderung nun auch die Rückseite der Fotomaske vor jeglicher Beschädigung und Verschmutzung zu schützen, wurde bereits 2011 mit MaskTrackPro InSync ein Automationssystem eingeführt, welches zu dem Dual-Pod-System kompatibel ist. In dieses Pod-System wird die EUV-Maske nach erfolgter Reinigung zurückgelegt, bevor sie erneut in den EUV-Scanner gelangt. Daher ist vorab noch die Verifizierung der Reinheit durch eine entsprechende Rückseiteninspektion notwendig. Mit der Integration und vollständigen Qualifizierung des SPARK-RIM-Inspektionssystems innerhalb des MaskTrackPro InSync, wurde ein weiterer wesentlicher Schritt zur Unterstützung der gesamten EUVL-Infrastruktur und -Logistik geschaffen. Eine optimale Auswertung der Defektdaten mit entsprechender Bewertung für eine gegebenenfalls erneut notwendige Reinigung wurde durch eine zusätzliche eigens entwickelte Software zur Datenanalyse erreicht, die in dieser Form selbst bei deutlich teureren Vorderseiteninspektionsgeräten nicht zu finden ist.

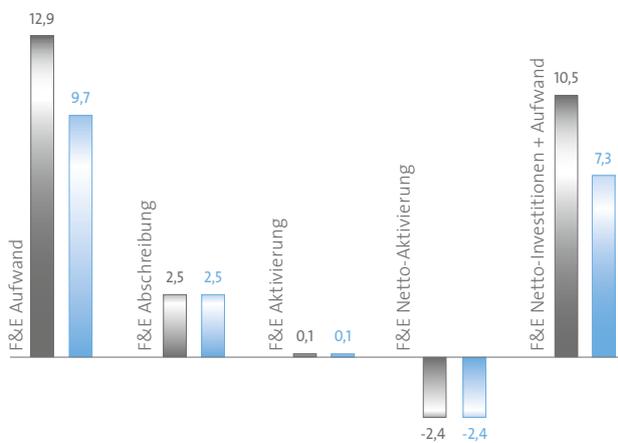
Durch die Einführung von neuen Reinigungsmedien 2012, wurden neue Prozesse sowohl für EUV-Lithografie als auch insbesondere für die 193i Technologieknoten 22 nm qualifiziert. Hierdurch wird eine weitere Reduzierung der Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften und der Beschädigung der Strukturen auf den Masken erzielt.

Mit diesen Entwicklungen stellt SÜSS MicroTec die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplettlösungen für die EUV Lithografie und 193i Technologie anzubieten.

Um ein umfassendes Bild über die finanziellen Auswirkungen unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu geben, sind in der folgenden Tabelle die relevanten Positionen aufgelistet. Auch in diesem Berichtsjahr übertrafen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte den Aktivierungsbetrag. Dies hat zu einer Nettobelastung der Gewinn- und Verlustrechnung von 2,4 Mio. € geführt (Vorjahr: 2,4 Mio. €).

F&E AUSGABEN IM JAHRESVERGLEICH in Mio €

2011 2012



F&E MITARBEITER

2011 2012



ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Im Verlauf des Jahres 2012 hat die gut ins Jahr gestartete Konjunktur in Deutschland mehr und mehr an Fahrt verloren, so dass im vierten Quartal voraussichtlich ein leichter Rückgang zu verzeichnen sein wird. Insgesamt wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,7% gegenüber dem Vorjahr erwartet. Auch die Weltkonjunktur hat sich seit Jahresmitte 2012 zunehmend abgekühlt und deutlich an Dynamik verloren. Insgesamt rechnen Experten mit einem Wachstum der Weltwirtschaft 2012 von 2,4%, wobei die Schwellenländer mit rund 5,0% deutlich stärker als die fortgeschrittenen Länder mit 1,2% gewachsen sein dürften (Quelle: ifo Institut München).

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Im Dezember 2012 hat das Marktforschungsinstitut Gartner für das gesamte Halbleitersegment einen Rückgang um rund 3% gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt, dies würde einem Marktvolumen von 298 Mrd. USD entsprechen. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts semi war die erste Jahreshälfte 2012 von einem soliden Orderverhalten im Halbleiter Equipment-Bereich gekennzeichnet. Die zweite Jahreshälfte verzeichnete dagegen ein deutlich verlangsamtes Bestellverhalten, Grund dafür war erneut die makroökonomische Verunsicherung vieler Kunden. Für 2012 wird insgesamt ein Rückgang der Nachfrage nach Halbleiter Equipment um rund 15% erwartet.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Die SÜSS MicroTec-Gruppe hat trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 absolviert. Sie erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 163,8 Mio.€ (Vorjahr: 175,4 Mio.€). Der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 9,9% auf 157,2 Mio.€ gestiegen (Vorjahr: 143,1 Mio.€).

Aufgrund des Umsatzrückgangs und des ungünstigeren Produktmix verzeichnete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012 ein geringeres Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 11,7 Mio. €. Im Vorjahr betrug das EBIT 18,6 Mio. €. Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2012 auf 36,6 Mio. €. Die Nettoliquidität lag zum Jahresende 2012 bei 32,3 Mio. € (Vorjahr: 42,0 Mio. €). Der Freie Cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf -4,5 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 86,5 Mio. € und lag aufgrund des verbesserten Auftragseingangs leicht über dem Vorjahresniveau von 83,7 Mio. €.

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich 2012 auf 0,96 nach 0,82 im Vorjahr.

UMSÄTZE UND AUFTRAGSLAGE IN DEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

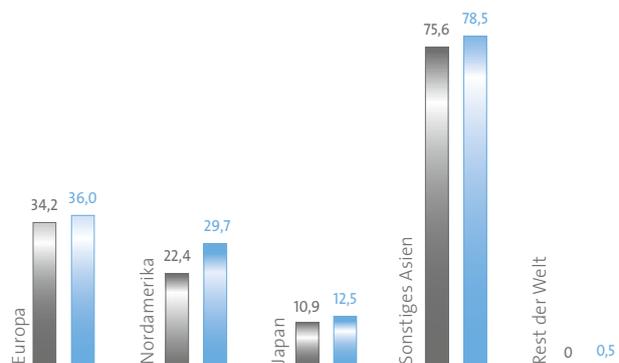
Auftragseingänge nach Regionen

Die Auftragseingänge haben sich trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage gut entwickelt, obwohl die Verunsicherung der Unternehmen und Konsumenten durch die Schuldenkrise in Europa 2012 erneut zu einem vorsichtigen Orderverhalten geführt hat. Laut Aussage des VDMA ist darüber hinaus die wirtschaftliche Expansion in Asien ins Stocken geraten. In China gesellte sich zu der 2011 bewusst eingeleiteten wirtschaftlichen Abschwächung eine schwache Exportnachfrage. Das chinesische Wirtschaftswachstum betrug daher „nur“ 7,8%, 2,5%-Punkte weniger als 2011. Die speziell auf Kundenbedürfnisse und wachstumsstarke Märkte ausgerichteten Produkte, haben sich jedoch auch in diesen schwierigen Zeiten bewährt und SÜSS MicroTec konnte im Vergleich zum Vorjahr in allen Regionen steigende Auftragseingänge verbuchen.

In Europa erhöhte sich der Auftragseingang um rund 5% auf 36,0 Mio. € nach 34,2 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete einen Anstieg um 33% im Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2012 Aufträge in Höhe 29,7 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €). Die Region Japan verzeichnete im Jahr 2012 einen Auftragseingang von 12,5 Mio. €, was ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. In der wichtigsten Region Sonstiges Asien (ohne Japan) erreichte die SÜSS MicroTec-Gruppe ein Auftragsplus in Höhe von 4% auf 78,5 Mio. € (Vorjahr: 75,6 Mio. €).

AUFTRAGSEINGÄNGE NACH REGIONEN in Mio €

2011 2012

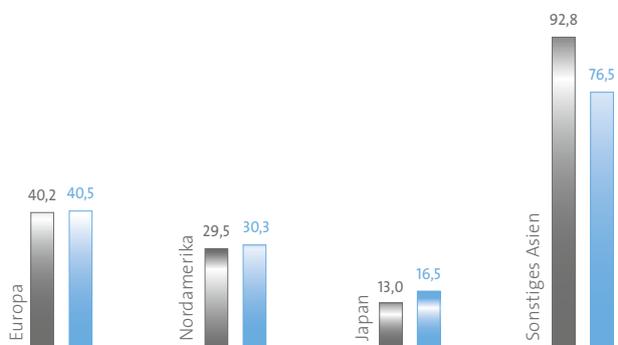


Umsätze nach Regionen

Alle Regionen, mit Ausnahme der Region Sonstiges Asien, konnten im Vergleich zum Vorjahr im Umsatz zulegen. In Europa erhöhte sich der Umsatz um rund 1% auf 40,5 Mio.€ nach 40,2 Mio.€ im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 2,7% auf 30,3 Mio.€ (Vorjahr: 29,5 Mio.€). Auch Japan erreichte mit 16,5 Mio.€ einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (13,0 Mio.€). Als eines der wenigen Industrieländer verfolgt Japan eine expansive Fiskalpolitik, die entsprechende Impulse für die Wirtschaft gibt. Lediglich die Region Sonstiges Asien verzeichnete einen Umsatzrückgang. Hier lag der Wert 2012 bei 76,5 Mio.€ und damit 17,6% unter dem Vorjahresumsatz in Höhe von 92,8 Mio.€.

UMSÄTZE NACH REGIONEN in Mio.€

2011 2012



GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

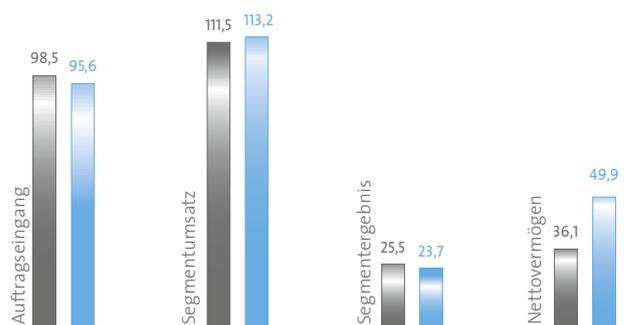
Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. verstärkt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Tamarack Scientific ist ein führender Anbieter von UV-Projektionsbelichtungsgeräten sowie laserbasierten Mikrostrukturierungssystemen. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 69% der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration und das Advanced Packaging.

Im Geschäftsjahr 2012 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 95,6 Mio.€ sowie einen Umsatz von 113,2 Mio.€. Dies entspricht einem leichten Rückgang im Auftragseingang um 3% bzw. einem Plus im Umsatz von 1,5% gegenüber Vorjahr. Das Segmentergebnis (EBIT) verringerte sich leicht von 25,5 Mio.€ im Vorjahr auf Mio. 23,7€ im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies ist ein Rückgang um 7,3%. Die Bruttomarge hat sich gegenüber Vorjahr leicht verringert und lag 2012 bei 40,7% (Vorjahr: 43,7%). Insgesamt hat die Verunsicherung der Endkunden und Unternehmen über den Fortgang der Schuldenkrise und die möglichen makroökonomischen Folgen zu einem vorsichtigen Bestellverhalten, insbesondere zur Jahresmitte, geführt.

SEGMENTÜBERSICHT LITHOGRAFIE in Mio.€

2011 2012



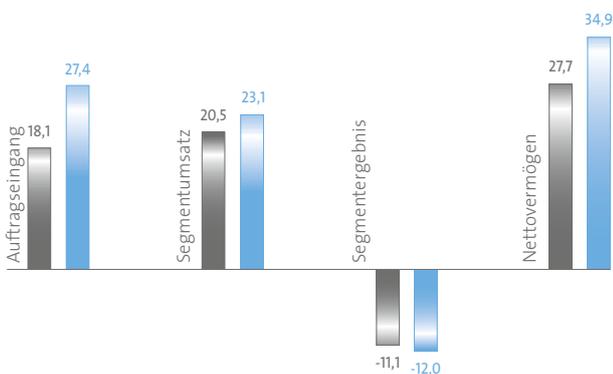
Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Seit 2011 ist die Fertigung in Sternenfels angesiedelt, der Bonder-Vertrieb sowie das nordamerikanische Service- und Applikationscenter wurden im letzten Jahr nach Kalifornien verlegt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 27,4 Mio.€ (Vorjahr: 18,1 Mio.€) als auch im Umsatz mit 23,1 Mio.€ (Vorjahr: 20,5 Mio.€) sehr positiv. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel leicht von -11,1 Mio.€ auf -12,0 Mio.€. Die Bruttomarge verschlechterte sich von -2,6% auf -10,1%.

SEGMENTÜBERSICHT SUBSTRAT BONDER in Mio €

2011 2012



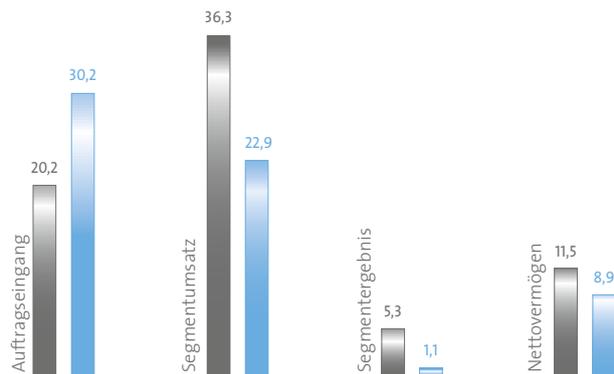
Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut positiv. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2012 bei 30,2 Mio.€ (Vorjahr: 20,2 Mio.€). Der Segmentumsatz belief sich auf 22,9 Mio.€ nach starken 36,3 Mio.€ 2011. Das Segmentergebnis (EBIT) weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,1 Mio.€ (Vorjahr: 5,3 Mio.€) aus. Die Bruttomarge lag nach 34,2% im Vorjahr bei 27,6%.

FOTOMASKEN EQUIPMENT in Mio €

2011 2012



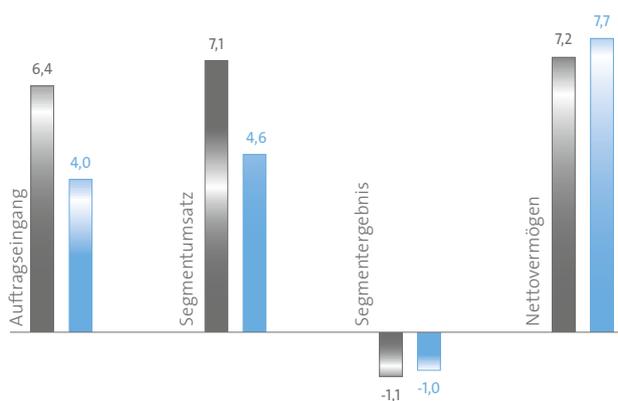
Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel, Schweiz, und das Geschäftsfeld C4NP sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Das Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie in Palo Alto, USA, wurde zum Jahresende 2011 verkauft. Der Anteil an dem Mikrooptik-Geschäft wurde im ersten Halbjahr 2012 von 85% auf 100% aufgestockt. Damit soll das Unternehmen, welches wichtige Schlüsseltechnologien beherrscht, noch enger an SÜSS MicroTec gebunden werden.

Der Auftragseingang verringerte sich von 6,4 Mio.€ 2011 auf 4,0 Mio.€ 2012. Der Segmentumsatz belief sich auf 4,6 Mio.€ nach 7,1 Mio.€ im entsprechenden Vorjahreszeitraum (2011 enthält das desinvestierte Maskengeschäft). Hierbei verzeichnete das Geschäftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang einen leichten Zuwachs von 3,8 Mio.€ auf 3,9 Mio.€ sowie einen Rückgang im Umsatz von 4,6 Mio.€ auf 4,3 Mio.€. Für das Geschäftsjahr 2012 belief sich das Segmentergebnis auf -1,0 Mio.€ nach -1,1 Mio.€ im Vorjahr.

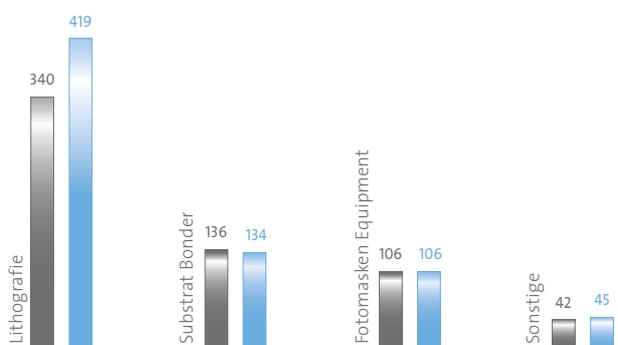
SEGMENTÜBERSICHT SONSTIGE in Mio.€

2011 2012



MITARBEITER NACH SEGMENTEN

2011 2012



NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

SÜSS MicroTec verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Fertigung von Anlagen und Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen. SÜSS MicroTec hat hier für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereit zu stellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht.

Qualitätsmanagement

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen.

Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagement-System, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz unter ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit

SÜSS MicroTec ist der EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) verpflichtet und hat die relevanten Teile der ISO 14001 Norm übernommen und umgesetzt. Darüber hinaus sind wir stetig bemüht, unsere Prozesse und Abläufe sowie deren Überwachung ständig zu verbessern. Unsere Aktivitäten stellen insgesamt auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung im globalen Umfeld ab.

Seit August 2012 ist SÜSS MicroTec darüber hinaus Partnerunternehmen der Blue Competence Initiative des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer). Blue Competence steht für die Innovations- und Technologieführerschaft des Maschinen- und Anlagenbaus im Bereich nachhaltiger Lösungen. Auf der Basis nachprüfbarer Kriterien kennzeichnet die Marke Mitglieder, Teilnehmer und Partner der Initiative als Anbieter Lebensqualität verbessernder, umweltschonender, energie- und ressourceneffizienter sowie marktgerechter Lösungen.

Als Teil unserer sozialen Verantwortung legt SÜSS MicroTec großen Wert auf den Schutz der Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft sowie das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums. Unsere Geschäftsbeziehungen umfassen nicht nur ökonomische und finanzielle Gesichtspunkte, auch die Umwelt und soziale Aspekte werden in gleicher Weise in Betracht gezogen.

Die Verbesserungen der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. Wir sind stolz, dass unsere Maschinen – insbesondere die Mask Aligner – bei der Herstellung von Ultra High Brightness LEDs zum Einsatz kommen und somit indirekt zur Reduzierung der CO²-Emissionen und zur Erhöhung der Energieeffizienz weltweit beitragen. Darüber hinaus kommen viele Bauelemente (z.B. power devices oder high performance ICs), die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt werden, in der Industrie für erneuerbare Energien, wie Wind- und Solarenergie, zum Einsatz. Aber auch die Verbesserungen der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte selbst sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. So legen wir verstärkter Wert auf einen möglichst geringen Einsatz von Chemikalien und gefährlichen Prozessmaterialien im Fertigungsprozess und während der Operation unserer Maschinen. Bei Belackungs- und Entwicklungsgeräten sowie Fotomasken Equipment lässt sich durch innovatives Prozessmanagement und ein ausgeklügeltes Maschinendesign der Verbrauch der verwendeten Medien reduzieren. Dies spart unseren Kunden bares Geld und es entlastet die Umwelt.

Globale Megaprojekte zum Schutz der Umwelt sind ein hervorragendes Mittel, um den Umweltschutz voranzutreiben, doch wir sind der festen Überzeugung, dass auch im täglichen Arbeitsleben jeder einzelne Mitarbeiter seinen Anteil zum Einsparen von Ressourcen oder der Vermeidung von übermäßigem Abfall leisten kann. Dies beginnt mit dem umsichtigen Umgang mit Ressourcen z.B. beim Ausdrucken von Emails bis hin zum Abschalten der Bürobeleuchtung bei Verlassen des Büros. Als unternehmensweites Beispiel sei hier die Einführung eines SAP-gestützten Rechnungserfassungssystems 2012 in Deutschland genannt, mit dem sämtliche Lieferantenrechnungen papierlos verarbeitet und archiviert werden. Darüber hinaus wurde mit der Umrüstung des Klimamanagementsystems für die Reinnräume am Standort Garching eine veraltete

Technologie gegen ein energieeffizientes und modernes System ausgetauscht. Nicht zuletzt wegen dieser Maßnahmen konnte am Standort Garching der Stromverbrauch über die letzten Jahre kontinuierlich verringert werden.

Mitarbeiter

Das Geschäft von SÜSS MicroTec ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Unsere starke Rolle auf dem Weltmarkt verdanken wir unseren Mitarbeitern. Die Mitarbeiter legen mit ihrer Expertise, mit ihren Fähigkeiten und ihrem Engagement die Grundlagen für den weiteren Erfolg von SÜSS MicroTec. Um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren, müssen wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft weltweit hoch qualifizierte und fähige Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen können. Jeder einzelne Mitarbeiter wird von uns unterstützt und gefördert. Mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten, mit angemessenen Vergütungssystemen und mit der Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfelds gelingt es uns weltweit, Mitarbeiter langfristig an unser Unternehmen zu binden.

Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (www.suss.com > Qualität) dargelegt, gibt es spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex („Code of Conduct“) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

Kundenbeziehungen

Unsere langjährige Erfahrung und unsere weltweite Präsenz machen SÜSS MicroTec zu einem zuverlässigen Partner für die Großserienproduktion und für die Forschung und Entwicklung. Mit unserer globalen Vertriebs- und Servicestruktur stehen wir unseren Kunden jederzeit umfassend zur Seite. Unser Serviceangebot beginnt bei der Installation und Inbetriebnahme der Anlagen sowie Anwenderschulungen. Darüber hinaus stellen wir eine weltweite, rasche Ersatzteilversorgung sicher und bieten weltweit präventive Wartungsprogramme und System-Upgrades.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test Houses (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

ERTRAGSLAGE

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatzrückgang, jedoch weiterhin ein deutlich positives Jahresergebnis. Die Umsätze sanken im Vergleich zum Vorjahr um rund 7% und beliefen sich auf 163,8 Mio.€, während im Vorjahr noch 175,4 Mio.€ erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten verringerte sich von 18,6 Mio.€ 2011 auf 11,7 Mio.€ im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das EBIT für das Geschäftsjahr 2012 enthält mehrere Sondereffekte. So ist das Ergebnis mit Währungseffekten von -0,4 Mio.€ belastet, die aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten der SÜSS MicroTec AG gegenüber der Süss MicroTec, Inc. resultieren. Die Rückzahlung dieser konzerninternen Kredite stand im Zusammenhang mit der im März 2012 erfolgten Akquisition von Tamarack Scientific. Die Erstkonsolidierung und die damit verbundene Purchase Price Allocation der Tamarack Scientific führte zu weiteren Sondereffekten: Im vierten Quartal ergab eine Anpassung der Purchase Price Allocation sowie eine Neu beurteilung der Earn-Out-Rückstellung per Saldo einen Ertrag in Höhe von 1,8 Mio.€. Ohne diese Sondereffekte würde sich für 2012 ein EBIT in Höhe von 10,3 Mio.€ ergeben. Im Vorjahr ergab sich ein um Sondereffekte bereinigtes EBIT von rund 20,0 Mio.€.

Der Rückgang der Umsatzerlöse aus den fortgeführten Aktivitäten um 11,6 Mio.€ auf 163,8 Mio.€ resultiert im Wesentlichen aus geringeren Umsätzen im Segment Fotomasken Equipment, in dem im Vorjahr außerordentlich hohe Umsätze erzielt wurden. Aufgrund des deutlich geringeren Auftragsbestands zum Jahresbeginn betrug die Umsatzerlöse 2012 im Segment Fotomasken Equipment 22,9 Mio.€ (nach 36,3 Mio.€ 2011). Im Vorjahr wurden zudem noch Umsätze aus dem Maskengeschäft (den Aktivitäten der Süss MicroTec Precision Photomask, Inc.) in Höhe von 1,7 Mio.€ verzeichnet. Das Maskengeschäft wurde im Oktober 2011 verkauft und leistete 2012 somit keinen Umsatzbeitrag mehr. Das Segment Lithografie konnte hingegen erneut einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen: Die Umsätze stiegen von 111,5 Mio.€ im Vorjahr auf 113,2 Mio.€. Darin enthalten sind Umsatzerlöse in Höhe von 1,9 Mio.€, die die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific erzielte.

Auch das Segment Substrat Bonder weist einen Umsatzanstieg aus: Die Umsätze kletterten im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 % auf 23,1 Mio. €. Die Umsätze im Bereich Mikrooptik sanken leicht von 4,6 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,3 Mio. €.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € enthalten. Damit sind die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten um rund 2,4 Mio. € höher als die Neu-Aktivierungen, die sich im Berichtsjahr auf lediglich 0,1 Mio. € summierten. In 2011 beließen sich die Aktivierungen von Entwicklungskosten ebenfalls auf 0,1 Mio. €, während die Abschreibungen rund 2,5 Mio. € betragen (fortgeführte Aktivitäten).

Im Berichtsjahr konnte aus den fortgeführten Aktivitäten ein Rohertrag von 57,4 Mio. € erzielt werden, was einer Rohertragsmarge von 35,0 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 66,4 Mio. €; die Rohertragsmarge 2011 belief sich auf 37,9 %. Der absolute Rückgang des Rohertrags resultiert aus dem Umsatzrückgang im Bereich Fotomasken Equipment und Mikrooptik. Das Rohergebnis im Segment Substrat Bonder war erneut negativ. Zum einen fielen immer noch hohe Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten an und zum anderen wurde während der vergangenen zwei Jahre der Bestand an Demonstrationsgeräten deutlich aufgestockt, deren Abschreibungen nun das Rohergebnis schmälern. Das Rohergebnis im Segment Lithografie war im abgelaufenen Geschäftsjahr – trotz leichter Umsatzzuwächse – leicht rückläufig. Grund hierfür ist vor allem der aktuelle Produktmix: Die 2012 verkauften Coater-Geräte erzielten aufgrund technischer Spezifikationen eine etwas geringere Rohertragsmarge als in den Vorjahren.

Die Vertriebskosten erhöhten sich von 19,0 Mio. € im Vorjahr auf 20,7 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 12,6 % (Vorjahr: 10,8 %) entspricht. Der Anstieg der Vertriebsaufwendungen resultiert vor allem aus einem Personalaufbau im Vertrieb der Suss MicroTec Lithography GmbH sowie aus erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Akquise von Neukunden. In den Vertriebsaufwendungen sind außerdem 0,6 Mio. € der Tamarack Scientific Co., Inc. enthalten, die seit März 2012 zum SÜSS MicroTec-Konzern gehört. Die Verwaltungskosten erhöhten sich von 15,7 Mio. € auf 17,0 Mio. € und entsprechen damit 2012 einer Aufwandsquote von 10,4 % (Vorjahr: 9,0 %). Der Anstieg erklärt sich vor allem aus den Verwaltungskosten der Tamarack Scientific Co., Inc., die 2012 zusätzlich im SÜSS MicroTec-Konzern berücksichtigt wurden und sich auf rund 1,1 Mio. € belaufen. Da Tamarack Scientific einen eigenen Produktionsbetrieb, eine Entwicklungsabteilung und einen Vertrieb beinhaltet, entstehen in dieser Gesellschaft deutlich höhere Verwaltungsaufwendungen als in anderen ausländischen Gesellschaften der Gruppe, die lediglich eine Vertriebsorganisation unterhalten. Die Verwaltungskosten in den übrigen Konzerngesellschaften entwickelten sich unterschiedlich: In der SÜSS MicroTec AG war bei den Verwaltungskosten 2012 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen ist. Dagegen entwickelten sich die Verwaltungsaufwendungen bei der Suss MicroTec, Inc. (Sunnyvale / USA) deutlich rückläufig, da die Gesellschaft seit Mitte 2011 ausschließlich als Vertriebsgesellschaft fungiert. Darüber hinaus sind Verwaltungsaufwendungen in Höhe von rund 0,6 Mio. € entfallen, die im Vorjahr bei der Suss MicroTec Precision Photomask, Inc. (Sunnyvale / USA) entstanden sind. Deren Geschäftsbetrieb wurde im Oktober 2011 verkauft.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten reduzierten sich von 12,9 Mio. € auf 9,7 Mio. € und betrafen mit 4,6 Mio. € den Bereich Lithografie und mit 2,9 Mio. € den Bereich Substrat Bonder. 1,3 Mio. € waren dem Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen. Der Rückgang der Kosten im Bereich Forschung und Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass ein großer Anteil der Kosten Kundenaufträgen direkt zugeordnet wurde.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 6,1 Mio.€ (Vorjahr: 4,8 Mio.€) und beinhalteten vor allem Erträge aus Fremdwährungsumrechnungen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen des abgelaufenen Geschäftsjahres sind Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung Tamarack Scientific in Höhe von 2,1 Mio.€ enthalten. Die Auflösung der entsprechenden Verbindlichkeit resultiert aus einer Neubeurteilung der voraussichtlichen Ertragslage von Tamarack Scientific, auf deren Basis der Earn-Out für die Verkäufer und die Mitarbeiter von Tamarack Scientific ermittelt werden wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 4,4 Mio.€ (Vorjahr: 4,9 Mio.€) und beinhalteten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen. Im Berichtsjahr sind hier außerdem Aufwendungen im Zusammenhang mit der Passivierung einer Earn-Out-Verbindlichkeit für Tamarack Scientific-Mitarbeiter in Höhe von 0,3 Mio.€ enthalten.

Der Bereich Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 23,7 Mio.€ (Vorjahr: 25,5 Mio.€) zum Konzern-EBIT aus fortgeführten Aktivitäten (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für den Bereich Lithografie eine Umsatzrendite von 20,9%, die sich im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 22,9%) leicht verringert hat. Der Rückgang des Ergebnisses und der Umsatzrendite des Bereichs Lithografie ist vor allem auf die erstmalige Berücksichtigung des Tamarack Scientific-Geschäfts in diesem Segment zurückzuführen. Tamarack Scientific steuerte im Berichtsjahr ein negatives EBIT aus dem operativen Geschäft von -2,9 Mio.€ zum Konzernergebnis bei. Darüber hinaus fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 0,6 Mio.€ Abschreibungen auf die im Rahmen der Purchase Price Allocation aufgedeckten stillen Reserven an. Aus der Zuführung zur Earn-Out-Verbindlichkeit gegenüber den Mitarbeitern sowie aus der Auflösung von Earn-Out-Verbindlichkeiten aufgrund einer Neu-Beurteilung zum 31. Dezember 2012 entstanden per Saldo Erträge in Höhe von 1,8 Mio.€, die ebenfalls Bestandteil des Lithografie-Ergebnisses sind. In Summe wurde das Segmentergebnis des Bereichs Lithografie durch Tamarack Scientific mit -1,7 Mio.€ belastet.

Im Bereich Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von -12,0 Mio.€ nach -11,1 Mio.€ im Vorjahr. Das Ergebnis war erneut belastet durch hohe Entwicklungskosten im Bereich Thin Wafer Handling sowie Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten. In den vergangenen 18 Monaten wurde zudem der Bestand an Demonstrationsgeräten aufgestockt, wodurch sich die Abschreibungen deutlich erhöhten. Zudem liegt die Bruttomarge der verkauften Substrat Bonder nach wie vor im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Ergebnis von 1,1 Mio.€ (Vorjahr: 5,3 Mio.€) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 4,8% und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2011: 14,6%) deutlich verringert. Grund für die gesunkene Umsatzrendite ist im Wesentlichen das geringe Umsatzvolumen, das 2012 erzielt wurde.

Das Finanzergebnis belief sich 2012 auf 11 Tsd.€ (nach 1,0 Mio.€ im Vorjahr). Im Finanzergebnis des Vorjahres war der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von 747.530 Cascade-Aktien erfasst, der sich auf 0,8 Mio.€ belief.

Das Konzernergebnis ist mit Ertragsteuern in Höhe von 4,1 Mio.€ belastet, was einer durchschnittlichen Steuerquote von rund 35% entspricht. Im Vorjahr fiel die steuerliche Belastung des Konzernergebnisses mit 5,8 Mio.€ absolut höher aus, spiegelte jedoch nur eine durchschnittliche Steuerquote von rund 30% wider. Im Steueraufwand des abgelaufenen Geschäftsjahres sind Wertberichtigungen aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 0,7 Mio.€ enthalten, die die Süss MicroTec, Inc. (Sunnyvale / USA) betreffen.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von 7,6 Mio.€. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 13,8 Mio.€ gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 1,5 Mio.€ (Vorjahr: -21 Tsd.€), das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Der erzielte Ertrag resultierte aus einer nachträglichen Kaufpreiszahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Test-Business, die der SÜSS MicroTec AG im Februar 2012 ausbezahlt wurde.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 9,1 Mio. € (Vorjahr: 13,8 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 0,48 € nach 0,72 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 17,0 % von 281 Tsd. € auf 233 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Die Net Cash Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – reduzierte sich von 42,0 Mio. € im Vorjahr auf 32,3 Mio. € zum 31. Dezember 2012. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren verringerte sich von 56,4 Mio. € im Vorjahr auf 36,6 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf -0,6 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €). Hier machte sich vor allem der weitere Anstieg des Konzernlagerbestands bemerkbar, aus dem ein Mittelabfluss in Höhe von 4,7 Mio. € resultierte. Neben einem Zuwachs der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1,2 Mio. € erhöhte sich auch der Bestand an unfertigen Maschinen um 3,2 Mio. € und der Bestand an Demonstrationsgeräten (insbesondere im Bonder-Bereich) um 5,1 Mio. €. Im Gegensatz dazu reduzierte sich der Bestand an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Endabnahme jedoch noch aussteht, auf 12,6 Mio. € (Vorjahr: 17,4 Mio. €). Auch der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sorgten für Mittelabflüsse von insgesamt 4,5 Mio. €. Zur Reduzierung des Cashflows trug außerdem der Rückgang der erhaltenen Kundenanzahlungen bei, die auf Jahresbasis verringerte Mittelzuflüsse von 6,1 Mio. € nach sich zogen. Im operativen Cashflow sind Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Tamarack Scientific in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere und bereinigt um den Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc. sowie ohne Berücksichtigung der nachträglichen Kaufpreiszahlung für das Test-Business -4,2 Mio. €. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen Sachanlagen. Im Vorjahr betrug der investive Cashflow ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere -2,6 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen und bereinigt um die Zahlungsströme aus dem Kauf Tamarack Scientific und dem Verkauf Test – auf -4,5 Mio. €, nachdem im Vorjahr (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verkäufen) ein freier Cashflow von 3,5 Mio. € erzielt wurde.

Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt sich – genauso wie im Vorjahr – die planmäßige Tilgung des Immobilien-Darlehens Sternenfels sowie die planmäßige Tilgung des Finanzierungsleasings für das konzernweite SAP-System. Im Dezember 2012 wurde außerdem das Schuldscheindarlehen mit 9 Mio. € zur Rückzahlung fällig und komplett aus den vorhandenen liquiden Mitteln getilgt. Darüber hinaus ist im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der Abfluss von 1,2 Mio. € für den Erwerb von 15 % der Anteile an der Suss MicroOptics S.A. (Neuchâtel / Schweiz) erfasst, die bis zum Erwerbszeitpunkt von Minderheitsaktionären gehalten wurden.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 36,6 Mio. € (Vorjahr: 56,4 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 11,2 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 1,9 Mio. €.

Mit Verträgen vom 15. und 26. März 2012 bzw. 2. April 2012 haben die SÜSS MicroTec AG und die Suss MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 7,5 Mio. € gestellt wird. Dem Bankenkonsortium gehören außerdem die Deutsche Bank sowie die DZ Bank AG an. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2013 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zwischen der Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der BW Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten, die durch Unternehmensakquisitionen erworbenen Technologien (Suss MicroTec Photomask Equipment bzw. Tamarack Scientific) sowie das Betriebsgrundstück in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,4 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €). Er hat sich durch die Erstkonsolidierung Tamarack Scientific um 1,8 Mio. € erhöht. Der Tamarack Scientific-Goodwill wird in USD geführt; der originäre Wert beläuft sich auf 2,4 Mio. USD. Dieser Teil des Geschäfts- oder Firmenwerts wird zukünftig Währungsschwankungen unterliegen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: Nach 5,4 Mio. € im Vorjahr betragen sie zum Bilanzstichtag noch 3,0 Mio. €. Die planmäßigen Abschreibungen auf die aktivierten Entwicklungsprojekte übertrafen im abgelaufenen Geschäftsjahr die getätigten Investitionen um 2,4 Mio. €, was zu einer entsprechenden Belastung in der Gewinn- und Verlustrechnung führte. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) auf das Segment Lithografie und in Höhe von 1,7 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €) auf das Segment Substrat Bonder.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstände (SAP-Lizenzen) in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,7 Mio. € entfällt in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) auf das Segment Sonstige. In den immateriellen Vermögenswerten des Bereichs Lithografie sind auch 0,8 Mio. € enthalten, die dem Konzern durch die Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific zugehen und die vor allem auf Software entfielen. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Tamarack Scientific-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,7 Mio. € aufweist. Die im Rahmen der HamaTech-Akquisition erworbene Technologie wurde zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres nahezu vollständig planmäßig abgeschrieben. Zum Vorjahresstichtag wies sie noch einen Restbuchwert von 0,3 Mio. € auf.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 4,8 Mio. € im Vergleich zu 2,8 Mio. € im Vorjahr. Als größte Investition ist der Einbau eines Reinraums in die gemieteten Geschäftsräume der Suss MicroOptics S.A. (Neuchâtel / Schweiz) zu nennen, der Anschaffungskosten von rund 1,7 Mio. € verursachte. Im Investitionsbetrag ist außerdem der Zugang des Sachanlagevermögens der Tamarack Scientific Co., Inc. enthalten, der sich im Erstkonsolidierungszeitpunkt auf 1,3 Mio. € belief. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueransprüche reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund der vollständigen Nutzung der Verlustvorträge bei der SÜSS MicroTec AG, aufgrund vorgenommener Abwertungen auf latente Steueransprüche der Suss MicroTec, Inc. und aufgrund erstmals vorgenommener Saldierungen um insgesamt 4,2 Mio. € und betragen zum Bilanzstichtag 1,2 Mio. €. Die passiven latenten Steuern haben sich im Geschäftsjahr im Wesentlichen aufgrund der erstmals vorgenommenen Saldierungen von 2,8 Mio. € auf 66 Tsd. € reduziert.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 7,0 Mio. € auf nun 143,1 Mio. € zurückgegangen. Dieser Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einem geringeren Bestand an Wertpapieren und flüssigen Mitteln.

Die Vorräte erhöhten sich von 71,6 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 82,2 Mio. €. Die Erhöhung ist teilweise auf einen höheren Bestand von Demonstrationsgeräten zurückzuführen, der im Geschäftsjahr von 12,5 Mio. € auf 19,0 Mio. € anstieg. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erhöhte sich im Geschäftsjahr um 3,1 Mio. € auf 27,5 Mio. €. Davon entfallen 2,0 Mio. € auf den Zugang von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Tamarack Scientific Co., Inc. Der Bestand an unfertigen Erzeugnissen stieg im Geschäftsjahr von 23,1 Mio. € auf 34,0 Mio. € an. Von dem Anstieg entfallen 7,5 Mio. € auf die Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific. Die Bestände an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aussteht, haben sich im Gegenzug im Vergleich zum Vorjahr reduziert: Sie beliefen sich auf 12,6 Mio. € (nach 17,4 Mio. € im Vorjahr).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 17,8 Mio. € auf 21,8 Mio. €. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt und ist den zahlreichen Abnahmen von Maschinen zum Jahresende geschuldet.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns ging 2012 von 19,4 Mio. € auf 11,4 Mio. € zurück. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich ebenfalls von 37,0 Mio. € auf 25,2 Mio. €.

Der Rückgang der sonstigen Vermögenswerte von 2,8 Mio. € im Vorjahr auf 1,7 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf einen geringeren Stand der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 10,5 Mio. € auf 9,8 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr auf 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) beliefen. Unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr außerdem die Earn-Out-Verpflichtungen in Höhe von 2,0 Mio. € für die Akquisition der Tamarack Scientific sowie die noch ausstehende Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der Minderheitenanteile an der Suss MicroOptics in Höhe von 0,3 Mio. € ausgewiesen. Die latenten Steuerschulden haben sich aufgrund erstmals vorgenommener Saldierungen mit latenten Steueransprüchen von 2,8 Mio. € im Vorjahr auf 0,1 Mio. € reduziert.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Rückgang von 56,9 Mio. € im Vorjahr auf 42,2 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Rückgang hatte die Rückzahlung des Schuldscheindarlehens in Höhe von 9,0 Mio. €, die im Dezember 2012 planmäßig erfolgte. Darüber hinaus hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr Steuerschulden für 2010 und 2011 beglichen, wodurch die Steuerschulden um rund 4,6 Mio. € auf nun 1,1 Mio. € sanken. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt von 7,6 Mio. € auf nun 6,9 Mio. € reduziert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um 0,5 Mio. € auf 23,6 Mio. € zurückgegangen. Hier wirkte der deutlich gesunkene Bestand an erhaltenen Anzahlungen: Durch die Erstkonsolidierung Tamarack Scientific sind dem Konzern erhaltene Anzahlungen in Höhe von 5,4 Mio. € zugegangen, die sich bis Jahresende um weitere 0,8 Mio. € erhöhten. Trotzdem beliefen sich die gesamten erhaltenen Anzahlungen des Konzerns zum Stichtag lediglich auf 17,6 Mio. € (Vorjahr: 18,6 Mio. €). Im Gegenzug haben sich die Personalrückstellungen sowie die Posten der passiven Rechnungsabgrenzung um insgesamt 0,5 Mio. € erhöht.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2011 um 7,7 Mio. € auf 128,1 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 64,1% auf 71,1%.

Durch die Ausübung von insgesamt 14.510 Aktienoptionen durch Vorstand und Mitarbeiter erhöhte sich das Stammkapital um 1,00 € pro Aktienoption und betrug zum Bilanzstichtag 19,1 Mio. €. Pro ausgeübter Aktienoption wurden 0,30 € in die Kapitalrücklage eingestellt.

GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SÜSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr erneut positiv dargestellt. Der SÜSS MicroTec-Konzern konnte ein EBIT von 11,7 Mio. € (fortgeführte Aktivitäten) und eine EBIT-Marge von 7,1% erzielen.

Durch die immer noch hohe Net Cash-Position von 32,3 Mio. € (Vorjahr: 42,0 Mio. €) verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren. Mit Kaufvertrag vom 23. Januar 2013 hat die SÜSS MicroTec AG außerdem die Immobilie am Firmensitz in Garching erworben, was voraussichtlich im Oktober 2013 zu einem Mittelabfluss von rund 8,7 Mio. € führen wird. Es ist vorgesehen, den Kaufpreis aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

INVESTITIONEN

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2% des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Um diesen Bereich weiter auszubauen, ist die Süss MicroOptic S.A. (Neuchâtel/Schweiz) im zweiten Halbjahr 2012 in neue gemietete Geschäftsräume umgezogen und hat in diese neuen Räume einen Reinraum für rund 1,7 Mio. € eingebaut.

Ein Teil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da für Entwicklungskosten unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind dem Konzern durch die Akquisition Tamarack Scientific immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen von insgesamt rund 4,2 Mio. € zugegangen. Tamarack Scientific Co., Inc. ist in Corona (Kalifornien / USA) in gemieteten Räumen angesiedelt und betreibt seine Wertschöpfungskette ähnlich wie die bereits zur SÜSS MicroTec-Gruppe gehörenden Produktionsunternehmen. Somit sind auch für die Produktion der Tamarack Scientific-Maschinen keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDING

Gesellschaft	SMT AG (HGB)			
	2012	2011	Änderung	in %
in Tsd. €				
Jahresüberschuss	7.595	9.762	-2.167	-22
Eigenkapital	109.760	102.146	7.614	7
Bilanzsumme	127.264	134.577	-7.313	-5
EK-Quote in %	86	76		
Anlagevermögen	76.816	71.982	4.834	7
% der Bilanzsumme	60	53		
Umlaufvermögen	50.448	62.595	-12.147	-19
% der Bilanzsumme	40	47		

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,6 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 1,5 Mio. €. Der Rückgang beruht ausschließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 57,2 Mio. € und sind damit um 1,5 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Zunahme resultiert aus dem Erwerb von 15 % der Anteile an der Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel (Schweiz). Die SÜSS MicroTec AG hat damit ihre Beteiligung von 85 % auf 100 % aufgestockt.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultiert im Wesentlichen aus der Auszahlung eines Darlehens an die Tamarack Scientific Co., Inc. in Höhe von 4,2 Mio. €.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen um 8,6 Mio. €. Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus dem Cashpooling mit der Suss MicroTec Lithography GmbH.

Im Berichtsjahr sank die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec AG deutlich. Der Abbau resultiert im Wesentlichen aus dem negativen Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften, der Rückführung des Schuldscheindarlehens in Höhe von 9,0 Mio. € und der Rückzahlung eines von der Suss MicroTec, Inc. gewährten Darlehens in Höhe von 5,5 Mio. €. Der Rückgang der Liquiditätsposition wird sowohl im Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 12,4 Mio. € als auch in der Position der Wertpapiere in Höhe von 7,9 Mio. € sichtbar. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen, die über ein Rating im Investment-Grade-Bereich verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sanken im Berichtsjahr um 5,2 Mio. €. Der Rückgang resultierte aus der Suss MicroTec, Inc.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2012 um 9,2 Mio. €. Der Rückgang resultiert aus planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels und der Rückführung des Schuldscheindarlehens im Dezember des Geschäftsjahres in Höhe von 9 Mio. €.

Das erhöhte Eigenkapital (+7,6 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres (7,6 Mio. €).

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2012 ein Jahresüberschuss von 7,6 Mio. € (Vorjahr: 9,8 Mio. €).

Aufgrund des zum 1. Januar 2011 gültigen Gewinnabführungsvertrages mit der Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 6,6 Mio. € (Vorjahr: 10,2 Mio. €) ergebniswirksam gebucht. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrages mit der Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) ergebniswirksam erfasst.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €), Mieterlöse in Höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) und ein nachträglicher Ertrag aus dem Verkauf der Suss MicroTec Test Systems GmbH in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 1,5 Mio. € (nach 3,4 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,3 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Auflösung der Drohverlustrückstellung für den Zinsswap für das Schuldscheindarlehen zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2012 durchschnittlich 20 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter tätig.

Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.

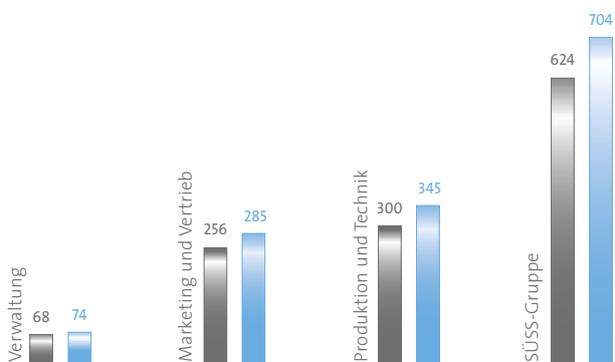
Mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2012 waren 704 (Vorjahr: 624) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

MITARBEITER NACH BEREICHEN

2011 2012



Rechtliche Angaben

ANGABEN GEMÄSS § 289 ABS. 4 HGB UND § 315 ABS. 4 HGB

1. ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Zum 31. Dezember 2012 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.101.028,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.101.028) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2. BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN BETREFFEN

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3. BETEILIGUNGEN AM KAPITAL, DIE 10 % DER STIMMRECHTE ÜBERSCHREITEN

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4. AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, DIE KONTROLLBEFUGNISSE VERLEIHEN

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE, WENN ARBEIT- NEHMER AM KAPITAL BETEILIGT SIND UND IHRE KONTROLLRECHTE NICHT UNMITTELBAR AUSÜBEN

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen ihres Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

6. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN DER SATZUNG ÜBER DIE ERNENNUNG UND AB- BERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN UND DIE ÄNDERUNG DER SATZUNG

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7. BEFUGNISSE DES VORSTANDS, AKTIEN AUSZUGEBEN ODER ZURÜCKZUKAUFEN

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.552.863€ durch Ausgabe von bis zu 2.552.863 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und / oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000€ durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

8. WESENTLICHE VEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE UNTER DER BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS INFOLGE EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS STEHEN

Mit den drei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z.B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9. ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE FÜR DEN FALL EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS MIT VORSTANDSMITGLIEDERN ODER ARBEITNEHMERN GETROFFEN SIND

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 8. März 2013 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.suss.de > Investor Relations > Corporate Governance > Erklärung zur Unternehmensführung allgemein zugänglich gemacht.

Vergütungsbericht

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden, aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen, darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

VERGÜTUNGSSTRUKTUR

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung und einer aktienbasierten Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Für das Geschäftsjahr 2011 war die variable Vergütung auf maximal 100 % der Festvergütung zu Beginn dieses Geschäftsjahrs begrenzt. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 kann die variable Vergütung höchstens 150 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen. 70 % der variablen Vergütung bestimmen sich nach quantitativen und 30 % nach qualitativen Kriterien.

AN QUANTITATIVEN ZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

Die quantitativen Kriterien (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an quantitativen Kriterien orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages ("Vorbehaltshälfte") ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten. Für das Bezugsjahr 2011 ist der Erwerb der Aktien der Gesellschaft während des Handelsfensters nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011 im April 2012 erfolgt.

AN QUALITATIVEN ZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG B)

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige, nachhaltige und qualitative Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden. Dabei sind für die jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele („Milestones“) zu definieren, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht werden sollen. Erstmals erfolgte eine Festlegung der Milestones für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Der Aufsichtsrat legt nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach Anhörung des Vorstandes durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 % und 130 % vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wird der Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wird zu 50 % als Vorschuss ausbezahlt und zu 50 % auf das Verrechnungskonto für die variable Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele wird der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 % bis 130 % den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend feststellen. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre sind nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maßgeblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienen nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels („Change-of-control“-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Für die Mitglieder des Vorstandes wurde folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2012 festgesetzt:

VORSTANDSVERGÜTUNG

2012 in €	Grund- gehalt *	Variable Vergütung	Sonstige Leistungen**	Aufwand für Alters- versorgung
Vorstand				
Frank Averdung	316.794,24	398.046,17	6.585,60	2.148,00
Michael Knopp	237.559,80	300.193,44	6.585,60	2.148,00

Für die Mitglieder des Vorstandes wurde folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2011 festgesetzt:

2012 in €	Grund- gehalt *	Variable Vergütung	Sonstige Leistungen**	Aufwand für Alters- versorgung
Vorstand				
Frank Averdung	265.601,52	110.789,29	6.567,00	2.148,00
Michael Knopp	227.470,24	101.070,57	6.567,00	2.148,00

* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung
Ergänzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang

PENSIONEN

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von 35 Tsd.€ (Vorjahr: 7 Tsd.€).

AKTIONSOPTIONSPROGRAMME

Die SÜSS MicroTec AG hat in der Vergangenheit mehrfach Aktienoptionspläne auflegt, um Mitarbeiter an dem Erfolg des Unternehmens zu beteiligen sowie Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Hierzu konnten Optionen an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i.S. der §§15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundener nachgeordneter Unternehmen i.S. der §§15 ff. AktG ausgegeben werden. Die beiden zu Beginn des Geschäftsjahres bestehenden Aktienoptionsprogramme sind im Laufe des Geschäftsjahres 2012 ausgelaufen. Derzeit verfügt die SÜSS MicroTec AG über kein Aktienoptionsprogramm.

Aktienoptionsprogramm 2005

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2012 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2005 insgesamt 186.800 Optionen aus, wobei eine Ausgabe von Optionen unter diesem Programm nur bis zum 31. Dezember 2009 möglich war. Insgesamt sind 186.800 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2005 im Geschäftsjahr 2012 verfallen. Optionen aus diesem Programm wurden im Geschäftsjahr 2012 nicht ausgeübt. Die Anzahl der noch ausstehenden Optionen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 0 Stück. Die ausgegebenen Optionen konnten nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wurde: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p.a. gestiegen und der Börsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDax oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen.

Aktienoptionsprogramm 2008

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2012 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2008 insgesamt 14.510 Optionen aus, wobei eine Ausgabe von Optionen unter diesem Programm nur bis zum 31. Dezember 2012 möglich war. Im Berichtsjahr 2012 wurden 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 0 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2008 im Geschäftsjahr 2012 verfallen und 14.510 Optionen sind ausgeübt worden. Am Ende des Geschäftsjahres 2012 standen noch 0 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 aus. Die ausgegebenen Optionen konnten nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern folgende Erfolgsziele erfüllt waren: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabebetrag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie hat sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabebetrag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,833 % pro vollem Kalendermonat gestiegen. Zusätzlich zu den Erfolgszielen (i) und (ii) musste der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate

der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraumes mindestens einmal bei 5,00 € für die Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 5,75 € und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und dem 60. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 6,60 € gelegen haben.

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

2012 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O Versicherungs- prämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsrats- vorsitzender)	45.000,00	10.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsrats- vorsitzender)	40.000,00	10.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	10.500,00	638,27

2011 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O- Versicherungs- prämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsrats- vorsitzender)	45.000,00	10.500,00	2.174,45
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsrats- vorsitzender)	40.000,00	10.500,00	1.087,23
Gerhard Pegam	17.500,00	6.000,00	362,41
Sebastian Reppegather	17.500,00	4.500,00	362,41

Im Geschäftsjahr 2012 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

Nachtragsbericht

Die SÜSS MicroTec AG hat mit Kaufvertrag vom 23. Januar 2013 die von SÜSS MicroTec AG und Suss MicroTec Lithography GmbH genutzte Immobilie am Firmensitz in Garching erworben. Der rechtliche Übergang der Immobilie wird voraussichtlich zum 30. September 2013 erfolgen. Der Kaufpreis für die Immobilie und das rund 20.000 m² große Grundstück beträgt 8,7 Mio. € und wird aus den bestehenden liquiden Mitteln finanziert werden.

Zum 31. Januar 2013 lief der Sale-and-Lease-Back-Vertrag für das konzerneigene SAP-System, das in Deutschland, den USA und Taiwan genutzt wird, aus. Die SÜSS MicroTec AG hat die im Vertrag festgelegte Kaufoption ausgeübt und das SAP-System zum 1. Februar 2013 für einen Kaufpreis von 0,2 Mio. € erworben.

STIMMRECHTSMITTEILUNGEN NACH DEM STICHTAG

Es lagen keine Stimmrechtsmitteilungen nach dem Stichtag vor.

Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit Langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2012 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit.

Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP schließlich bei der Süss MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA) implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden schließlich über ein zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Das Wachstum der Weltwirtschaft hat im Verlauf des Jahres 2012 weiter an Schwung verloren. Nach real 3,8% Plus im Jahr 2011 ist das weltweite Bruttoinlandsprodukt 2012 nur um geschätzt real 3,2% gestiegen.⁽¹⁾ Belastet wurde die wirtschaftliche Entwicklung vor allem durch die anhaltende Staatsschulden- und Vertrauenskrise im Euroraum. Die in den USA bis November anhaltende Unsicherheit über den Ausgang der Präsidentschaftswahl dämpfte 2012 auch die Konjunkturerwicklung im nordamerikanischen Raum. Das fragile Konjunkturbild blieb aber 2012 nicht auf die Industrieländer begrenzt, sondern schloss auch aufstrebende Volkswirtschaften wie China ein. Dennoch dauerte die bereits seit Jahren bestehende Wachstumskluft zwischen Industrieländern auf der einen und aufstrebenden Volkswirtschaften auf der anderen Seite an: In den Industrieländern stieg das Bruttoinlandsprodukt nur um durchschnittlich 1,2%, in den aufstrebenden Volkswirtschaften hingegen um durchschnittlich 5,0%.⁽²⁾

Das Marktforschungsinstitut Gartner hat im Dezember 2012 für das gesamte Halbleitersegment für das abgelaufene Jahr einen Rückgang um rund 3% gegenüber Vorjahr in Aussicht gestellt. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts semi wird für 2012 insgesamt ein Rückgang der Nachfrage nach Halbleiter-Equipment um rund 15% erwartet. SÜSS MicroTec verzeichnete 2012 einen Umsatzrückgang um rund 7%. Der höchste Umsatzanteil wurde wieder in den Regionen China, Taiwan und sonstiges Asien erzielt. Die Umsätze in diesen Regionen waren jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufig. Stattdessen haben sich die Umsätze mit japanischen Kunden um rund 27% erhöht. Die Umsätze in Europa und Nordamerika lagen etwas über Vorjahresniveau. Der Auftragseingang erreichte im dritten Quartal nur ein Niveau von rund 37 Mio. €; im vierten Quartal konnte hingegen ein erfreulich hoher Auftragseingang von rund 40 Mio. € erzielt werden.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können. Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten unserem Unternehmen jedoch – je nach Art der Entwicklung – auch zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftragseingänge und Umsätze sorgen können.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere Technologiekompetenz konnten wir unsere Stellung als Marktführer in Mikrostrukturanwendungen festigen. Wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft vom schnellen technologischen Wandel profitieren können und durch unsere Neuentwicklungen und durchdachten Prozesslösungen unsere Marktstellung weiter ausbauen können.

Abhängigkeit von einzelnen „Knowhow“-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

⁽¹⁾ Quelle: WEO Update Januar 2013 IWF-Datenbank

⁽²⁾ Quelle: ifo Institut München

BETRIEBLICHE RISIKEN

Vermögens- und Ertragslage

Angesichts des relativ hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, überschaubar. Der Break-Even-Umsatz liegt auch 2012 wieder deutlich unter dem tatsächlich erwirtschafteten Umsatz.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der Substrat-Bonder-Bereich erneut defizitär. Das Ergebnis des Segments Substrat Bonder war belastet durch hohe Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten sowie durch deutlich gestiegene Abschreibungen auf 2011 und 2012 hergestellte Demonstrationsgeräte. Zudem liegt die Bruttomarge der verkauften Substrat Bonder nach wie vor im niedrigen einstelligen Prozentbereich und damit deutlich außerhalb der für eine erfolgreiche Entwicklung des Segments Substrat Bonder mittel- bis langfristig notwendigen Bandbreite von 30% bis 40%. Das Nettovermögen dieses Segments beläuft sich auf rund 35 Mio.€, was in etwa dem 1,5-fachen des erzielten Jahresumsatzes entspricht. Wir erwarten für den Substrat-Bonder-Bereich auch für 2013 ein deutlich negatives Ergebnis. Die positive Ertragslage der übrigen Segmente des Konzerns, insbesondere des Bereichs Lithografie, ermöglicht es dem SÜSS MicroTec-Konzern bisher, die anfallenden Verluste des Substrat-Bonder-Bereichs auszugleichen. Für die Zukunft erwarten wir eine positive Ergebnisentwicklung des Substrat-Bonder-Bereichs, so dass auch bei einem geringeren Ergebnisbeitrag der übrigen Segmente des Konzerns ein positives Konzernergebnis erwirtschaftet wird.

Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2012 vorhandenen Auftragsbestands und den verhaltenen Aussichten für die Halbleiter-Equipment-Branche im Jahr 2013 gehen wir davon aus, dass wir 2013 einen Umsatz leicht über dem Break-Even-Umsatz erwirtschaften werden.

Zum 31. Dezember 2012 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,4 Mio.€ aus, der ausschließlich dem Bereich Lithografie zuzuordnen ist. Der Bereich Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und trägt ganz wesentlich zu einem positiven Konzernergebnis bei. Für 2013 erwarten wir zwar rückläufige Umsätze in diesem Segment. Der Bereich Lithografie wird jedoch auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

Änderungen der Konzernstruktur

Im März 2012 hat SÜSS MicroTec die Tamarack Scientific Co., Inc., Corona (Kalifornien / USA) erworben. Mit der Akquisition verfolgt SÜSS MicroTec eine Konsolidierungsstrategie im Halbleiter Backend und hat seine Technologiekompetenz im Bereich Lithografie um die Projektionsbelichtung erweitert.

Im Mai 2012 hat die SÜSS MicroTec AG die restlichen 15% an der Süss MicroOptics S.A., Neuchâtel (Schweiz) erworben und damit seine Beteiligung auf 100% aufgestockt. Mit dem Erwerb hat SÜSS MicroTec seine Organisationsstruktur weiter verschlankt und hat die Süss MicroOptics, die für SÜSS MicroTec bedeutende Schlüsseltechnologien beherrscht, fest an die SÜSS MicroTec-Gruppe gebunden.

Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs nach Deutschland – Künftige Entwicklung

Im April 2011 wurde die Verlagerung des im US-amerikanischen Waterbury (Vermont) ansässigen Geschäftsbereichs Substrat Bonder nach Deutschland abgeschlossen. Die Funktionsbereiche Forschung und Entwicklung, Produktion sowie das Produktmanagement des Substrat Bonder Bereichs sind nun in die Süss MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels integriert. Obwohl der Umzug, der Neuaufbau der Produktion und die Übertragung von Knowhow reibungslos abliefen, ist es SÜSS MicroTec bisher nicht gelungen, mit dem Substrat Bonder Bereich ein positives Ergebnis zu erzielen. Der Substrat Bonder Bereich wird auch 2013 defizitär sein. Ein positives Ergebnis in diesem Segment wird voraussichtlich erst zu erzielen sein, wenn deutlich mehr Auftragseingänge zu verzeichnen sind und höhere Stückzahlen pro Maschinentyp produziert werden können, da so eine deutliche verbesserte Bruttomarge der verkauften Substrat Bonder erzielt werden kann. Solange sich keine deutliche Verbesserung der Auftragslage und der Zusammensetzung der erhaltenen Aufträge einstellt, wird dieser Bereich weiterhin defizitär sein.

Tamarack Scientific Co., Inc.

Mit dem Erwerb von Tamarack Scientific hat SÜSS MicroTec sein Produktspektrum im Bereich Lithografie ausgeweitet und um die Projektionsbelichtung ergänzt. Die Integration von Tamarack Scientific in die SÜSS MicroTec-Gruppe ist nahezu abgeschlossen und verlief reibungslos. Tamarack Scientific trug 2012 mit Umsätzen in Höhe von 1,9 Mio. € zum Konzernumsatz bei und erzielte ein negatives EBIT aus dem operativen Geschäft in Höhe von -2,9 Mio. €. Auch 2013 wird Tamarack Scientific – aufgrund des margenschwachen Auftragsbestands – ein negatives operatives Ergebnis erzielen. Wir erwarten jedoch für die kommenden Jahre deutliche Umsatzsteigerungen und die Akquise neuer Kunden durch die Erweiterung des Lithografie-Produktportfolios.

FINANZMARKTRISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -Absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 22,4 Mio. € (Vorjahr: 18,3 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 15,5 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2012 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

in Tsd. €	2012	2011
Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung		
1 – 30 Tage	1.439	832
31 – 60 Tage	458	925
61 – 90 Tage	3.636	1.231
91 – 180 Tage	105	1.215
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	5.638	4.203

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 1,3 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

in Tsd.€	2012	2011
Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung		
91 – 180 Tage	368	148
181 – 360 Tage	535	300
> 360 Tage	366	302
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	1.269	750

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash Bestand von 32,3 Mio.€ aus (Vorjahr: 42,0 Mio.€). Der Free Cashflow belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf -4,5 Mio.€ (Vorjahr: 3,5 Mio.€).

Das 2007 begebene Schuldscheindarlehen in Höhe von 9,0 Mio.€ war im Dezember 2012 zur Rückzahlung fällig und wurde aus den vorhandenen liquiden Mitteln getilgt.

Derzeit stellen drei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums eine Kredit- und Avallinie von 7,5 Mio.€, die zunächst bis zum 31. März 2013 befristet ist. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio.€ steht der Süss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinien des Bankenkonsortiums über den 31. März 2013 hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei einzelnen Kunden, die auf solche Bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen verzichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung von einzelnen Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für Stornierungen von Aufträgen erhöhen. Zum 31. Dezember 2012 sind diese Kredit- und Avallinien lediglich in Höhe von 1,9 Mio.€ in Form von Avalen in Anspruch genommen.

Für 2013 ist geplant, die Kreditverträge mit den drei Banken des Bankenkonsortiums unter Führung der BayernLB zu verlängern, um die für die Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur Verfügung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Verträge werden voraussichtlich Ende März 2013 abgeschlossen werden. Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65% bzw. 45%. Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnpromzentigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 217 Tsd. € (Vorjahr: Erhöhung um 53 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Erhöhung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

in Tsd.€	2012		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.681	1.811	3.491
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.635	544	3.179
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.138	-138	-1.275
Kundenanzahlungen	-2.851	-156	-3.007
Netto-Exposure	327	2.061	2.388
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 prozentiger Aufwertung des Euro	-30	-187	-217

in Tsd.€	2011		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.843	6	1.849
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.671	0	1.671
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.390	-108	-1.498
Kundenanzahlungen	-2.602	0	-2.602
Netto-Exposure	-478	-102	-580
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 prozentiger Aufwertung des Euro	43	9	53

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine Bank oder über die Börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern (z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante Kursverluste entstehen.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2012 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

Prognosebericht

Laut einer Analyse des ifo Instituts München ist die gesamtwirtschaftliche Produktion in Deutschland trotz der anhaltenden europäischen Schuldenkrise gut ins Jahr 2012 gestartet. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Auslandsnachfrage nach Produkten „Made in Germany“. Im weiteren Verlauf des Jahres hat die Konjunktur jedoch mehr und mehr an Fahrt verloren, so dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal voraussichtlich sogar leicht geschrumpft sein wird. Insgesamt ergibt sich damit für 2012 ein erwartetes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,7% gegenüber dem Vorjahr, bei nahezu unveränderten Arbeitslosenzahlen und einer Inflationsrate von rund 2%. Das Börsenjahr 2012 ist, trotz einer deutlich spürbaren Unsicherheit der Handelsteilnehmer, sehr positiv verlaufen. Die wichtigsten deutschen Börsenindizes DAX, MDAX und TecDAX haben das Jahr mit deutlichen Kursgewinnen beschlossen.

Die Wirtschaftskraft der Eurozone wird im Jahr 2012 laut den Erwartungen des ifo Instituts um rund 0,5% sinken, wobei hier sehr starke regionale Unterschiede festzustellen sind. Stabil aufgestellte Länder wie z. B. Deutschland, Finnland oder Österreich werden trotz merklicher Schwäche noch ein positives Wachstum

verzeichnen können, wohingegen die Wirtschaft in den Krisenländern deutlich schrumpfen wird. Auch die Weltkonjunktur hat sich seit Jahresmitte 2012 zunehmend abgekühlt und deutlich an Dynamik verloren. Insgesamt rechnen Experten mit einem Wachstum der Weltwirtschaft 2012 von 2,4%, wobei die Schwellenländer mit rund 5,0% deutlich stärker als die fortgeschrittenen Länder mit 1,2% gewachsen sein dürften.

Für das aktuelle Wirtschaftsjahr sehen die Prognosen zum Jahresanfang 2013 deutlich schwächer aus, als dies noch Mitte 2012 der Fall war. Eine nachhaltige Belebung der Weltwirtschaft ist aus heutiger Sicht für 2013 nicht zu erwarten. Der Hauptgrund hierfür ist die weiterhin ungelöste Schuldenproblematik in Europa sowie die verlangsamte Wachstumsdynamik in den Schwellenländern und aufstrebenden Volkswirtschaften. Die Unternehmen investieren sehr zurückhaltend und auch der private Konsum zeigt bislang keine deutliche Belebung. Das ifo Institut geht von einem schwachen Winterhalbjahr 2012/13 aus und erwartet neue Wachstumsimpulse für die Weltwirtschaft erst im Verlauf des Jahres 2013, geht aber insgesamt von einem leicht positiven Wachstum aus. Eine ähnliche Erwartungshaltung gilt auch für den Euroraum, wobei das ifo Institut insgesamt 2013 von einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% ausgeht. Prognosen des VDMA erwarten für die Eurozone dagegen ein stagnierendes Wachstum.

Für Deutschland erwarten Experten eine Belebung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte, so dass insgesamt für 2013 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von abermals 0,7% ausgegangen wird.

HALBLEITERINDUSTRIE

Im Vergleich zu anderen Branchen weist die Halbleiterindustrie verschiedene Besonderheiten auf. Die Mikrochiphersteller haben in der Vergangenheit jedes Jahr die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte, bei gleichzeitig sinkenden Kosten für die Verbraucher, erhöht. Die Entwicklung ist getrieben von Moore's Law, welches besagt, dass sich circa alle 18 Monate die Größe eines Mikrochips halbiert, der Preis aber nur um 50% ansteigt. Da die Strukturgrößen jedoch nicht unendlich verkleinert werden können, sucht die Branche bereits seit Jahren nach Alternativen, um die Komplexität und Leistungsfähigkeit der Mikrochips auch ohne Strukturverkleinerungen zu erhöhen und die

Kosten pro Mikrochip zu senken. Dabei stehen Themen wie der Einsatz von 450 mm Wafern oder das Stapeln gedünnter Mikrochips ganz oben auf der Agenda. Die Technologiethemata der Vergangenheit und der Zukunft sind von großen Investmentzyklen begleitet, die die Halbleiterbranche zu einem sehr volatilen Industriezweig machen.

Aus diesem Grund ist kaum eine Industrie so zyklisch und unterliegt so starken Schwankungen wie die Halbleiterbranche. Wie schwierig es ist, diesen Markt einzuschätzen, zeigt die Entwicklung der Prognosen von Forschungsinstituten 2012. Noch im März 2012 hatte das Marktforschungsinstitut Gartner seine Schätzungen für das Wachstum im Halbleitersegment für 2012 von rund 2% auf rund 4% angehoben, dies hätte einem Gesamtmarktvolumen von 316 Mrd. USD entsprochen. Der Anstieg wurde im Wesentlichen für das zweite Halbjahr 2012 erwartet. Ende Dezember 2012 hat Gartner seine Schätzungen deutlich revidiert und hat einen Rückgang im Halbleitersegment von rund 3% für 2012 in Aussicht gestellt, dies entspricht einem Marktvolumen von 298 Mrd. USD. Die Semiconductor Industry Association hat im Januar 2013 einen Rückgang im Halbleitersegment um 2,7% prognostiziert. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen die Einschätzungen dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bedeuten.

Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet Gartner einen erneuten Anstieg der Nachfrage nach Halbleiterprodukten. Der Markt wird erwartungsgemäß um 4,5% gegenüber 2012 steigen und kann somit ein Gesamtvolumen von rund 311 Mrd. USD erreichen. Die wesentlichen Wachstumstreiber werden die weiter ansteigende Nachfrage nach Tablet-Computern und Smartphones, die insbesondere die Nachfrage nach NAND-Speichern beflügelt, sein. Der PC-Markt und der Markt für DRAM-Speicher wird sich nach Angaben von Gartner auch 2013 schwach entwickeln, wobei für DRAM ein erneuter Anstieg in der zweiten Jahreshälfte 2013 erwartet wird.

in der Volumenproduktion in den Markt eingeführt. Diese neueste Generation von Bonding Equipment kann für das permanente Bonden von Wafern oder für das Debonden und Reinigen von 200 mm und 300 mm Wafern konfiguriert werden. Der Einsatzbereich der XBC300 Gen2 umfasst Produktion wie auch Prozessentwicklung. Darüber hinaus wurde im März 2012 mit der RCD8 eine neue manuelle Geräteplattform zum Belackern und Entwickeln von Substraten in den Markt eingeführt. Eine hohe Flexibilität in den Anwendungsbereichen bei gleichzeitig niedrigen Investitionskosten zeichnet die neue Plattform aus. In der zweiten Jahreshälfte hat SÜSS MicroTec mit der dritten Generation der ACS200 eine neuentwickelte Automatenplattform zum Belackern und Entwickeln in den Markt eingeführt. Das Gerät verbindet sowohl innovative Technologien als auch produktionserprobte Komponenten der bewährten ACS200Plus und Gamma-Plattform.

Mit der Übernahme sämtlicher Anteile an der Süss MicroOptics S.A. und dem Umzug an einen neuen modernen Standort haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Konzentration auf strategisch wichtige Geschäftsbereiche vollzogen und haben das Unternehmen, mit seinen für uns wichtigen lithografischen Schlüsseltechnologien, fest in die SÜSS MicroTec-Gruppe eingebunden. Auf der Produkt- und Technologieseite haben wir uns mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc., Corona, USA, verstärkt. Tamarack Scientific entwickelt, produziert und vertreibt UV-Projektionsbelichtungsgeräte sowie laserbasierte Mikrostrukturierungssysteme. Schwerpunktmärkte sind Advanced Packaging, 3D-Integration, MEMS und LED. Mit der Akquisition von Tamarack Scientific verfolgt SÜSS MicroTec eine Konsolidierungsstrategie im Halbleiter Backend und ergänzt die vorhandene Lithografie-Kompetenz um die Projektionsbelichtung, die komplementär zur bestehenden Belichtungs-Kompetenz ist.

Auch 2012 sind wir verschiedene Kooperationen eingegangen, beispielhaft seien hier die Zusammenarbeit mit der GenlSys und Dow Corning genannt.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS

Sieht man von makroökonomischen Gegebenheiten wie der Schuldenproblematik in Europa, dem verlangsamten Wachstum in Schwellenländern, sowie fiskalpolitischen Einschnitten ab, so sind die Wachstumstrends wie E-Mobility, Digital Lifestyle und Energy Efficiency, weiterhin langfristig intakt.

Aufgrund des zum Jahresende 2012 gebuchten Auftragsbestands, des schwachen Konjunkturausblicks und des verhaltenen Starts in das Jahr 2013 rechnen wir insgesamt für das Geschäftsjahr 2013 mit einem Umsatz von rund 150 Mio.€ und einem EBIT im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Segment Lithografie wird auch 2013 wieder den größten Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis liefern. Aufgrund geringerer Umsätze und zusätzlicher Belastungen durch die Integration der Tamarack Scientific wird jedoch das EBIT geringer ausfallen als im aktuellen Geschäftsjahr. Im Bereich Substrat Bonder erwarten wir einen Umsatzanstieg, jedoch weiterhin ein negatives Ergebnis. Die Umsätze des Segments Fotomasken Equipment werden im kommenden Jahr in etwa das gleiche Niveau erreichen wie 2012 bei einem verbesserten EBIT. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

Die bisher veröffentlichten Marktstudien stellen für 2014 aufgrund des zyklischen Aufschwungs der Halbleiterindustrie ein erneutes Wachstum für die von SÜSS MicroTec adressierten Märkte im Halbleiter Mid- und Backend in Aussicht. Wir gehen daher für 2014 von einem Umsatzwachstum im leicht zweistelligen Prozentbereich aus.

Vorausschauende Aussagen

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 14. März 2013
Der Vorstand



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand

KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2012

071 Konzernabschluss nach IFRS

- 072 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
- 073 Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
- 074 Konzernbilanz (IFRS)
- 076 Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)
- 078 Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)
- 080 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2012
- 082 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2011
- 084 Segmentberichterstattung (IFRS)

086 Anhang zum Konzernabschluss

- 103 Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
- 111 Erläuterungen zu den Aktiva
- 115 Erläuterungen zu den Passiva

117 Aktienoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

- 127 Sonstige Angaben

140 Versicherung der gesetzlichen Vertreter

141 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (IFRS)

in Tsd.€	Anhang	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
Umsatzerlöse	(3)	163.827	175.427
Umsatzkosten	(4)	-106.437	-109.069
Bruttoergebnis vom Umsatz		57.390	66.358
Vertriebskosten		-20.673	-19.001
Forschungs- und Entwicklungskosten		-9.705	-12.936
Verwaltungskosten		-16.976	-15.719
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	6.069	4.767
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-4.365	-4.894
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT)			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		18.581	24.926
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-6.841	-6.351
Operatives Ergebnis (EBIT)		11.740	18.575
Finanzerträge		940	2.017
Finanzaufwendungen		-929	-996
Finanzergebnis	(7)	11	1.021
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern		11.751	19.596
Ertragsteuern	(8)	-4.131	-5.789
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten		7.620	13.807
Gewinn / Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern)		1.507	-21
Gewinn		9.127	13.786
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		9.097	13.513
Davon Minderheitsanteile		30	273
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,40	0,72
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,08	0,00
Ergebnis je Aktie (verwässert)	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,40	0,71
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,08	0,00

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS)

in Tsd.€	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
Periodenergebnis	9.127	13.786
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	9	-30
Fremdwährungsanpassung	228	-146
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-189	-230
Latente Steuern	22	70
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	70	-336
Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen	9.197	13.450
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	9.158	13.160
Davon Minderheitsanteile	39	290

KONZERNBILANZ (IFRS)

AKTIVA in Tsd.€	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
Langfristige Vermögenswerte		36.998	37.691
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	7.504	8.568
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	15.394	13.599
Sachanlagen	(13)	12.068	9.462
Steuererstattungsansprüche	(19)	80	87
Sonstige Vermögenswerte	(14)	773	592
Latente Steueransprüche	(8)	1.179	5.383
Kurzfristige Vermögenswerte		143.088	150.055
Vorräte	(15)	82.179	71.632
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	21.758	17.790
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	547	756
Wertpapiere	(18)	11.394	19.362
Steuererstattungsansprüche	(19)	295	686
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		25.192	37.036
Sonstige Vermögenswerte	(20)	1.723	2.793
Bilanzsumme		180.086	187.746

PASSIVA in Tsd. €	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
Eigenkapital		128.108	120.393
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		128.108	119.704
Gezeichnetes Kapital	(21)	19.116	19.101
Rücklagen	(21)	109.944	101.616
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-952	-1.013
Minderheitsanteile		0	689
Langfristige Schulden		9.797	10.500
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	2.877	2.872
Rückstellungen	(23)	296	348
Finanzschulden	(24)	3.981	4.279
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(25)	2.577	244
Latente Steuerschulden	(8)	66	2.757
Kurzfristige Schulden		42.181	56.853
Rückstellungen	(26)	3.602	3.322
Steuerschulden		1.050	5.734
Finanzschulden	(24)	288	10.131
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(27)	6.815	5.995
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.862	7.582
Sonstige Verbindlichkeiten	(28)	23.564	24.089
Bilanzsumme		180.086	187.746

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)

in Tsd.€	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
Gewinn (nach Steuern)	9.127	13.786
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	4.661	4.211
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.180	2.140
Aktivierete Eigenleistungen	0	-291
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	-127
Ergebnis aus dem Abgang der Cascade-Aktien	0	-833
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	2.729	189
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	70	-194
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	0	45
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-480	0
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-1.469	-566
Gewinn aus nachträglicher Kaufpreiszahlung für den Bereich Test	-1.507	0
Veränderung des Vorratsvermögens	-4.712	-7.682
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3.910	-1.325
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	1.808	335
Veränderung der Pensionsrückstellungen	5	-47
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-555	-2.441
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-10.025	-4.565
Veränderung der latenten Steuern	1.513	3.506
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-565	6.141

in Tsd.€	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-3.377	-2.462
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-801	-895
Auszahlungen für den Erwerb von kurzfristigen zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	-3.071	-9.067
Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	11.046	3.099
Einzahlungen aus dem Verkauf der Cascade-Aktien	0	3.333
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	0	732
Einzahlungen aus nachträglicher Kaufpreiszahlung für den Bereich Test	1.507	0
Auszahlungen für den Erwerb Tamarack Scientific	-5.184	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	120	-5.260
Tilgung von Bankdarlehen	-180	-180
Tilgung des Schuldscheindarlehens	-9.000	0
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-118	28
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-843	-924
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an der Suss MicroOptics	-1.155	0
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	19	494
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-11.277	-582
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-122	212
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-11.844	511
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang	37.036	36.525
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	25.192	37.036
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	816	420
Zinseinnahmen während der Periode	1.052	1.031
Steuerzahlungen während der Periode	6.801	2.170
Steuererstattungen während der Periode	0	16

KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS)

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage
Stand 01.01.2011	18.721	98.225
Ausübung von Aktienoptionen	380	114
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		45
Periodenergebnis		
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen		
Gesamtergebnis		
Stand 31.12.2011	19.101	98.384
Stand 01.01.2012	19.101	98.384
Ausübung von Aktienoptionen	15	4
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Periodenergebnis		
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen		
Gesamtergebnis		
Erwerb von Minderheitenanteilen SMO		-773
Stand 31.12.2012	19.116	97.615

	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn / -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Minderheitsanteile	Eigenkapital
	433	-10.714	-659	106.006	398	106.404
				494		494
				45		45
		13.513		13.513	273	13.786
			-354	-354	18	-336
		13.513	-354	13.159	291	13.450
	433	2.799	-1.013	119.704	689	120.393
	433	2.799	-1.013	119.704	689	120.393
				19		19
				0		0
		9.097		9.097	30	9.127
			61	61	9	70
		9.097	61	9.158	39	9.197
				-773	-728	-1.501
	433	11.896	-952	128.108	0	128.108

ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS ANLAGESPIEGEL 2012

in Tsd. €	HISTORISCHE ANSCHAFFUNGS- BZW. HERSTELLUNGSKOSTEN					
	01.01.2012	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Zugang aus Erwerb Tamarack Scientific	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.568	-22	727	838	0	0
2. Entwicklungskosten	29.269	-14	74	0	0	0
3. Aktivierte Leasinggegenstände						
Software	3.197	-29	0	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögensgegenstände	960	0	0	1.962	0	0
	48.994	-65	801	2.800	0	0
II. Geschäfts- oder Firmenwert	32.436	0	0	1.795	0	0
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.542	-111	396	25	0	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.078	17	1.851	1.334	0	0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.680	-62	936	95	0	20
4. Fahrzeuge	373	-1	5	0	0	4
5. Anlagen im Bau	16	0	191	0	0	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Technische Anlagen und Maschinen	771	-46	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	719	-5	0	0	0	0
Fuhrpark	38	-5	0	0	0	0
	23.217	-213	3.379	1.454	0	24
IV. Finanzanlagen						
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0	0
	2.263	0	0	0	0	0

	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN						RESTBUCHWERTE		
	31.12.2012	01.01.2012	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
	17.111	13.706	-21	763	0	0	14.448	1.862	2.663
	29.329	23.823	-11	2.519	0	0	26.331	5.446	2.998
	3.168	2.236	-29	887	0	0	3.094	961	74
	2.922	661	0	492	0	0	1.153	299	1.769
	52.530	40.426	-61	4.661	0	0	45.026	8.568	7.504
	34.231	18.837	0	0	0	0	18.837	13.599	15.394
	7.852	1.592	-77	462	0	0	1.977	5.950	5.875
	7.280	3.004	16	722	0	0	3.742	1.074	3.538
	10.629	7.379	-55	943	0	19	8.248	2.301	2.381
	373	353	-1	4	0	4	352	20	21
	207	0	0	0	0	0	0	16	207
	725	712	-45	38	0	0	705	59	20
	714	714	-5	3	0	0	712	5	2
	33	1	0	8	0	0	9	37	24
	27.813	13.755	-167	2.180	0	23	15.745	9.462	12.068
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0

ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS ANLAGESPIEGEL 2011

in Tsd.€	HISTORISCHE ANSCHAFFUNGS- BZW. HERSTELLUNGSKOSTEN				
	01.01.2011	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.264	40	783	-353	166
2. Entwicklungskosten	28.452	0	112	727	22
3. Aktivierte Leasinggegenstände					
Software	3.178	19	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögensgegenstände	960	0	0	0	0
	47.854	59	895	374	188
II. Geschäfts- oder Firmenwert	32.436	0	0	0	0
III. Sachanlagen					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.195	102	507	778	1.040
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.082	380	510	-480	8.414
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.447	104	920	140	1.931
4. Fahrzeuge	477	6	19	0	129
5. Anlagen im Bau	67	2	759	-812	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Technische Anlagen und Maschinen	845	42	0	0	116
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766	3	0	0	50
Fuhrpark	0	0	38	0	0
	31.879	639	2.753	-374	11.680
IV. Finanzanlagen					
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0
	2.263	0	0	0	0

	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN						RESTBUCHWERTE		
	31.12.2011	01.01.2011	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
	15.568	13.359	30	550	-76	157	13.706	1.905	1.862
	29.269	20.869	0	2.518	436	0	23.823	7.583	5.446
	3.197	1.330	19	887	0	0	2.236	1.848	961
	960	405	0	256	0	0	661	555	299
	48.994	35.963	49	4.211	360	157	40.426	11.891	8.568
	32.436	18.837	0	0	0	0	18.837	13.599	13.599
	7.542	2.144	84	376	0	1.012	1.592	5.051	5.950
	4.078	10.342	338	842	-480	8.038	3.004	1.740	1.074
	9.680	8.123	89	844	120	1.797	7.379	2.324	2.301
	373	427	4	27	0	105	353	50	20
	16	0	0	0	0	0	0	67	16
	771	729	40	47	0	104	712	116	59
	719	758	3	3	0	50	714	8	5
	38	0	0	1	0	0	1	0	37
	23.217	22.523	558	2.140	-360	11.106	13.755	9.356	9.462
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS) SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSFELDERN

in Tsd. €	Lithografie		Substrat Bonder		Fotomaschinen Equipment	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Außenumsatz	113.194	111.500	23.149	20.474	22.869	36.345
Innenumsatz	0	0	0	0	0	0
Gesamter Umsatz	113.194	111.500	23.149	20.474	22.869	36.345
Segmentergebnis (EBIT)	23.689	25.541	-12.009	-11.085	1.104	5.264
Ergebnis vor Steuern	23.493	25.468	-12.009	-11.087	1.099	5.260
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-) / Erträge (+)	1.980	-831	-2.335	-2.394	-190	-393
Segmentvermögen	76.617	57.893	39.869	36.229	11.306	17.593
davon Geschäfts- oder Firmenwert	15.394	13.599	0	0	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
Konzernaktiva						
Segmentverschulden	-26.757	-21.800	-4.929	-8.500	-2.443	-6.065
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
Konzernschulden						
Abschreibungen	2.264	1.621	2.174	2.098	604	629
davon planmäßig	2.264	1.621	2.174	2.098	604	629
davon außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
Investitionen	5.231	1.418	199	921	60	329
Mitarbeiter zum 31.12.	419	340	134	136	106	106

SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN

in Tsd. €	Umsatzerlöse (fortgeführte Aktivitäten)		Investitionen		Vermögen (ohne Goodwill)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Europa	40.520	40.160	3.856	2.607	98.140	96.085
Nordamerika	30.276	29.461	4.536	880	20.425	7.707
Japan	16.518	12.983	3	41	3.689	3.945
Sonstiges Asien	76.513	92.775	37	120	1.544	1.447
Rest der Welt	0	48	0	0	0	0
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-290	-1.731
Gesamt	163.827	175.427	8.432	3.648	123.508	107.453

Sonstige		Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten (Test Business)		Konsolidierungseffekte		Summe	
2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
4.615	7.108	163.827	175.427	0	382	-	-	163.827	175.809
8.387	6.973	8.387	6.973	0	0	-8.387	-6.973	0	0
13.002	14.081	172.214	182.400	0	382	-8.387	-6.973	163.827	175.809
-1.044	-1.145	11.740	18.575	1.507	-21	-	-	13.247	18.554
-832	-45	11.751	19.596	1.507	-23	-	-	13.258	19.573
22	-44	-523	-3.662	0	0	-	-	-523	-3.662
11.110	9.337	138.902	121.052	0	0	-	-	138.902	121.052
0	0	15.394	13.599	0	0	-	-	15.394	13.599
								41.184	66.694
								180.086	187.746
-3.376	-2.126	-37.505	-38.491	0	0	-	-	-37.505	-38.491
								-14.473	-28.862
								-51.978	-67.353
1.799	2.003	6.841	6.351	0	0	-	-	6.841	6.351
1.799	2.003	6.841	6.351	0	0	-	-	6.841	6.351
0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
2.942	980	8.432	3.648	0	0	-	-	8.432	3.648
45	42	704	624	0	0	-	-	704	624

ANHANG ZUM IFRS – KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2012

(1) Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Corona (seit März 2012) in den USA und Neuchâtel in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2012 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB und das International Financial Reporting Interpretations Committee haben den nachfolgenden Standard geändert; der geänderte Standard ist verpflichtend im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 anzuwenden:

IFRS 7: „ANHANGANGABEN - ÜBERTRAGUNG FINANZIELLER VERMÖGENSWERTE“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 22. November 2011 wurde die Verordnung Nr. 1205 / 2011 bekannt gemacht, mit der die vom IASB am 7. Oktober 2010 veröffentlichten Änderungen an IFRS 7 „Anhangangaben – Übertragungen finanzieller Vermögenswerte“ übernommen wurden. Die Änderungen an IFRS betreffen erweiterte Angabepflichten bei der Übertragung finanzieller Vermögenswerte und sollen den Bilanzadressaten ein besseres Verständnis der Auswirkungen der beim Unternehmen verbleibenden Risiken ermöglichen. Diese Änderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

C) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat den nachfolgend dargestellten Standard herausgegeben, dessen Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) erfordert:

IFRS 9: „FINANCIAL INSTRUMENTS“

Im November 2009 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 9 „Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Dieser Standard ist der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“. Im Oktober 2010 veröffentlichte das IASB Vorschriften zur Bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten, die den IFRS 9 „Financial Instruments“ ergänzen und die Phase zur Klassifizierung und Bewertung des IASB-Projekts zur Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ abschließen. Ergänzend zum IFRS 9 (2009) enthält der IFRS 9 (2010) Regelungen für die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten sowie zur Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Am 16. Dezember 2011 hat das IASB unter dem Titel „Verpflichtender Anwendungszeitpunkt und Anhangangaben bei Übergang“ Änderungen an IFRS 9 veröffentlicht.

Gemäß der Methodik von IFRS 9 sind finanzielle Vermögenswerte entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer der beiden Bewertungskategorien hängt davon ab, wie das Unternehmen seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschäftsmodell) und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermögenswerte haben.

Der Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard von der EU in dieser Form übernommen wird.

Die nachfolgend dargestellten neuen und geänderten Standards wurden bereits von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, sind jedoch im Geschäftsjahr 2012 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Von einer vorzeitigen Anwendung der neuen und geänderten Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

IFRS 10: „CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“, mit dem eine einheitliche Definition für den Begriff „Beherrschung“ und damit eine einheitliche Grundlage für das Vorliegen einer Mutter-Tochter-Beziehung und die hiermit verbundene Abgrenzung des Konsolidierungskreises geschaffen wird. Der neue Standard ersetzt die bisher relevanten IAS 27 (2008) „Consolidated and Separate Financial Statements“ und SIC-12 „Consolidation – Special Purpose Entities“.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 10 übernommen wurde.

IFRS 10 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 11 und IFRS 12 sowie mit den in 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IFRS 11: „JOINT ARRANGEMENTS“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 11 „Joint Arrangements“. Der Standard regelt die Bilanzierung von Sachverhalten, in denen ein Unternehmen gemeinschaftliche Führung (joint control) über ein Gemeinschaftsunternehmen (joint venture) oder eine gemeinschaftliche Tätigkeit (joint operation) ausübt. Der neue Standard ersetzt IAS 31 „Interests in Joint Ventures“ und SIC-13 „Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturers“ als die bisher für Fragen der Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen einschlägigen Vorschriften.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 11 übernommen wurde.

IFRS 11 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 12 sowie mit den in 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IFRS 12: „DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 12 „Disclosure of Interests in Other Entities“. Aus dem Standard ergeben sich die Anhangangaben zu Unternehmensverbindungen im Konzernabschluss (neuer IFRS 10) und Joint Arrangements (neuer IFRS 11).

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 12 übernommen wurde.

IFRS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 11 sowie mit den in 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 27 (2011): „SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den geänderten Standard IAS 27 (2011) „Separate Financial Statements“. Im Rahmen der Verabschiedung des IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“ werden die Regelungen für das Kontrollprinzip und die Anforderungen an die Erstellung von Konzernabschlüssen aus dem IAS 27 ausgelagert und abschließend im IFRS 10 behandelt (siehe Ausführungen zu IFRS 10). Im Ergebnis enthält IAS 27 künftig nur die Regelungen zur Bilanzierung von Tochtergesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen in IFRS-Einzelabschlüssen.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 27 (2011) übernommen wurden.

IAS 27 (2011) ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 28 (2011): „INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den geänderten Standard IAS 28 (2011) „Investments in Associates and Joint Ventures“. Im Rahmen der Verabschiedung des IFRS 11 „Joint Arrangements“ erfolgten auch Anpassungen des IAS 28, dessen Anwendungsbereich durch den neuen IFRS 11 erheblich erweitert wird.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 28 (2011) übernommen wurden.

IAS 28 (2011) ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IFRS 13: „FAIR VALUE MEASUREMENT“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 13 „Fair Value Measurement“. Der Standard befasst sich mit der Zeitwertermittlung sowie mit zugehörigen Anhangangaben und verfolgt das Ziel einer weiteren Annäherung der IFRS und der US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze (US GAAP).

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1255 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 13 übernommen wurde.

IFRS 13 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 19: „LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER“

Am 16. Juni 2011 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“. Der geänderte Standard regelt, dass künftig unerwartete Schwankungen der Pensionsverpflichtungen sowie etwaiger Planvermögensbestände unmittelbar im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) erfasst werden müssen. Das bisherige Wahlrecht zwischen sofortiger Erfassung im Gewinn oder Verlust, im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) oder der zeitverzögerten Erfassung nach der sogenannten Korridormethode wird abgeschafft. Zudem werden derzeit die erwarteten Erträge des Planvermögens anhand der subjektiven Erwartungen des Managements über die Wertentwicklung des Anlageportfolios ermittelt. Mit Anwendung des geänderten IAS 19 ist nur noch eine typisierende Verzinsung des Planvermögens in Höhe des aktuellen Diskontierungszinssatzes der Pensionsverpflichtung zulässig.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 6. Juni 2012 wurde die Verordnung Nr. 475 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 19 übernommen wurden.

Der geänderte IAS 19 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Da die SÜSS MicroTec AG derzeit die Korridormethode anwendet, würde die Änderung – bei Anwendung auf die Verhältnisse zum 31. Dezember 2012 – zu einer Erhöhung der Pensionsrückstellung um 1,358 Tsd. € führen. Mit dem Wechsel von der Korridormethode hin zur geänderten Methode bleibt die Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec AG zukünftig frei von Effekten aus versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten (z. B. aufgrund von Zinsschwankungen), da diese dann zwingend im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) zu erfassen sind.

IAS 1: „DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES“

Am 16. Juni 2011 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“. Nach dem geänderten Standard ist zukünftig die IFRS-Erfolgsrechnung formal als ein einziger Abschlussbestandteil darzustellen, dem „Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income“. Gleichwohl muss diese formal zusammengefasste Erfolgsrechnung künftig verpflichtend in zwei Sektionen unterteilt werden, die zum einen den Gewinn oder Verlust und zum anderen das sonstige Ergebnis ausweisen. Zudem verlangt der geänderte Standard, dass die Bestandteile des sonstigen Ergebnisses separat dargestellt werden als Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung reklassifiziert werden und Posten, die niemals reklassifiziert werden, sondern im sonstigen Ergebnis verbleiben.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 6. Juni 2012 wurde die Verordnung Nr. 475 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 1 übernommen wurden.

Der geänderte IAS 1 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 32: „FINANZINSTRUMENTE: DARSTELLUNG“

Am 16. Dezember 2011 veröffentlichte das IASB eine Ergänzung zum IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“, die die Voraussetzungen für die Saldierung von Finanzinstrumenten klarstellt. Zusammen mit diesen Klarstellungen wurden auch die Vorschriften zu den Anhangangaben im IFRS 7 erweitert.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1256 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichte Ergänzung des IAS 32 übernommen wurde.

Die Ergänzung zu IAS 32 ist verpflichtend retrospektiv anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. Die Änderung des IFRS 7 ist erstmals anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des true and fair views sowie der fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die Süss MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf der Basis des Nutzungswertes errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

SONSTIGE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe nicht vor.

SACHANLAGEN

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

WERTMINDERUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE UND SACHANLAGEN

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

VORRÄTE

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

FINANZINSTRUMENTE

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

WERTPAPIERE

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert, da sie nicht zu Spekulationszwecken gehalten werden. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

AKTIENBASIERTE VERGÜTUNGEN

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10% des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der jeweiligen Funktionskosten ausgewiesen.

RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

FINANZSCHULDEN

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus den Schuldscheindarlehen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

LEASING

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf Basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt, selbst wenn dieses Recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

Bei Leasingvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden, gilt in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften von IFRIC 4 der 1. Januar 2005 als Zeitpunkt des Abschlusses der Leasingvereinbarung.

Finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur Aktivierung des Leasinggegenstands zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in Finanzierungsaufwendungen und den Tilgungsanteil der Restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. Finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

Leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands abgeschrieben. Ist der Eigentumsübergang auf den Konzern am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig abgeschrieben. Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand für Operating-Leasingverhältnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

NICHT FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

UMSATZREALISIERUNG

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart ist, der Umsatz erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

UMSATZKOSTEN

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

LATENTE STEUERN

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

ERGEBNIS PRO AKTIE (EPS – EARNINGS PER SHARE)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

CASHFLOW HEDGES

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

BILANZIERUNG VON ZUSCHÜSSEN

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgesetzt.

TRANSAKTIONEN IN FREMDWÄHRUNG

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

E) VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturlagen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2012 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 617 Tsd. € (Vorjahr: 546 Tsd. €).

WERTMINDERUNGEN

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich dabei für das Segment Lithografie, dem der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 13,0 % (Vorjahr: 21,5 %). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 10,0 % (Vorjahr: 10,1 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrundeliegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sie werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Abhängig vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen sind Schätzungen notwendig, um den wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag zu bestimmen.

PURCHASE PRICE ALLOCATION

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

F) KONSOLIDIERUNG

KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

UMRECHNUNG VON JAHRESABSCHLÜSSEN IN FREMDER WÄHRUNG

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

in Tsd. €	2012		2011	
	Bilanz	G & V	Bilanz	G & V
1 EUR vs 1 USD	1,319	1,293	1,294	1,394
1 EUR vs 1 JPY	113,620	103,253	100,100	111,148
1 EUR vs 1 GBP	0,816	0,813	0,837	0,871
1 EUR vs 1 CHF	1,207	1,205	1,216	1,234
1 EUR vs 1 TWD	38,491	38,262	39,338	41,101
1 EUR vs 1 SGD	1,611	1,613	1,682	1,750
1 EUR vs 1 CNY	8,349	8,161	8,234	9,016
1 EUR vs 1 KRW	1.411,150	1.456,037	1.495,670	1.544,865
1 EUR vs 1 THB	40,333	40,300	40,775	42,850

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

ANGABEN ZUM KONSOLIDIERUNGSKREIS

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 ergaben sich folgende Veränderungen im Konsolidierungskreis:

Mit Kaufvertrag vom 29. März 2012 hat der Süß MicroTec-Konzern 100 % der Anteile an der Tamarack Scientific Co., Inc. (Corona / USA) erworben.

Mit Kaufvertrag vom 14. Mai 2012 hat die SÜSS MicroTec AG 15 % der Anteile der Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel (Schweiz) erworben und damit ihre Beteiligung von 85 % auf 100 % aufgestockt.

Weitere Veränderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Wahrung):

Gesellschaft	Wahrung	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching ⁽¹⁾	EUR	19.115.538,00	Holding	102.530.790,14	365.578,62	voll
Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching ⁽²⁾	EUR	2.000.100,00	100 %	47.282.634,75	6.556.158,50	voll
Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100 %	-42.663,42	1.592.145,18	voll
Suss MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100 %	15.393,52	-2.238,12	voll
Suss MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100 %	1.135.388,25	-14.358,48	voll
Suss MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100 %	-303.394.664,00	-46.861.317,00	voll
Suss MicroTec S.A.S., Lyon	EUR	114.750,00	100 %	879.792,06	159.009,00	voll
Suss MicroOptics S.A., Neuchatel	CHF	500.000,00	100 %	7.841.244,58	1.597.942,61	voll
Suss MicroTec Inc., Sunnyvale	USD	105.000,00	100 %	20.979.511,06	-20.818,79	voll
Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	TWD	5.000.000,00	100 %	158.218.323,00	27.946.007,00	voll
Suss MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100 %	26.498.207,23	9.805.234,64	voll
Suss MicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto	USD	24.287,00	100 %	838.700,36	33.858,36	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose ⁽³⁾	USD	1.190.442,00	53,1%	-39.579,00	-1.827,00	at cost
Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim ⁽²⁾	EUR	25.564,59	100 %	729.401,46	523.529,40	voll
Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	1.082.390,69	-292.352,28	voll
Suss MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100 %	962.657.657,00	375.190.648,00	voll
Tamarack Scientific Co. Inc., Corona ⁽⁴⁾	USD	10.400,00	100 %	1.236.063,27	-4.769.306,96	voll
Tamarack Scientific Ltd., London ⁽⁵⁾	USD	2.033,00	100 %	-51.251,00	2.677,00	voll
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand ⁽⁶⁾	EUR	52.000,00	10 %	931.696,00	-128.105,00	at cost

⁽¹⁾ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der Suss MicroTec Lithography GmbH und der Suss MicroTec Reman GmbH

⁽²⁾ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

⁽³⁾ Aufgrund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

⁽⁴⁾ Rumpfgeschäftsjahr 1. April bis 31. Dezember 2012

⁽⁵⁾ In Liquidation, Zahlen für Rumpfgeschäftsjahr vom 01. November 2011 bis 30. Juni 2012

⁽⁶⁾ Zahlen laut Jahresabschluss 31. Dezember 2011

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching, und die Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

UNTERNEHMENSERWERBE

Erwerb von 100 % an Tamarack Scientific Co., Inc.

Mit Kaufvertrag vom 29. März 2012 hat der Süss MicroTec-Konzern 100 % der Anteile an der Tamarack Scientific Co., Inc. (Corona / USA) erworben.

Tamarack Scientific entwickelt, produziert und vertreibt UV-Projektionsbelichtungsgeräte sowie laserbasierte Mikrostrukturierungssysteme. Schwerpunktmärkte sind Advanced Packaging, 3D-Integration, MEMS und LED. Die Geräte kommen sowohl in der industriellen Produktion als auch in der Forschung und Entwicklung zum Einsatz. Mit der Akquisition von Tamarack Scientific verfolgt Süss MicroTec eine Konsolidierungsstrategie im Halbleiter Backend und ergänzt die vorhandene Lithografie-Kompetenz um die Projektionsbelichtung.

Der Erwerb der Anteile und Vermögenswerte bzw. Schulden wird im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG nach den International Financial Reporting Standards als Unternehmenszusammenschluss gemäß IFRS 3 (rev. 2008) abgebildet. In diesem Zusammenhang sind die erworbenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden (mit einzelnen Ausnahmen) zu ihrem beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt anzusetzen (IFRS 3.18). Hierbei sind – nach den Vorschriften des IFRS 3 in Verbindung mit IAS 38 – nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

Vor diesem Hintergrund wurde für die erworbenen Vermögenswerte und Schulden eine Purchase Price Allocation durchgeführt. Die erworbenen Vermögenswerte und Schulden wurden im Erstkonsolidierungszeitpunkt, dem 31. März 2012, wie folgt angesetzt:

in Tsd. USD	Buchwert nach IFRS per 31.03.2012	Bei Erwerb angesetzt (gemäß PPA)
Immaterielle Vermögenswerte	1.146	3.733
Sachanlagen	1.728	1.938
Sonstige langfristige Vermögenswerte	300	300
Kurzfristige Vermögenswerte	12.820	14.881
Summe Vermögenswerte	15.994	20.852
Langfristige Schulden	-	-
Kurzfristige Schulden	9.181	9.181
Summe Schulden	9.181	9.181
Nettovermögen	6.813	11.671
Anschaffungskosten		9.340
Rückstellungen für Earn-Out		4.697
Geschäfts- oder Firmenwert		2.366

Im Erstkonsolidierungszeitpunkt wurden bisher nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von rund 2,6 Mio. USD aktiviert, die zum größten Teil die erworbene Technologie betreffen. Die Bewertung der Technologie basiert auf einer Planung für die Jahre 2012 bis 2020 und den daraus resultierenden Zahlungsströmen. Darüber hinaus wurden stille Reserven in den Sachanlagen in Höhe von 0,2 Mio. USD aufgedeckt. In den kurzfristigen Vermögenswerten wurden stille Reserven in Höhe von rund 2,0 Mio. USD angesetzt, die Maschinen und unfertige Erzeugnisse des Vorratsvermögens betreffen. Die kurzfristigen Vermögenswerte beinhalten außerdem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,4 Mio. USD. Stille Reserven sind hier nicht enthalten.

Neben dem fixen Kaufpreis von rund 9,34 Mio. USD ist eine variable Kaufpreiskomponente vereinbart, die von der Umsatz- und Margenentwicklung der kommenden drei Jahre abhängt. Die Höhe der voraussichtlichen Earn-Out-Verpflichtung wurde anhand der vorliegenden Unternehmensplanungen auf rund 6,8 Mio. USD geschätzt. Davon entfallen rund 5,6 Mio. USD auf die beiden bisherigen Anteilseigner der Tamarack Scientific Co., Inc., die ihre Anteile an Süss MicroTec verkauft haben. Die übrigen 1,2 Mio. USD entfallen auf fünf Mitarbeiter, denen in der Vergangenheit Aktienoptionen gewährt wurden und die deshalb im Kaufvertrag ebenfalls als Anteilseigner behandelt wurden.

Der Earn-Out, der auf die beiden bisherigen Anteilseigner entfällt, wurde in der Purchase Price Allocation als Kaufpreis behandelt und im Rahmen der Erstkonsolidierung in Höhe des Barwerts von rd. 4,7 Mio. USD passiviert. Der variable Kaufpreis, der auf die fünf Mitarbeiter entfällt, wird als Vergütung für Arbeitsleistung angesehen und über einen Zeitraum von 24 Monaten ratierlich zugeführt. In 2012 wurden für den variablen Kaufpreis, der auf die fünf Mitarbeiter entfällt, rund 0,4 Mio. USD aufwandswirksam passiviert.

Zum 31. Dezember 2012 wurde eine Neueinschätzung der Earn-Out-Verpflichtung vorgenommen und die Beträge entsprechend angepasst. Anhand der vorliegenden Unternehmensplanungen für Tamarack Scientific wurde die Höhe der gesamten Earn-Out Verpflichtung zum 31. Dezember 2012 auf rund 3,43 Mio. USD (nominal) geschätzt. Von den bisher für den variablen Kaufpreis gebildeten Rückstellungen konnten somit zum 31. Dezember 2012 rund 2,7 Mio. USD ertragswirksam aufgelöst werden.

In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind die Erträge und Aufwendungen der Tamarack Scientific Co., Inc. der Monate April bis Dezember 2012 eingeflossen. In diesem Zeitraum trug Tamarack Scientific mit Umsätzen von 1,9 Mio. € sowie einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von -2,9 Mio. € zum Konzernumsatz und -ergebnis bei. Darüber hinaus resultiert aus der Abwertung der durch die Purchase Price Allocation aufgedeckten stillen Reserven, der Zuführung zur Earn-Out-Verbindlichkeit für die Mitarbeiter und der Neubeurteilung der Earn-Out-Verbindlichkeiten zum Jahresende ein zusätzlicher positiver Ergebnisbeitrag von 1,2 Mio. €. Hätte der SÜSS MicroTec-Konzern die Tamarack Scientific bereits zum Beginn der Berichtsperiode erworben, betrügen die Konzernumsätze 167,0 Mio. € und das Konzernergebnis nach Steuern 6,1 Mio. € (fortgeführte Aktivitäten).

Aufstockung der Beteiligung Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel (Schweiz) auf 100 %

Mit Kaufvertrag vom 14. Mai 2012 hat die SÜSS MicroTec AG 15 % der Anteile der Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel (Schweiz) erworben und damit ihre Beteiligung von 85 % auf 100 % aufgestockt. Der fixe Kaufpreis betrug 1,35 Mio. CHF und wurde im Mai 2012 ausbezahlt. Neben dem fixen Kaufpreis wurde mit den Verkäufern ein variabler Kaufpreis vereinbart, der in den Jahren 2013 bis 2015 zur Auszahlung kommen wird. Der variable Kaufpreis beläuft sich auf rund 0,45 Mio. CHF (nominal); hierfür wurden entsprechende Rückstellungen passiviert.

Im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG wurde der Kauf der Anteile gemäß IAS 27 als Eigenkapitaltransaktion abgebildet. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem gesamten Kaufpreis von 1,8 Mio. CHF und dem niedrigeren Buchwert der erworbenen Minderheiten betrug rund 0,8 Mio. € und wurde mit der Konzernkapitalrücklage verrechnet.

G) NICHT FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN

In 2010 hat sich die SÜSS MicroTec AG von ihrem Geschäft mit Test Systemen getrennt und das Segment Test Systeme zum 28. Januar 2010 veräußert. Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren die Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH. Zudem wurden einzelne Vermögenswerte von Auslandstöchtern veräußert, die ebenfalls dem Bereich Test Systeme zugeordnet waren.

Der Kaufpreis für das Segment Test Systeme bestand aus einem festen und einem treuhänderisch verwalteten Anteil. Die fixe Komponente betrug 4,5 Mio. €, wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Käuferin (Cascade Microtech Inc.) bezahlt wurden. Ein weiterer Betrag von 2,5 Mio. € wurde auf ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten Bedingungen abhängig war, die nach der Transaktion von dem Verkäufer erfüllt werden mussten und zu einer entsprechenden Kaufpreisanpassung führten. Bis zum 31. Dezember 2011 sind der SÜSS MicroTec AG aus diesem Treuhandkonto 0,8 Mio. € zugeflossen. Darüber hinaus hat die SÜSS MicroTec AG aus Kaufpreisanpassungen 0,8 Mio. € erhalten. Im Februar 2012 wurden die auf den Treuhandkonten verbliebenen Beträge in Höhe von 1,5 Mio. € an die SÜSS MicroTec AG ausbezahlt. Daraus resultierte in 2012 ein positives Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 1.507 Tsd. €.

Im Januar 2010 wurde die Suss MicroTec Test Systems GmbH entkonsolidiert.

Das Ergebnis des Segments Test Systeme, das in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wurde, stellte sich wie folgt dar:

in Tsd.€	2012	2011
Umsatzerlöse	0	382
Kosten und Aufwendungen	0	-403
Erträge aus nachträglicher Kaufpreiszahlung	1.507	0
Gewinn /Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern	1.507	-21
Ertragsteuern	0	0
Gewinn /Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern	1.507	-21

ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erläuterungen zur Konzerngewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(3) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2012	2011
Maschinen	133.083	147.846
Ersatzteile und Upgrades	16.669	13.825
Serviceleistungen	9.751	7.438
Sonstige	4.324	6.318
Umsatzerlöse	163.827	175.427

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Bereich Mikrooptik. Im Vorjahr beinhalteten die sonstigen Umsatzerlöse neben den Erlösen aus dem Bereich Mikrooptik auch Erlöse aus dem Maskengeschäft.

(4) Umsatzkosten

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 2.519 Tsd. € (Vorjahr: 2.518 Tsd. €) enthalten. Die Abschreibungen betreffen mit 769 Tsd. € (Vorjahr: 768 Tsd. €) Entwicklungsprojekte im Bereich Lithografie und mit 1.750 Tsd. € (Vorjahr: 1.750 Tsd. €) den Bereich Substrat Bonder. Darüber hinaus sind in den Umsatzkosten planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der Suss MicroTec Photomask Equipment in Höhe von 256 Tsd. € (Vorjahr: 256 Tsd. €) sowie auf die erworbene Technologie der Tamarack Scientific in Höhe von 182 Tsd. € enthalten.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von 5.170 Tsd. € (Vorjahr: 3.817 Tsd. €) eingeflossen. Dabei entfallen 1.752 Tsd. € (Vorjahr: 1.071 Tsd. €) auf Bestände des Bereichs Lithografie und 3.031 Tsd. € (Vorjahr: 2.371 Tsd. €) auf Bestände des Bereichs Substrat Bonder. Die Bestände des Bereichs Fotomasken Equipment wurden um 384 Tsd. € (Vorjahr: 375 Tsd. €) abgewertet. Auf die Bestände des Segments Sonstiges entfallen Abwertungen in Höhe von 3 Tsd. € (Vorjahr: 0 Tsd. €).

(5) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2012	2011
Fremdwährungsgewinne	2.135	3.562
Kommissionen	391	334
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	113	241
KFZ-Sachbezüge	264	197
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	127
Sonstige Zuschüsse	192	20
Rückstellungsaufösungen	480	0
Reduzierung Earn-Out-Verpflichtung Tamarack	2.107	0
Erstattungen von Versicherungen	145	0
Sonstiges	242	286
Sonstige betriebliche Erträge	6.069	4.767

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in USD und JPY) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem realisierte das Unternehmen Kursgewinne aus der Devisenkursicherung.

Die Kommissionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen im Wesentlichen Zuschüsse des Kantons Neuchâtel, die der SMO in 2012 gewährt wurden. Im Vorjahr betrafen die sonstigen Zuschüsse Zuschüsse der Arbeitsagentur für Eingliederungsmaßnahmen und Altersteilzeit.

Die Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung Tamarack Scientific resultieren aus einer Teil-Auflösung der Earn-Out-Verpflichtung, die im Rahmen der Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. passiviert wurde (1.947 Tsd. €). Darüber hinaus wurde auch ein Teil der Earn-Out-Verbindlichkeit für die Mitarbeiter aufgelöst (160 Tsd. €), die in 2012 aufwandswirksam passiviert wurde.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren im Wesentlichen aus der Süss MicroTec Lithography GmbH (163 Tsd. €) sowie aus der Tamarack Scientific Co., Inc. (296 Tsd. €).

(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd.€	2012	2011
Fremdwährungsverluste	3.423	3.856
Sonstige Steuern	395	283
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	262
Vertragsstrafen	19	125
Lizenzgebühren	12	101
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	70	50
Aufwendungen für Earn-Out Tamarack	309	0
Sonstiges	137	217
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.365	4.894

Die Fremdwährungsverluste entstanden im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in US-Dollar aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung. 574 Tsd.€ der Fremdwährungsverluste resultieren aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die SÜSS MicroTec AG gegenüber der Suss MicroTec, Inc., Sunnyvale. Dieser Betrag wurde bis zur Rückführung der Kredite im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst. Darüber hinaus sind dem Konzern Kursverluste aus Devisenkurssicherungsgeschäften entstanden.

Die Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen betrafen im Vorjahr eine Maschine der Suss MicroTec Precision Photomask, Inc. Sämtliche Vermögenswerte und Schulden der Suss MicroTec Precision Photomask, Inc. wurden im vierten Quartal 2011 im Rahmen eines Asset Deals veräußert.

Die Lizenzgebühren des aktuellen Jahres sowie des Vorjahres betrafen ebenfalls die Suss MicroTec Precision Photomask, Inc.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc. wurden einzelnen Mitarbeitern von Tamarack Scientific erfolgsabhängige Vergütungen gewährt, die innerhalb der nächsten drei Jahre zur Auszahlung kommen sollen. Diese Earn-Out-Verbindlichkeiten gegenüber den Mitarbeitern wurden – im Gegensatz zu den Earn-Out-Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern – aufwandswirksam passiviert. Im Geschäftsjahr 2012 wurden von insgesamt 24 Monatsraten acht Monatsraten als Aufwand erfasst.

(7) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzerträge in Höhe von 940 Tsd. € (Vorjahr: 2.017 Tsd. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen für Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren. In 2011 sind hier auch die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Cascade-Aktien in Höhe von 833 Tsd. € erfasst.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in Tsd. €	2012	2011
Bankverbindlichkeiten	745	749
Zinsswaps	-161	-137
Bezahlte Stückzinsen	55	186
Zinsen für Finanzierungsleasing	20	49
Avalprovisionen	48	67
Aufzinsung von Rückstellungen	186	0
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	36	82
Finanzaufwendungen	929	996

Die Höhe der gesamten Finanzaufwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten betrafen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für das im Dezember 2012 getilgte Schuldscheindarlehen (Darlehenssumme 9 Mio. €) sowie die Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels (Darlehensstand zum 31. Dezember 2012: 4,1 Mio. €). Für die Zinsswaps, die im Zusammenhang mit dem Schuldscheindarlehen stehen, ergab sich im Berichtsjahr ein positiver Effekt und damit ein Ertrag in Höhe von insgesamt 161 Tsd. €. Die Zinsaufwendungen für die Aufzinsung von langfristigen Verbindlichkeiten resultieren aus der Barwertermittlung der Earn-Out-Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc.

(8) Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2012	2011
Laufender Steueraufwand	2.596	2.223
Latenter Steuerertrag (-) / -aufwand	1.536	3.566
davon auf temporäre Differenzen	332	1.827
Gesamtaufwand	4.131	5.789

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

in %	2012	2011
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	5,50	5,50
Gewerbesteuer	12,43	12,43
Kombinierter Steuersatz	28,25	28,25
in Tsd.€	2012	2011
Ergebnis vor Steuern	11.751	19.596
Erwartete Ertragsteuern	3.320	5.536
Abweichende Steuersätze im Ausland	-946	-866
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	19	44
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	282	75
Steueraufwand Vorjahre	-73	49
Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern	2.600	1.668
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-69	-359
Steuerfreie Erträge	-1.103	-270
Dem Organträger zuzurechnendes Einkommen aus nicht fortgeführten Aktivitäten	0	-6
Sonstiges	101	-82
Effektive Ertragsteuern	4.131	5.789

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von 811 Tsd.€ (Vorjahr: 253 Tsd.€). Statt einen Steueraufwand in Höhe von 3.320 Tsd.€ auszuweisen, verbuchte das Unternehmen im Berichtsjahr einen Steueraufwand in Höhe von 4.131 Tsd.€.

Im Berichtsjahr wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von 2.600 Tsd.€ gebildet. Der größte Wertberichtigungsbedarf entstand bei den US-Gesellschaften Suss MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA), und Tamarack Scientific Co., Inc., Corona (Kalifornien / USA). Die drei US-Gesellschaften Suss MicroTec, Inc., Tamarack Scientific Co., Inc. und Suss MicroTec Precision Photomask, Inc. bilden eine „Tax Group“, deren zu versteuerndes Einkommen in den USA der Gruppenbesteuerung unterliegt. Auf Basis der aktuellen Konzernplanung wird für die Tamarack Scientific in den nächsten beiden Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Grund für das negative Ergebnis ist vor allem die für den aktuellen Auftragsbestand erwartete geringe Rohertragsmarge. Das Ergebnis der Suss MicroTec, Inc. wird in den kommenden beiden Jahren voraussichtlich leicht negativ sein. Als Grund hierfür ist unter anderem auch das geänderte Geschäftsmodell der Suss MicroTec, Inc. zu nennen, die zukünftig als Repräsentant den Vertrieb unserer Produkte im nordamerikanischen Raum durchführen wird. Bisher war die Suss MicroTec, Inc. als Reseller tätig.

Der positive Steuereffekt aus der Erzielung von steuerfreien Erträgen ist im Wesentlichen auf die Erträge aus der Auflösung der Earn-Out-Verpflichtung zurückzuführen, die im Zuge der Neuurteilung zum Jahresende erfasst wurden.

Der positive Effekt aus der Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge resultiert aus einem positiven Jahresergebnis der Süss MicroTec Precision Photomask, Inc., Sunnyvale (USA) sowie der Süss MicroTec S.A.S., Lyon (Frankreich).

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in Tsd.€	Aktiva		Passiva	
	2012	2011	2012	2011
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37	284	40	0
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	612	630	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	13	63	111
Langfristige Rückstellungen	39	20	66	62
Immaterielle Vermögenswerte	2.616	2.551	703	21
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	64	15	0	0
Finanzschulden	5	11	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	2.044	1.807
Passiver Ausgleichsposten SMT Photomask Equipment	0	0	403	515
Vorräte	182	698	68	0
Sachanlagen	0	5	82	113
Sonstiges	142	57	0	128
Verlustvorträge	885	1.099	0	0
Saldierung	-3.403	0	-3.403	0
Gesamt	1.179	5.383	66	2.757

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 27.730 Tsd.€ (Vorjahr: 21.054 Tsd.€). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 insgesamt 4.266 Tsd.€. Im Zeitraum von 2028 bis 2032 verfallen insgesamt 21.223 Tsd.€. Verlustvorträge in Höhe von 2.240 Tsd.€ sind unbegrenzt nutzbar.

Der Anstieg der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. deren Verlustvorträge sich zum Jahresende auf rund 9.076 Tsd.€ belaufen. Das positive Jahresergebnis der steuerlichen Organschaft der SÜSS MicroTec AG (mit den Organgesellschaften Süss MicroTec Lithography GmbH und Süss MicroTec REMAN GmbH) hat den im Vorjahr bei der SÜSS MicroTec AG vorhandenen Verlustvortrag ausgeglichen.

Für Verlustvorträge in Höhe von 25.663 Tsd.€ (Vorjahr: 17.906 Tsd.€) und temporäre Differenzen in Höhe von 6.500 Tsd.€ (Vorjahr: 3.409 Tsd.€) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

Nach IAS 12.74 f. ist eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorzunehmen, wenn zum einen eine zivilrechtliche Aufrechnungslage gegeben ist und zum anderen die latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden.

Im Vorjahr wurde keine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorgenommen. Wäre im Vorjahr eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern erfolgt, hätten sich – unter Berücksichtigung eines Saldierungsbetrags von 2.540 Tsd. € – zum 31. Dezember 2011 aktive latente Steuern von 2.843 Tsd. € und passive latente Steuern von 217 Tsd. € ergeben.

(9) Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in Tsd. €	2012	2011
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten	7.620	13.807
Abzüglich: Minderheitsanteile	-30	-273
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	7.590	13.534
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück)	19.108.700	18.908.799
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück)	6.838	14.510
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	18.923.309
Ergebnis je Aktie in EUR aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert	0,40	0,72
Ergebnis je Aktie in EUR aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert	0,40	0,71

In die Berechnung des Ergebnisses je Aktie des Vorjahres (verwässert) wurde der gewichtete Durchschnitt von 186.800 Aktien nicht mit einbezogen, da die Ausübungsvoraussetzungen im Vorjahr nicht erfüllt waren.

Weitere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 21.

(10) Sonstige Angaben zur IFRS-KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Neben den in der Gewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind im Geschäftsjahr auch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten erfasst worden sowie in geringem Umfang Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten vorgenommen worden.

Die Netto-Investitionen und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2012	2011
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	9.705	12.936
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten	2.519	2.518
Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten	74	112
Netto-Investitionen	-2.445	-2.406

PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in Tsd. €	2012	2011
Löhne und Gehälter	46.001	39.826
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.054	3.436
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.804	2.426
Personalaufwand	52.859	45.688

In den Löhnen und Gehältern sind Zuführungen zu den Earn-Out-Verbindlichkeiten für die Mitarbeiter von Tamarack Scientific in Höhe von 309 Tsd. € enthalten.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betragen in 2012 62.895 Tsd. € (Vorjahr: 91.111 Tsd. €).

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2012	2011
Immaterielle Vermögenswerte	4.661	4.211
Sachanlagen	2.180	2.140
Abschreibungen	6.841	6.351

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 2.519 Tsd. € (Vorjahr: 2.518 Tsd. €) wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von 763 Tsd. € (Vorjahr: 550 Tsd. €) abgeschrieben. Außerdem wurden Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurückgeleaste SAP-Software in Höhe von 887 Tsd. € (Vorjahr: 887 Tsd. €) vorgenommen. Auf die im Rahmen der Unternehmensakquisition HamaTech (umfirmiert; nun: Süss MicroTec Photomask Equipment) erworbene Technologie wurden Abschreibungen in Höhe von 256 Tsd. € (Vorjahr: 256 Tsd. €) vorgenommen. Die im Rahmen der Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific angesetzte Technologie und weitere erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden mit 236 Tsd. € abgeschrieben.

Die auf aktivierte Entwicklungsleistungen vorgenommenen Abschreibungen betreffen ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(11) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 4.507 Tsd. € (Vorjahr: 3.122 Tsd. €) Entwicklungsleistungen von 2.997 Tsd. € (Vorjahr: 5.446 Tsd. €) ausgewiesen.

In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das geleaste SAP-System mit einem Restbuchwert von 74 Tsd. € (Vorjahr: 961 Tsd. €) enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder.

Mit Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. sind dem Konzern immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 2.800 Tsd. € zugegangen. Darin enthalten ist die im Rahmen der Purchase Price Allocation angesetzte Technologie, deren Zugangswert rd. 1.905 Tsd. € betrug.

(12) Geschäfts- oder Firmenwert

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.394 Tsd. € (Vorjahr: 13.599 Tsd. €) entfällt in voller Höhe auf das Segment Lithografie. Der Geschäfts- oder Firmenwert, der auf die Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. entfällt, ist darin mit 1.795 Tsd. € enthalten. Dieser Geschäfts- oder Firmenwert wurde im Rahmen der Erstkonsolidierung mit 2.366 Tsd. USD erfasst und wird für die kommenden Jahre in USD fortgeführt.

(13) Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von 46 Tsd. € (Vorjahr: 101 Tsd. €) auch geleaste technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleaster Fuhrpark enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrunde liegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

Mit Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. sind dem Konzern Sachanlagen in Höhe von insgesamt 3.379 Tsd. € zugegangen.

(14) Sonstige (langfristige) Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie Aktivwerte von Zeitkontenrückdeckungen und geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in Tsd.€	2012	2011
Rückdeckungsversicherung	346	380
Kautionen	418	212
Sonstiges	9	0
Sonstige langfristige Vermögenswerte	773	592

(15) Vorräte

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in Tsd.€	2012	2011
Materialien und Hilfsstoffe	27.527	24.382
Unfertige Erzeugnisse	33.997	23.128
Fertigerzeugnisse	14.586	19.970
Demonstrationsgeräte	18.960	12.469
Handelswaren	371	211
Wertberichtigungen	-13.262	-8.528
Vorratsvermögen	82.179	71.632

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2012 bilanzierten Vorräte in Höhe von 82.179 Tsd.€ (Vorjahr: 71.632 Tsd.€) sind 33.960 Tsd.€ (Vorjahr: 7.210 Tsd.€) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Mit Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. ist dem Konzern Vorratsvermögen in Höhe von insgesamt 8.956 Tsd.€ zugegangen.

Der Betrag der Vorräte, die in den Geschäftsjahren 2012 und 2011 als Aufwand erfasst wurden, beträgt rund 95.987 Tsd.€ (Vorjahr: 105.540 Tsd.€).

(16) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in Tsd.€	2012	2011
Forderungen gegen Dritte	22.375	18.336
Wertberichtigungen	-617	-546
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.758	17.790

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in Tsd.€	2012	2011
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	546	740
Ausbuchung von Forderungen	-19	-3
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-14	-241
Zuführung	104	50
Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende	617	546

(17) Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in Tsd.€	2012	2011
Aktivierter Stückzinsen	260	379
Förderprojekte	24	186
Lieferantenboni	37	54
Bietungsgarantien	89	57
Versicherungsentschädigungen	68	0
Sonstiges	69	80
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	547	756

Unter den aktivierten Stückzinsen werden geleistete Vorauszahlungen auf Zinsforderungen aus erworbenen Wertpapieren dargestellt.

(18) Wertpapiere

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von 11.394 Tsd. € (Vorjahr: 19.362 Tsd. €).

(19) Steuererstattungsansprüche

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von 80 Tsd. € (Vorjahr: 87 Tsd. €) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 2,54 % p.a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von 295 Tsd. € (Vorjahr: 686 Tsd. €).

(20) Sonstige (kurzfristige) Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in Tsd. €	2012	2011
Aktive Rechnungsabgrenzung	597	1.055
Geleistete Anzahlungen	651	671
Umsatzsteuer	352	379
Kautionen	32	30
Forderungen aus Förderprojekten	85	213
Sonstiges	6	445
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1.723	2.793

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

(21) Eigenkapital

GEZEICHNETES KAPITAL

Aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 wurden im Geschäftsjahr insgesamt 14.510 Bezugsrechte ausgeübt.

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG wurde von 19.101.028,00 € (eingeteilt in 19.101.028 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €) um einen Betrag von 14.510,00 € erhöht und betrug zum Bilanzstichtag 19.115.538,00 €. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 9.053 Tsd. € (Vorjahr: 9.053 Tsd. €).

Am 31. Dezember 2012 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt 0 Tsd. € (Vorjahr: 1.270 Tsd. €).

in Tsd. €	2012	2011
Grundkapital	19.116	19.101
Genehmigtes Kapital	9.053	9.053
Gedingtes Kapital	0	1.270

RÜCKLAGEN

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2012	2011
Kapitalrücklage	97.615	98.384
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzgewinn	11.896	2.799
Rücklagen	109.944	101.616

Mit Erwerb von 15 % an den Anteilen an der Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel / Schweiz im Mai 2012 hat die SÜSS MicroTec AG ihre Beteiligung auf 100 % aufgestockt. Die Anschaffungskosten für die erworbenen Anteile betragen 1.501 Tsd. €, während sich das auf die Minderheiten entfallende Eigenkapital zum Kaufzeitpunkt auf 728 Tsd. € belief. Der Kauf der Minderheitenanteile wurde gemäß IAS 27 als Eigenkapitaltransaktion dargestellt. Die Differenz zwischen den Anschaffungskosten für die erworbenen Anteile und dem auf die Minderheiten entfallende Eigenkapital wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Aus den Ausübungen von Aktienoptionen wurden 4 Tsd. € (Vorjahr: 114 Tsd. €) der Kapitalrücklage zugeführt. Im Vorjahr wurden der Kapitalrücklage aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne 45 Tsd. € ergebniswirksam zugeführt.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzgewinn erhöhte sich durch das positive Jahresergebnis von 9.097 Tsd. € vor Berücksichtigung von Minderheiten auf 11.896 Tsd. €.

KUMULIERTES ÜBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2012	2011
Fremdwährungsanpassungen	-988	-824
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-331	-101
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	277	307
Steuereffekte		
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-90	-98
Absicherung künftiger Zahlungsströme	119	57
Stand zu Beginn der Periode	-1.013	-659
Veränderungen vor Steuern		
Fremdwährungsanpassungen	200	-164
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-189	-230
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	9	-30
Steuereffekte		
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	-2	8
Absicherung künftiger Zahlungsströme	24	62
Stand am Ende der Periode	-952	-1.013

Die SÜSS MicroTec AG hat in 2010 einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

EIGENKAPITALMANAGEMENT

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr aus dem operativen Geschäft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Unabhängig davon besteht bei einer Verfehlung der Planung die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags verringern könnte.

AKTIENOPTIONSPLÄNE DER SÜSS MICROTEC AG

AKTIENOPTIONSPLAN 2005

Auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2005 wurde die Schaffung eines bedingten Kapitals 2005 / I in Höhe von 750.000 € beschlossen. Es dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals wurden insgesamt 749.800 Bezugsrechte ausgegeben. Sämtliche ausgegebenen Bezugsrechte sind zum 31. Dezember 2012 verfallen.

AKTIENOPTIONSPLAN 2008

Auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 wurde die Schaffung eines bedingten Kapitals 2008 / I in Höhe von 438.250 € beschlossen. Es dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals wurden insgesamt 438.250 Bezugsrechte ausgegeben. Hieraus wurden im Geschäftsjahr 2011 379.990 und im Geschäftsjahr 2012 14.510 Bezugsrechte ausgeübt. Alle übrigen Bezugsrechte sind zum 31. Dezember 2012 verfallen.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 0 Tsd. € (Vorjahr: 45 Tsd. €) für diese Pläne vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden wie im Vorjahr keine Bezugsrechte ausgegeben.

Am 31. Dezember 2012 bestanden keine begebaren Bezugsrechte mehr (Vorjahr: 461.750 begebare Bezugsrechte).

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €
01.01.2008	668.950	7,26
gewährt 2008	0	0,00
ausgeübt 2008	0	0,00
verfallen 2008	81.300	7,30
31.12.2008	587.650	7,26
gewährt 2009	438.250	1,30
ausgeübt 2009	0	0,00
verfallen 2009	170.700	7,04
31.12.2009	855.200	4,25
gewährt 2010	0	0,00
ausgeübt 2010	0	0,00
verfallen 2010	158.400	4,59
31.12.2010	696.800	4,18
gewährt 2011	0	0,00
ausgeübt 2011	379.990	1,30
verfallen 2011	115.500	7,21
31.12.2011	201.310	7,88
gewährt 2012	0	0,00
ausgeübt 2012	14.510	1,30
verfallen 2012	186.800	8,39
31.12.2012	0	0,00
noch begebbar	0	

(22) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd.€	2012	2011
Inländische Verpflichtungen	1.663	1.683
Ausländische Verpflichtungen	1.214	1.189
Gesamt	2.877	2.872

LEISTUNGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED BENEFIT PLANS“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2012	2011
Abzinsungsfaktor	2,54	4,83 – 5,16
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	2,54	5,80
Gehaltssteigerung	0,00	0,00
Rentensteigerung	2,00	2,00

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden nur in der Schweiz Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2012	2011
Abzinsungsfaktor	2,00	2,50
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,00	3,00
Gehaltssteigerung	1,50	1,50
Rentensteigerung	0,00	0,25

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2012	2011
Abzinsungsfaktor	2,00	2,00
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	0,00	0,00
Gehaltssteigerung	1,62	1,62
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2012 und 2011 wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2012	2011
Anwartschaftsbarwert am 01.01.	5.405	5.610
Dienstzeitaufwand	264	272
Zinsaufwand	196	207
Pensionszahlungen	-341	-387
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust	775	-417
Währungsveränderungen	-98	120
Anwartschaftsbarwert am 31.12.	6.201	5.405

in Tsd. €	2012	2011
Planvermögen am 01.01.	1.901	1.913
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	82	84
Geleistete Fondsdotierungen	-7	20
Versicherungsmathematische (+) Gewinne / (-) Verluste	-17	-141
Währungsveränderungen	7	25
Planvermögen am 31.12.	1.966	1.901

Die wesentlichen Komponenten des Planvermögens sind Rückdeckungsversicherungen und festverzinsliche Wertpapiere. Die erwarteten Gesamterträge aus Planvermögen werden auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt gängigen Marktpreise für den Zeitraum, über den die Verpflichtung erfüllt wird, berechnet. Diese spiegeln sich in den Grundannahmen wider. Die tatsächlichen Erträge aus Planvermögen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 12 Tsd. € (Vorjahr: 18 Tsd. €). Die erwarteten Beiträge an das Planvermögen betragen 178 Tsd. €.

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in Tsd. €	2012	2011
Barwert der Pensionsverpflichtungen	6.201	5.405
Zeitwert des Planvermögens	-1.966	-1.901
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	4.235	3.504
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne / (-) Verluste	-1.358	-632
Rückstellung	2.877	2.872

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von 3.677 Tsd. € (Vorjahr: 3.401 Tsd. €) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Tsd. €	2012	2011
Dienstzeitaufwand	183	189
Personalaufwandskomponente	183	189
Zinsaufwand	196	207
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-79	-84
Versicherungsmathematische (+) Gewinne / (-) Verluste	57	-14
Zinsaufwandskomponente	174	109

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von 109 Tsd. € (Vorjahr: 133 Tsd. €) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von 74 Tsd. € (Vorjahr: 56 Tsd. €) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts und des Planvermögens zeigt folgende Tabelle:

in Tsd.€	2012	2011	2010	2009	2008
Anwartschaftsbarwert	6.201	5.405	5.610	5.014	4.819
Planvermögen	1.966	1.901	1.913	1.645	1.664
Deckungsstatus	4.235	3.504	3.697	3.369	3.155

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 A(p) waren im Betrachtungszeitraum nicht notwendig.

BEITRAGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED CONTRIBUTION PLANS“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Von dem Plan profitieren alle Mitarbeiter der Tamarack Scientific Co., Inc. (Corona) und der Suss MicroTec Inc. (Sunnyvale) ab einem Alter von 18 bzw. 21 Jahren und einem Minimum an geleisteten Arbeitsstunden von 1.000 Stunden pro Jahr. Beide Defined Contribution Plans beinhalten zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Bei der Suss MicroTec Inc. werden die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag 0,50 USD für jeden 1,00 USD des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von 3.000 USD (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt 1.500 USD). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Der 401 (k) Plan der Tamarack Scientific Co., Inc. bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 25 % ihrer jährlichen Vergütung in den 401 (k) Plan einzubezahlen. Für jeden 1,00 USD Arbeitnehmerbeitrag wird ein Arbeitgeberbeitrag von 1,00 USD beigesteuert bis zu einem Maximalbetrag von 3 % des Gehalts. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen einen unverfallbaren Leistungsanspruch gestaffelt in 20-%-Schritten über einen Zeitraum von 6 Jahren.

Im Geschäftsjahr 2012 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den 401 (k) Plan 160 Tsd. USD (Vorjahr: 141 Tsd. USD).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 2.621 Tsd. € (Vorjahr: 2.324 Tsd. €) abgeführt.

(23) (Langfristige) Rückstellungen

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in Tsd.€	Stand 01.01.2012	Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.2012
Altersteilzeit	348	-52	0	296

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der Süss MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung / Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82% des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(24) Finanzschulden

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2012 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31.12.2012				
in Tsd.€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182	720	3.240	4.142
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	106	21	0	127
Gesamt	288	741	3.240	4.269

31.12.2011				
in Tsd.€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182	720	3.420	4.322
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	8.984	0	0	8.984
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	965	139	0	1.104
Gesamt	10.131	859	3.420	14.410

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag in Höhe von 4.140 Tsd. € (Vorjahr: 4.320 Tsd. €), der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels dient. Der Darlehensvertrag wurde am 25./28. Mai 2010 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf 4,5 Mio. € und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valuiert und zur Auszahlung gebracht.

Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

in Tsd.€	2012	2011	Zinssatz	Fälligkeit
Konzerngesellschaft				
SÜSS MicroTec AG	4.140	4.320	3,98%	30.6.2020
Gesamt	4.140	4.320		
davon kurzfristig fällig	180	180		
davon langfristig fällig	3.960	4.140		
fällig in 2013	180			
2014	180			
2015	180			
2016	180			
2017	180			
später	3.240			
	4.140			

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd.€	2012	2011
Kreditlinie	11.200	13.700
Inanspruchnahme	1.913	2.894
Verfügbare Kreditlinie	9.287	10.806

Die von dem bisherigen Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB bereitgestellte Kredit- und Avallinie in Höhe von 8 Mio.€ lief bis zum 31. März 2012. Daneben stellte die DZ Bank AG eine Kredit- und Avallinie in Höhe von 2 Mio.€, die ebenfalls eine Laufzeit bis zum 31. März 2012 aufwies.

Mit Auslaufen der bisherigen Kreditverträge wurde das Bankenkonsortium erweitert und umfasst ab dem 1. April 2012 neben der BayernLB als Konsortialführer und der Deutschen Bank nun auch die DZ Bank AG. Die SÜSS MicroTec AG und die Suss MicroTec Lithography GmbH haben mit dem neuen Bankenkonsortium im März 2012 neue Kreditverträge abgeschlossen. Mit den neuen Kreditverträgen wurden Kredit- und Avallinien von insgesamt 7,5 Mio.€ vereinbart. Die neuen Kreditlinien haben eine Laufzeit bis zum 31. März 2013 und wurden ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften. Die Linie wird durch eine Globalzession der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Suss MicroTec Lithography GmbH besichert.

Im Mai 2010 hat die Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG mit der BW-Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio.€ gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronats-erklärung für die Suss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften in Höhe von 2,5 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von 1.913 Tsd. € (Vorjahr: 2.894 Tsd. €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 1,25 % (Vorjahr: 1,20 %).

VERBINDLICHKEITEN AUS SCHULDSCHEINDARLEHEN

Das Schuldscheindarlehen wurde im Dezember des Berichtsjahres zurückgeführt und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 0 €.

in Tsd.€	2012	2011	Zinssatz	Fälligkeit
Konzerngesellschaft				
SÜSS MicroTec AG	0	2.995	6,00 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	0	2.995	6,17 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	0	2.994	6,06 %	21.12.2012
Gesamt	0	8.984		
davon kurzfristig fällig	0	8.964		
davon langfristig fällig	0	0		
fällig in 2013	0			
2014	0			
2015	0			
2016	0			
2017	0			
später	0			
	0			

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE LEASE

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Software, Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in Tsd.€	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehenden Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 2012	987	2.465	0
Abschreibungen / Aufwendungen 2011	948	2.370	0
Künftige Verpflichtungen fällig in 2013	107	2.272	0
2014	13	918	0
2015	8	258	0
2016		117	0
2017		35	0
später			0
Gesamt zukünftig	128	3.600	0
Zinsanteil	1		
Verbindlichkeit 31.12.2012	127		
davon kurzfristig	106		
davon langfristig	21		

Größten Anteil an den Aufwendungen für Finance Lease haben die Leasing-Raten für das in Deutschland, den USA und Taiwan genutzte SAP-System. Dieser Leasing-Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2013. Der Vertrag beinhaltet eine Kaufoption, die mit Beendigung des Leasing-Vertrags ausgeübt werden kann. Die SÜSS MicroTec AG hat diese Kaufoption ausgeübt und das SAP-System zum 1. Februar 2013 für einen Kaufpreis von 228 Tsd.€ erworben.

(25) Sonstige (langfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd.€	2012	2011
Kaufpreisverpflichtung Suss MicroOptics	346	0
Earn-Out-Verpflichtung Tamarack Scientific (Anteilseigner)	1.833	0
Earn-Out-Verpflichtung Tamarack Scientific (Mitarbeiter)	149	0
Sonstiges	249	244
Sonstige (langfristige) finanzielle Verbindlichkeiten	2.577	244

(26) (Kurzfristige) Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd.€	2012	2011
Garantierückstellungen	2.012	2.085
Übrige Rückstellungen	1.590	1.237
Kurzfristige Rückstellungen	3.602	3.322

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Nachlaufkosten sowie Personalrückstellungen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd.€	Stand 01.01.2012	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
Garantierückstellungen	2.085	-1.412	-7	1.346	2.012
Übrige Rückstellungen	1.237	-602	-325	1.280	1.590
Kurzfristige Rückstellungen	3.322	-2.014	-332	2.626	3.602

(27) Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd.€	2012	2011
Prämien und Provisionen	3.182	2.943
Fremdleistungen	2.303	1.794
Aufsichtsratsvergütung	148	152
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	0	148
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	506	478
Sonstiges	676	480
Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten	6.815	5.995

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte der Zinsderivate aus. Weitere Einzelheiten zu den Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 30 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

(28) Sonstige (kurzfristige) Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd.€	2012	2011
Erhaltene Anzahlungen	17.648	18.446
Abgegrenzte Personalkosten	4.443	3.621
Passive Rechnungsabgrenzung	135	1.444
Umsatzsteuer	418	0
Sonstiges	920	578
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	23.564	24.089

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(29) Steuerschulden

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von 716 Tsd.€ (Vorjahr: 5.344 Tsd.€) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von 334 Tsd.€ (Vorjahr: 390 Tsd.€).

SONSTIGE ANGABEN

(30) Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten. Zur Risikoberichterstattung im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten verweisen wir auf die Darstellung im Lagebericht (Seite 64 ff. dieses Geschäftsberichts).

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in Tsd. €	2012	2011
Finanzielle Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.192	37.036
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	11.394	19.362
Kredite und Forderungen	22.305	18.546
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	0	0
	58.891	74.944
Finanzielle Verbindlichkeiten		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	506	627
Finanzielle Verbindlichkeiten	20.017	27.604
	20.523	28.231

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in Tsd. €	2012		2011	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Finanzielle Vermögenswerte				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.192	25.192	37.036	37.036
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.758	21.758	17.790	17.790
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	547	547	756	756
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	547	547	756	756
bewertet zum Marktwert	0	0	0	0
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	11.394	11.394	19.362	19.362
Finanzielle Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.862	6.862	7.582	7.582
Finanzschulden	4.269	5.061	14.410	15.251
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.142	4.933	4.322	4.713
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	0	0	8.984	9.415
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	127	128	1.104	1.123
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	9.392	9.392	6.239	6.239
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	8.886	8.886	5.612	5.612
bewertet zum Marktwert	506	506	627	627

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige finanzielle Vermögenswerte / Verbindlichkeiten: Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Wertpapiere: Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen (Vorjahr) wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2012	2011
Kredite und Forderungen	-71	196
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	121	-276
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	9	-154

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die während der Laufzeit im kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von 23 Tsd. € (Vorjahr: -63 Tsd. €) infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert.

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die direkten Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd.€	2012		2011	
	positiver Marktwert	negativer Marktwert	positiver Marktwert	negativer Marktwert
Devisentermingeschäfte	0	0	0	148
Zinsswaps	0	506	0	479

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Teil des in 2007 begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Auch das in 2010 aufgenommene Darlehen, das der Finanzierung des Grundstücks Sternenfels dient und einen variablen Zins aufweist, wurde mit einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps für das Grundstücksdarlehen im kumulierten übrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft für diesen Zinsswap Hedge Accounting angewendet. Die Marktwertschwankungen der Zinsswaps für den variablen Teil des Schuldscheindarlehens wurden in den Zinserträgen bzw. -aufwendungen erfasst. Der Zinsswap im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 auf.

(31) Nahestehende Personen

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20% oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen“ – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

(32) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2012	2011
Bestellobligo	11.020	24.493
Mietverpflichtungen	2.646	4.003
Summe	13.666	28.496

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

(33) Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von 350 Tsd. € (Vorjahr: 350 Tsd. €) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Dieser Betrag kann jederzeit durch die Stellung einer Rückbürgschaft abgelöst werden.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von -1.469 Tsd. € (Vorjahr: -566 Tsd. €) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sind hier außerdem die Effekte aus der Anpassung der Earn-Out-Verpflichtung Tamarack Scientific in Höhe von 1.798 Tsd. € erfasst.

Im Cashflow aus Investitionstätigkeit sind Zahlungseingänge in Höhe von 1.507 Tsd. € enthalten, die aus der Veräußerung des Test Business zum 28. Januar 2010 resultieren. 24 Monate nach Abschluss des Kaufvertrags wurde ein auf Treuhandkonten verbleibender Kaufpreis-Bestandteil an die SÜSS MicroTec AG ausbezahlt und ertragswirksam vereinnahmt.

Der Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc., Corona (USA) wurde als Investition im Cashflow aus Investitionstätigkeit dargestellt. Im Geschäftsjahr ist ein Teil des vereinbarten Kaufpreises in Höhe von 7.005 Tsd. € für den Erwerb abgeflossen. Durch die Erstkonsolidierung wurden Zahlungsmittel der erworbenen Gesellschaft in Höhe von 1.821 Tsd. € übernommen. Die im Zusammenhang mit dem Erwerb angefallenen Nebenkosten in Höhe von 288 Tsd. € mindern den operativen Cashflow.

Der Erwerb der restlichen 15 % an der Süss MicroOptics S.A., Neuchâtel (Schweiz), die bis zum Erwerbszeitpunkt von Minderheitsaktionären gehalten wurden, wurde im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Im Geschäftsjahr ist ein Teil des vereinbarten Kaufpreises in Höhe von 1.126 Tsd. € abgeflossen. Darüber hinaus fielen Erwerbsnebenkosten in Höhe von 29 Tsd. € an, die – da sie erfolgsneutral mit der Konzernkapitalrücklage verrechnet wurden – ebenfalls im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen werden.

(34) Segmentberichterstattung

INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment aufgeteilt. Zusammen mit dem Segment Sonstige werden diese Aktivitäten in der Segmentberichterstattung unter den fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt. Unter den nicht fortgeführten Aktivitäten wird das Segment Test Systeme ausgewiesen.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater sowie die durch Akquisition der Tamarack Scientific neu hinzugekommenen Produktlinien UV Projection und Laser Processing. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Die Entwicklung und Produktion der Tamarack-Produktlinien erfolgt in Corona (USA). Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für das Segment Lithografie tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind seit März 2011 in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. In 2010 war dieser Geschäftszweig mit Produktion, Entwicklung und Vertrieb noch in Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Der Vertrieb für das Segment Substrat Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig. In diesem Segment bildet der XBC300, ein Produktions-Bonder für bis zu 300 mm Wafern, die Ausgangsplattform für die drei wichtigsten Bondtechniken im Bereich der 3D-Integration (einer unserer Zukunftsmärkte): das temporäre und permanente Bonden sowie das Debonden. Zu den Schlüsseltechnologien, die die 3D-Integration erfordert, zählt darüber hinaus das Dünnen von Wafern sowie die weitere Handhabung dieser äußerst fragilen Substrate („Thin Wafer Handling“). Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMX, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der am 15. Februar 2010 akquirierten Süss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (vormals HamaTech APE GmbH & Co. KG). Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr lagen sämtliche Umsätze von Süss MicroTec mit einzelnen Kunden unter einem Anteil von 10 % des Gesamtumsatzes. Im Vorjahr erzielte Süss MicroTec mit einem Kunden Umsätze, die einen Anteil von 11,2 % am Gesamtumsatz ausmachten. Diese Umsätze betrafen im Vorjahr die Segmente Fotomasken Equipment sowie Lithografie.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen. Die Segmentberichterstattung 2012 weist in den Investitionen des Segments Lithografie auch die Zugänge an Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten aus, die durch die Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific zum Vermögen des Konzerns hinzuaddiert wurden.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Süss MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 24.510 Tsd. € (Vorjahr: 19.131 Tsd. €) in Deutschland erzielt.

Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt. Das langfristige Vermögen des Konzerns besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und Sachanlagen. Vom langfristigen Vermögen sind 26.225 Tsd. € (Vorjahr: 29.590 Tsd. €) Gesellschaften in Deutschland zuzurechnen; 10.183 Tsd. € (Vorjahr: 2.053 Tsd. €) entfallen auf ausländische Gesellschaften. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 2.033 Tsd. € (Vorjahr: 2.390 Tsd. €) in Deutschland vorgenommen.

(35) Nachtragsbericht

Die SÜSS MicroTec AG hat mit Kaufvertrag vom 23. Januar 2013 die von SÜSS MicroTec AG und Suss MicroTec Lithography GmbH genutzte Immobilie am Firmensitz in Garching erworben. Der rechtliche Übergang der Immobilie wird voraussichtlich zum 30. September 2013 erfolgen. Der Kaufpreis für die Immobilie und das rund 20.000 m² große Grundstück beträgt 8,7 Mio. € und wird aus den bestehenden liquiden Mitteln finanziert werden.

Zum 31. Januar 2013 lief der Sale-and-Lease-Back-Vertrag für das konzernneigene SAP-System, das in Deutschland, den USA und Taiwan genutzt wird, aus. Die SÜSS MicroTec AG hat die im Vertrag festgelegte Kaufoption ausgeübt und das SAP-System zum 1. Februar 2013 für einen Kaufpreis von 0,2 Mio. € erworben.

(36) Vorstand und Aufsichtsrat

VORSTAND DER KONZERNBERGEGESellschaft

MITGLIEDER DES VORSTANDES DER SÜSS MICROTEC AG IM GESCHÄFTSJAHR 2012 WAREN:

Frank Averdung Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender
 Zuständigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Investor Relations, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie
 weitere Mandate: VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
 IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

Michael Knopp Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands
 Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Materialwirtschaft, Logistik, Facility Management
 weitere Mandate: keine

AUFSICHTSRAT

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES IM GESCHÄFTSJAHR 2012 WAREN:

Dr. Stefan Reineck Kirchartt, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchartt; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG
 weitere Mandate: AttoCube Systems AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
 Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)
 Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“)
 Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

Jan Teichert Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar;
 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG
 weitere Mandate: keine

Gerhard Pegam	Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting GmbH, Au bei Bad Aibling; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG
Weitere Mandate:	OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats); EPCOS AG, München (Vorstandsvorsitzender bis 31. Januar 2012) TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan (Mitglied des Board of Directors bis 31. Januar 2012) sowie folgende Tochtergesellschaften der EPCOS AG (bis 31. Januar 2012): <ul style="list-style-type: none"> • EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors) • EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors) • EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors) • EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA (Vorsitzender des Board of Directors) • Becromal S.p.A., Mailand, Italien (Vorsitzender des Board of Directors) • Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island (Vorsitzender des Board of Directors)

VERGÜTUNG VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von 1.253 Tsd. € (Vorjahr: 705 Tsd. €). Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 161 Tsd. € (Vorjahr: 165 Tsd. €).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrates sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2012		2011	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Michael Knopp	22.500	0	35.000	41.400
Frank Averdung	83.200	0	82.000	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	0	9.600	40.000

(37) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 695 Mitarbeiter (Vorjahr: 631 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2012	2011
Verwaltung	74	68
Marketing und Vertrieb	285	256
Produktion und Technik	345	300
Summe	704	624

(38) Honorare des Abschlussprüfers

Im aktuellen Geschäftsjahr hat Süss MicroTec für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Honoraraufwendungen nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von 265 Tsd. € erfasst. Das im Vorjahr für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honorar nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB betrug 306 Tsd. €. Die Zusammensetzung des Honorars im aktuellen sowie im Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2012 (BDO AWT GmbH)	2011 (KPMG AG)
Abschlussprüfung	265	286
Steuerberatung	0	20
Gesamt	265	306

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Vorjahr: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Von dem Prüfungshonorar entfallen 222 Tsd. € direkt auf den bestellten Abschlussprüfer und 43 Tsd. € auf Netzwerkpartner des Abschlussprüfers.

Das Honorar für Steuerberatung 2011 betraf die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen sowie die laufende steuerliche Beratung der Süss MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG.

(39) Corporate Governance

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Mai 2012 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 mit fünf Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung / Stimmrechtsvertreter, Briefwahl / Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen haben und entsprechen werden.

Im Januar 2013 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit vier Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, Bildung von Ausschüssen und Benennung von Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden und den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Mai 2012 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

(40) Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 21. Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Februar 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,54 % beträgt (486.093 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,28 % (436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die BlackRock, Inc., New York, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 10. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 4. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,07 % beträgt (586.792 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,07 % (586.792 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 10. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 4. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,07 % beträgt (586.792 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,07 % (586.792) Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Financial Management, Inc., New York, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 10. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 4. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,07 % beträgt (586.792 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,07 % (586.792) Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Advisors Holdings, Inc., New York, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (577.168 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,02 % (577.168 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock International Holdings, Inc., New York, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (577.168 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,02 % (577.168) Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Group Limited, London, Großbritannien hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (577.168 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,02 % (577.168) Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BR Jersey International Holdings L.P., St. Helier, Jersey, Channel Islands, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15. Mai 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 9. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % beträgt (577.168 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,02 % (577.168) Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Advisors Holdings, Inc., New York, NY, U.S.A. hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juni 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,86 % beträgt (545.569 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,86 % (545.569 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock International Holdings, Inc., New York, NY, U.S.A. hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juni 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,86 % beträgt (545.569 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,86 % (545.569) Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Group Limited, London, U.K. hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juni 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,86 % beträgt (545.569 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,86 % (545.569) Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BR Jersey International Holdings, L.P., St. Helier, Jersey, Channel Islands, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juni 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,86 % beträgt (545.569 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,86 % (545.569) Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock, Inc., New York, NY, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Juli 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,23 % beträgt (617.610 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,23 % (617.610 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington, DE, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Juli 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,23 % beträgt (617.610 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,23 % (617.610 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Financial Management, Inc., New York, NY, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Juli 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,23 % beträgt (617.610 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,23 % (617.610 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock, Inc., New York, NY, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 29. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99 % beträgt (570.217 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,99 % (570.217 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington, DE, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 29. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99 % beträgt (570.217 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,99 % (570.217 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Financial Management, Inc., New York, NY, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 29. Juni 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99 % beträgt (570.217 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,99 % (570.217 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock, Inc., New York, NY, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 17. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Juli 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (567.949 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,97 % (567.949 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington, DE, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 17. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Juli 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (567.949 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,97 % (567.949 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die BlackRock Financial Management, Inc., New York, NY, USA hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 17. Juli 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Juli 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97 % beträgt (567.949 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,97 % (567.949 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Global Investors (holdings) Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Oktober 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Oktober 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Oktober 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,14 % beträgt (601.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,14 % (601.056 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die DWS Invest, Luxembourg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19. Oktober 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. Oktober 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,04 % beträgt (580.394 Stimmrechte).

(41) Freigabe des Abschlusses

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss am 14. März 2013 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 14. März 2013

Der Vorstand



Frank Averdung



Michael Knopp

VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 14. März 2013

SÜSS MicroTec AG



Frank Averdung



Michael Knopp

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG, Garching, den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 25. März 2013

BDO AWT GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. S. Spitaler
Wirtschaftsprüfer

B. Erdt
Wirtschaftsprüfer

GLOSSAR

3D-INTEGRATION

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt werden ohne durch sogenannte „Through-Silicon Vias“ (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-a-Chip) sowie weitere Verfahren subsummiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire Bonding („Drahtbonden“) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch „Through-Silicon Vias“ (TSV) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

300 MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben z.B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42 %) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 Millimeter. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip.

ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter Advanced Packaging versteht man weiterentwickelte Packaging-Verfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten Frontend der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

BACKEND

Backend bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

BONDEN

Mit dem Begriff „Bonden“ bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafers mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z.B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

BUMP

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold, o.Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugeln auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire Bonding oder Flip Chip Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

COATER (BESCHICHTUNGSGERÄT)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

COMPOUND SEMICONDUCTOR

siehe Verbindungshalbleiter

COST OF OWNERSHIP (COO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die Cost of Ownership der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem IBM System 3 eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen IBM C4 Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. C4 steht für Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip Chip Bonding verwendet. C4NP ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. NP steht dabei für New Process.

DIE

„Die“, IC (Integrated Circuit), Chip sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der „Dies“ spricht man von Chips.

DRAM

DRAM steht für Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird.

FAB

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Mrd. USD.

FLIP CHIP BONDING

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h. der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

FOUNDRY

Foundry ist eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

FRONTEND

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

HALBLEITER

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

LASER PROZESSIERUNG

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie z. B. die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten in Pikosekunden, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. SÜSS MicroTec bietet zwei Lasertechnologien an:

Excimer-Laserabdampfung: In der Mikrostrukturierung bietet der Einsatz von Excimer-Laser vor allem Möglichkeiten für eine Materialabdampfung. Durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung lässt sich Material von einer Oberfläche abtragen. Dabei stößt eine photochemische Reaktion eine Elektronenanregung an, die in einem plötzlichen Druckanstieg und einer explosiven Abtragung von Material in Form von Monomeren und Gasen resultiert. Die thermische Wirkung ist hierbei minimal – die Prozesstechnologie schont temperaturempfindliche Materialien. Die Systeme verwenden eine Photomaske, die mit einem Laserstrahl beleuchtet wird. Eine Projektionsoptik zwischen Maske und Wafer bildet, ähnlich einem Projektionsstepper in der Lithografie, die Maskenstrukturen auf dem Wafer ab. Jedoch wird das Material nicht belichtet sondern direkt abgetragen. Mit einem Step-and-Repeat-Verfahren wird der komplette Wafer strukturiert.

Prozessierung mit Festkörper-Laser: Die Festkörper-Laser-Technologie verspricht alle Vorteile der Laserprozessierung: Sie erreicht hohe Auflösungen von bis zu 2 µm und sorgt für besonders präzise Ergebnisse. Strukturierungsprozesse laufen ohne thermische Nebenwirkungen ab. Die Systeme kommen ohne Maske aus und verwenden eine direkte Schreibmethode.

LED

Light Emitting Diode. Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnfach so große Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.

LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32 nm (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip Chip Bonding herzustellen.

MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs benötigt werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

MASK ALIGNER (BELICHTUNGSGERÄT)

Mask Aligner richten eine Glasmasken submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

MEMS

MEMS steht für Micro Electro Mechanical System und ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

MIKROMETER / MIKRON

Metrisches Längenmaß. Symbol: μm . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haars beträgt ca. $60 \mu\text{m}$.

MIKROSYSTEM

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

MIKROSYSTEMTECHNIK

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Micro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

NANOIMPRINTING / NANO IMPRINT LITHOGRAFIE (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

NANOTECHNOLOGIE

Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehreren hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9}m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile, wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer, zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

PACKAGING FOUNDRIES

siehe Backend

PROBER (TEST- UND PRÜFSYSTEME)

Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden, und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexibel, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

PROJEKTIONSLITHOGRAFIE

Während bei der Vollfeld-Lithografie (Mask Aligner) der komplette Wafer in einem Vorgang belichtet wird, werden bei projektionslithografischen Prozessen typischerweise nur einzelne Bereiche des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die komplette Belichtung des Wafers wird dann entweder schrittweise (Step and Repeat) oder kontinuierlich (Scan) durchgeführt. SÜSS MicroTec fertigt 1:1 Projektionsscanner für das Halbleiter Mid- und Backend. Hierbei wird eine Vollfeldmaske verwendet und der Wafer in einem Scannvorgang belichtet. Eine Verkleinerung der Strukturgrößen von der Maske zum Wafer findet nicht statt. Die Projektionsscanner-Technologie von SÜSS MicroTec kombiniert Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie und bietet eine Alternative zu Mask Aligner und Projektions-Steppern.

SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

SILIZIUM

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

SUBSTRAT BONDER (VERBINDUNGSGERÄT)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können unsere Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker, etc. funktionieren.

SYSTEM-ON-A-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-a-Chip immer größere Wichtigkeit.

THROUGH-SILICON VIA (TSV)

Bei der Through-Silicon Via-Technik werden die einzelnen Chip-Komponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen (Through-Silicon Via) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

TOOL

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zu einer Produktionslinie kombiniert werden.

VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

WAFER

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid, etc.) auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300 mm Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200 mm Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

WIRE BONDING

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

YIELD

Die Ausbeute ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

FINANZKALENDER 2013

Geschäftsbericht 2012	28. März
Quartalsbericht 2013	8. Mai
Commerzbank German Midcap Conference, Boston / New York	22./23. Mai
DZ Bank Sustainability Konferenz, Zürich	4. Juni
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	19. Juni
Halbjahresbericht 2013	8. August
Commerzbank TMT Conference, Frankfurt	28. August
UBS Best of Germany Conference, New York	16. – 18. September
UniCredit / Kepler Investment Conference, München	24. – 26. September
Baader Investment Conference, München	24. – 26. September
Neunmonatsbericht 2013	7. November
Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/Main	11. – 13. November

HIGHLIGHTS 2012

FEBRUAR

LAUNCH DES XBC300 GEN2 BOND CLUSTERS

Mit der XBC300 Gen2 hat SÜSS MicroTec im Februar 2012 eine neue Geräteplattform für 3D-Prozesse in der Volumenproduktion in den Markt eingeführt. Diese neueste Generation von Bonding Equipment kann für das permanente Bonden von Wafern oder für das Debonden und Reinigen von 200 mm und 300 mm Wafern konfiguriert werden. Der Einsatzbereich der XBC300 Gen2 umfasst Produktion wie auch Prozessentwicklung. Zusammen mit der im Dezember 2011 eingeführten XBS300 und der neuen XBC300 Gen2 kann SÜSS MicroTec seinen Kunden eine hochmoderne und vollautomatische Lösung für die Handhabung von gedünnten Wafern bei der 3D-Integration und dem 3D-Packaging anbieten.

ZUSAMMENARBEIT MIT GENISYS GMBH

SÜSS MicroTec hat im Februar 2012 die Zusammenarbeit mit der GeniSys GmbH bekannt gegeben. Es geht bei dieser Kooperation um die Zusammenarbeit bei der Lithografie-Simulationssoftware Layout LAB™ von GeniSys mit Mask Alignern von SÜSS MicroTec. Im Rahmen dieser Kooperation wurde die Layout LAB™-Software erweitert, um alle derzeit verfügbaren SÜSS MicroTec Mask Aligner-Belichtungs-optiken zu modellieren. Beide Partner kombinieren ihre Anstrengungen, die SÜSS Mask Aligner-Technologie mit der

Simulationssoftware Layout LAB™ von GeniSys gemeinsam zu vermarkten. Die Kombination von Lithografiegeräten und zugehöriger Simulationssoftware ist ein weiterer Erfolgsfaktor für eine kosteneffektive Prozess- und Produktentwicklung bei den Endkunden.

MÄRZ

LAUNCH DER RCD8 COATER DEVELOPER-PLATTFORM

Im März 2012 wurde mit der RCD8 eine neue manuelle Geräteplattform zum Belacken und Entwickeln von Substraten in den Markt eingeführt. Eine hohe Flexibilität in den Anwendungsbereichen bei gleichzeitig niedrigen Investitionskosten zeichnet die neue Plattform aus. Die RCD8 bietet derzeit als einziges System im Markt die Möglichkeit, es innerhalb von wenigen Minuten von einem Spinbelacker – mit der GYRSET®-Technologie – zu einem Sprühentwickler umzurüsten.

AKQUISITION DER TAMARACK SCIENTIFIC CO., INC.

SÜSS MicroTec hat am 29. März 2012 die Akquisition der TamarackScientificCo.,Inc., Corona, Kalifornien, USA, bekannt gegeben. Der Kaufpreis für die Übernahme sämtlicher Tamarack-Aktien betrug 9,34 Mio. US Dollar. Darüber hinaus wurde eine Earn-Out-Komponente vereinbart. Tamarack Scientific entwickelt, produziert und vertreibt UV-Projektionsbelichtungsgeräte sowie laserbasierte Mikrostrukturie-

rungssysteme. Schwerpunktmärkte sind Advanced Packaging, 3D-Integration, MEMS und LED. Mit der Akquisition von Tamarack Scientific verfolgt SÜSS MicroTec eine Konsolidierungsstrategie im Halbleiter-Backend und ergänzt die vorhandene Lithografie-Kompetenz um die Projektionsbelichtung, die komplementär zur bestehenden Belichtungs-kompetenz ist. SÜSS MicroTec wird damit zum führenden Anbieter von Backend-Lithografie-Anlagen- und Prozesslösungen.

MAI

ANTEILSBESITZ AN SUSS MICROOPTICS S.A. AUF 100 PROZENT AUFGESTOCKT

Am 14. Mai 2012 hat SÜSS MicroTec bekannt gegeben, dass der Anteilsbesitz an der Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel, Schweiz, von bisher 85 Prozent auf 100 Prozent aufgestockt wurde. Suss MicroOptics ist ein führender Lieferant hochwertiger refraktiver und diffraktiver Mikrooptik. Das Know-how des Unternehmens umfasst optisches Design, Mikrofabrikation und Messtechnik. Das Unternehmen liefert hochwertige, in modernsten Herstellungsverfahren gefertigte Produkte basierend auf der 200 mm Wafer-Technologie in Quarz und Silikat und ist dank innovativer Technologien in der Branche führend.

JUNI

SÜSS MICROTEC AG: HAUPTVERSAMMLUNG 2012 IN MÜNCHEN

Am 20. Juni 2012 fand die Hauptversammlung von SÜSS MicroTec im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Die Aktionäre haben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der ordentlichen Hauptversammlung 2012 präsentierten, gegeben. Insgesamt waren über 100 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit waren mehr als 29 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 und der Bestellung eines neuen Abschluss- und Konzernabschlussprüfers stand die turnusmäßige Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats an. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Dr. Stefan Reineck, Jan Teichert und Gerhard Pegam, wurden in ihrem Amt bestätigt und für eine weitere Amtsperiode in den Aufsichtsrat gewählt.

DOW CORNING UND SÜSS MICROTEC KOOPERIEREN BEI DER ENTWICKLUNG VON TEMPORÄREN BOND-LÖSUNGEN FÜR DIE HALBLEITERINDUSTRIE

Dow Corning und SÜSS MicroTec haben am 25. Juni 2012 ihre Zusammenarbeit im Bereich temporäres Waferbonden für die 3D (TSV)-Integration angekündigt. Im Rahmen dieser nicht exklusiven Vereinbarung entwickeln beide Unternehmen Material- und Ausrüstungslösungen für das temporäre Bonden bei der 3D-Integration für die Volumenproduktion. Das auf Silikonbasis aufbauende Materialsystem von Dow Corning besteht aus einer Klebe- und einer Releaseschicht die beide über ein Aufschleuderverfahren aufgetragen werden. Im Anschluss werden die beiden Wafer temporär gebondet.

JULI

SÜSS MICROTEC PRÄSENTIERT ACS200 GEN3: NEUER AUTOMATISCHER BELACKER UND ENTWICKLER FÜR DIE MASSENPRODUKTION

Im Juli 2012 hat SÜSS MicroTec mit der dritten Generation der ACS200 eine neuentwickelte Automatenplattform zum Belacken und Entwickeln in den Markt eingeführt. Sie verbindet sowohl innovative Technologien als auch produktionserprobte Komponenten der bewährten Plattformen ACS200Plus und Gamma. Die vielfältige und flexible Konfigurierbarkeit der unterschiedlichen Module und Technologien ermöglicht es, nicht nur die Anforderungen der Kernmärkte Advanced Packaging, MEMS und LED abzudecken, sondern erlaubt darüber hinaus den Einsatz sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in der Massenproduktion.

SÜSS MICROTEC PRÄSENTIERT SICH AUF DER SEMICON WEST IN SAN FRANCISCO

Vom 10. bis 12. Juli fand die Semicon West 2012 im Moscone Center, San Francisco, statt. Unter dem bekannten Motto „Shrink, Stack, Integrate“ hat sich SÜSS MicroTec auf dieser bedeutenden Halbleitermesse präsentiert. Der Schwerpunkt des Messestands war die Lithography Plus-Kampagne, welche die im März getätigte Akquisition der Tamarack Scientific und die damit verbundene Ausweitung der Technologiekompetenz von SÜSS MicroTec in den Vordergrund stellte. Wie auch in den vergangenen Jahren, wurde darüber hinaus ein 3D-Workshop unter dem Motto „3D Integration Technology – Ready for Take Off?“ abgehalten.

AUGUST

SÜSS MICROTEC WIRD PARTNER DER NACHHALTIGKEITS-INITIATIVE „BLUE COMPETENCE“ DES VDMA

Seit August 2012 ist die SÜSS MicroTec AG offiziell anerkannter Partner der Nachhaltigkeitsinitiative „Blue Competence“ des VDMA. Da das Thema Nachhaltigkeit auch im industriellen Sektor immer mehr an Bedeutung gewinnt, hat sich SÜSS MicroTec der Initiative des VDMA angeschlossen. Als Teil der sozialen Verantwortung legt SÜSS MicroTec großen Wert auf den Schutz der Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft sowie das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums. Die Geschäftsbeziehungen umfassen nicht nur ökonomische und finanzielle Gesichtspunkte; auch die Umwelt und soziale Aspekte werden in gleicher Weise in Betracht gezogen.

SEPTEMBER

BAU DES HUNDERTSTEN LABSPIN6

Im September 2012 brach das kleinste Gerät der SÜSS MicroTec-Familie gleich zwei Rekorde. Mit insgesamt neun verkauften LabSpin6 war dies nicht nur die höchste Verkaufszahl eines Monats seit der Einführung des Gerätes, auch wurde die hundertste LabSpin gebaut. Die LabSpin-Serie löst seit Mitte 2010 ihren Vorgänger, die Delta6, ab. Als aktuelle Generation eines kompakten Belacker / Entwickler-Systems wurde sie von Grund auf für die Anforderungen von Laboratorien sowie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ausgelegt.

NOVEMBER

SÜSS MICROTECS ASIA TECHNOLOGY-FORUM FINDET GROSSEN ZUSPRUCH

Im November 2012 hat SÜSS MicroTec mit großem Erfolg ein Technologie-Forum in Asien veranstaltet. Im Rahmen des Forums wurden neueste Entwicklungen im Bereich Advanced Packaging, die damit verbundenen Materialien und Herstellungsprozesse sowie Markttrends in 3DIC vorgestellt. Die Veranstaltung fand an drei verschiedenen Tagen in den drei wichtigen Industriezentren Singapur, Hsinchu (Taiwan) und Shanghai (China) statt. Auf dem Forum haben führende Industrieunternehmen und weltbekannte Forschungsinstitute ihre Erfahrungen ausgetauscht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 2013 ein entscheidender Wandel in der 3DIC-Technologie mit

nennenswertem Wachstum erwartet wird, waren die Teilnehmer sehr interessiert daran, mehr über die neuesten Entwicklungen zu erfahren.

SUSS MICROOPTICS S.A. BEZIEHT NEUES PRODUKTIONSGEBÄUDE

Die 100%ige Tochtergesellschaft der SÜSS MicroTec AG ist im November 2012 in ein neues Produktionsgebäude in Neuchâtel eingezogen. Der Umzug wurde nötig, um dem kontinuierlich wachsenden Geschäftsvolumen Rechnung zu tragen und die Produktionseinrichtungen auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das neue Gebäude, welches zweckgerecht ausgebaut wurde, unterstützt die strategische Wachstumsausrichtung des Bereichs Mikrooptik.

DEZEMBER

EXCELLENCE IN ENGINEERING – BUILT TO LAST, SÜSS MICROTEC REMAN

SÜSS MicroTecs Anlagen werden mit großer Sorgfalt konstruiert und sind für lange Nutzungszeiten ausgelegt. Eine Lebensdauer von 20 oder mehr Jahren ist keine Seltenheit – und liefert einen Beweis für die herausragende Wirtschaftlichkeit. Seit einiger Zeit verzeichnet SÜSS MicroTec eine deutlich verstärkte Nachfrage nach überarbeiteten Gebrauchsmaschinen. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen entschlossen, den Fokus verstärkt auf dieses Geschäftssegment zu legen mit der vor kurzem initiierten Kampagne: „Excellence in Engineering – Built to Last!“. Damit möchte SÜSS MicroTec zukünftig das Gebrauchsmaschinengeschäft noch aktiver vermarkten.

IMPRESSUM

Herausgeber	SÜSS MicroTec AG
Redaktion	Finance, Julia Natterer Investor Relations, Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer	BDO AWT GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung	Whitepark GmbH & Co., Hamburg
Druck	Eberl Print GmbH, Immenstadt, München
Fotos	Michael Lange, SÜSS MicroTec AG, veer.com

KONTAKT

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Telefon: +49 (0)89-32007-161
E-Mail: ir@suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

www.suss.com